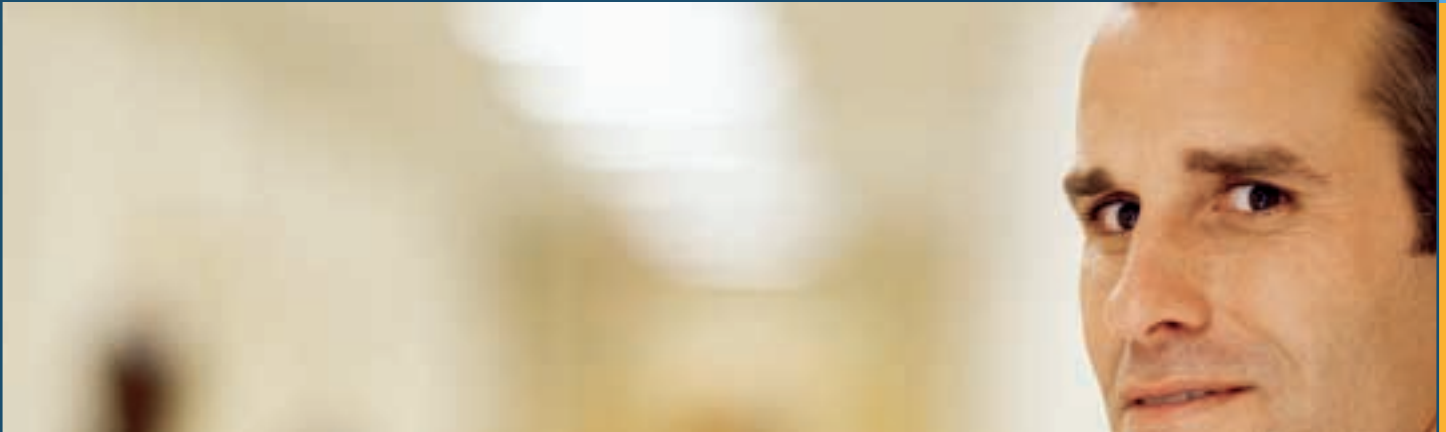


# Geschäftsbericht 2004



**Fokussierung auf das Wesentliche**

## SÜSS MICROTEC AG KENNZAHLENTABELLE

in Mio. Euro	2004	2003	% uale Veränderung
Auftragseingang netto	119,1	101,0	+ 18 %
Auftragsbestand per 31.12.2004 netto	38,7	33,9	+ 14 %
Umsatz	112,9	92,6	+ 22 %
Rohertrag	45,9	36,4	+ 26 %
Rohertragsmarge	40,7 %	39,4 %	n. a.
EBITDA	-3,2	-11,0	+ 71 %
EBITDA-Marge	-2,9 %	-11,9 %	n. a.
EBIT	-8,8	-17,1	+ 49 %
EBIT-Marge	-7,8 %	-18,5 %	n. a.
Eigenkapitalquote	62,0 %	64,0 %	n. a.
Net Cash	20,0	23,6	- 15 %
Free Cash Flow	-2,7	4,5	n. a.
Ergebnis je Aktie	-1,10	-0,97	- 13 %
Mitarbeiter	731,0	716	+ 2 %

+++++

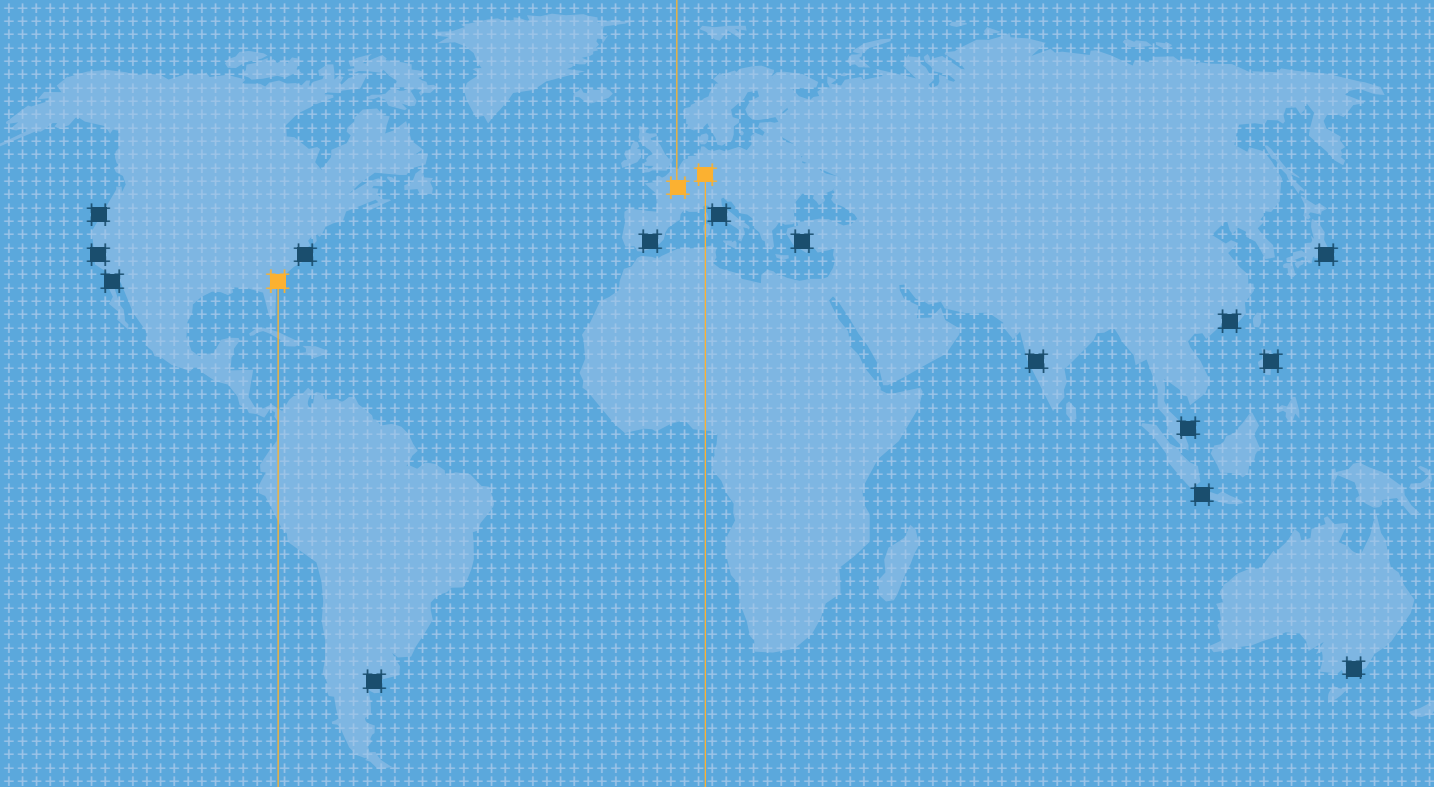
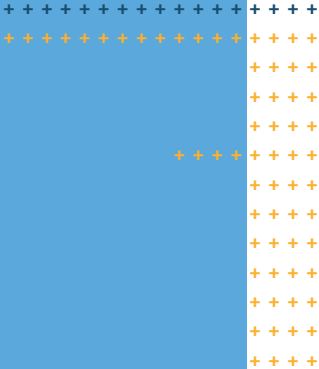
+++++

+++++

## UNTERNEHMENSKALENDER

Seminar	Datum	Ort
SEMICON Europa	12 - 14 April	München, Deutschland
Quartalsbericht	03. Mai	
Transducers 2005	05 - 09 Juni	Seoul, Korea
Hauptversammlung	21. Juni	München, Deutschland
SEMICON West	12 - 14 Juli	San Fransisco, USA
Halbjahresbericht	02. August	
COMS 2005	21 - 25 August	Baden-Baden, Deutschland
SEMICON Taiwan	12 -14 August	Taipei, Taiwan
European Microwave Week	03 - 07 Oktober	Paris, Frankreich
Neunmonatsbericht	08. November	
MEMS Seminar	November	Shanghai, China
SEMICON Japan	07 - 09 Dezember	n. A.

# WELTWEITE PRÄSENZ



Waterbury, USA + Substrat Bonder

Produktionsorte + Produkte

Sales Offices und Repräsentanzen

- Europa
  - München, Deutschland
  - Dresden, Deutschland
  - Vaihingen, Deutschland
  - Lincoln, England
  - St. Jeoire, Frankreich
  - Neuchatel, Schweiz

- Nord Amerika
  - Waterbury, USA
  - Tempe, USA
  - Santa Clara, USA

- Asien
  - Shanghai, China
  - Yokohama, Japan
  - Hsin-Chu, Taiwan
  - Bangkok, Thailand

- Rest der Welt
  - New South Wales, Australien
  - Sao Paulo, Brasilien
  - Pretoria, Südafrika

St. Jeoire, Frankreich + Device Bonder

München, Deutschland + Mask Alligner

Dresden, Deutschland + Prober

Vaihingen, Deutschland + Coater

## INHALTSVERZEICHNIS

+++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++  
++++

## GESCHÄFTSFELDER

- Das SÜSS MicroTec-Equipment 16
- Der Advanced Packaging-Markt 17
- Der Mikrosystemtechnik-Markt 19
- Der Verbindungshalbleiter-Markt 21
- Der Test & Measurement-Markt 22

## ÜBER UNS

- Vorwort des Vorstands 4
- Bericht des Aufsichtsrats 6
- Interview mit dem Vorstand 8
- Highlights 2004 14



++++  
++++  
++++  
++++

## DIE AKTIE

- Die SÜSS MicroTec-Aktie 26
- Corporate Governance 28



## LAGEBERICHT

Die Unternehmensgruppe	32
Marktentwicklung	32
Geschäftsverlauf 2004	33
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	37
Investitionen	41
Die Holding – SÜSS MicroTec AG	41
Mitarbeiter	43
Forschung und Entwicklung	44
Marketing und Vertrieb	46
Umwelt	46
Risikobericht	47
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	49
Ausblick	49



## KONZERNABSCHLUSS

Konzerngewinn- und Verlustrechnung	55
Konzernbilanz	56
Konzernkapitalflussrechnung	58
Entwicklung des Konzernanlagevermögens	60
Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung	62
Anhang	64
Glossar	98
Kontakt	



LINKS: DR. STEFAN SCHNEIDEWIND  
RECHTS: STEPHAN SCHULAK

## VORWORT DES VORSTANDES

### LIEBE AKTIONÄRE, MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER DER SÜSS MICROTEC AG,

im vergangenen Geschäftsjahr verfolgten wir das Ziel, unsere Marktposition durch Konzentration auf die Kernkompetenzen zu stärken und damit das Geschäftsergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu verbessern. Dieses Ziel wurde hinsichtlich Auftragseingang und Umsatz im Wesentlichen erreicht – hinsichtlich des Jahresergebnisses hingegen nicht. Mit diesem Geschäftsbericht möchten wir Ihnen die Ergebnisse detailliert darstellen.

Mit einem Umsatz von rund 113 Millionen Euro erreichten wir mit plus 22 Prozent eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig haben wir unsere Umsatzprognose für 2004 (115 bis 120 Millionen Euro) nahezu erfüllt. Dass wir die definierte Umsatzspanne nicht ganz erreichten, ist im Wesentlichen auf den unerwartet starken Werteverfall des US-Dollars gegenüber dem Euro im vierten Quartal 2004 zurückzuführen. Eine deutliche Verbesserung erzielten wir beim EBIT. Im Vergleich zu 2003 verbesserten wir unser operatives Ergebnis um 48,4 Prozent auf minus 8,8 Millionen Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung konnten wir unsere Prognose EBIT-Break-even bei einem Umsatz von 115 bis 120 Millionen Euro nicht erreichen. Belastet wurde das EBIT insbesondere durch einmalige Sondereffekte wie wechsellkursbedingte Buchverluste auf interne US-Dollar-Darlehen, durch Aufwendungen für die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die Änderungen im Vorstand.

Dass wir nun das dritte Jahr in Folge herbe Verluste zu verzeichnen haben, zeigt, dass weitere durchgreifende Kostensenkungsmaßnahmen notwendig sind, um 2005 wieder positive Ergebnisse zu erzielen.

Der Auftragseingang, der wohl wichtigste Branchenindikator, entwickelte sich im Jahr 2004 für SÜSS MicroTec deutlich positiv. Er erhöhte sich von 101 Millionen Euro im Jahr 2003 auf 119,1 Millionen Euro in 2004 (plus 17,8 Prozent). Der Auftragsbestand erreichte zum 31. Dezember 2004 38,7 Millionen Euro (Vorjahr: 33,9 Millionen Euro). Diese Entwicklungen zeigen die erhöhte Nachfrage nach SÜSS MicroTec-Equipment. In Bezug auf die Positionierung unserer Produkte haben wir im Jahr 2004 erhebliche Fortschritte erzielt. Neben unserem „klassischen“ Equipment für die Märkte Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik (Mask Aligner, Developer und Spin Coater) rückten 2004 auch unsere Produktlinien Bonder und Prober zunehmend in den Blickpunkt. So gelang uns im Geschäftsfeld Testsysteme die erfolgreiche Markteinführung des „Cluster Probe System“, der in der Produktion von Chips für die Optoelektronik und Mikrosystemtechnik eingesetzt wird (siehe Seite 22).

In den Märkten Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik wurde 2004 unser 200mm- und 300mm-Equipment verstärkt nachgefragt und verschaffte uns einen wesentlichen Wachstumsschub – auch im Hinblick auf unsere Position gegenüber dem Wettbewerb. Besonders erfreulich war die große Nachfrage aus den USA und Asien.

Ein besonders wichtiger Meilenstein war im September 2004 die Unterzeichnung eines Technologieabkommens zwischen IBM und SÜSS MicroTec zur gemeinsamen Entwicklung von Equipment für IBMs patentierte C4NP-Packaging-Technologie. Mikroelektronische Schaltkreise können mittels dieser Technologie kostengünstiger und durch den Verzicht auf bleihaltige Materialien umweltfreundlicher produziert werden. Weitere Informationen zu dem Technologieabkommen erhalten Sie auf den Seiten 8 (Highlights) und 18 (Märkte).

Mit der Schließung des Werkes Aßlar und der Konzentration der Mask Aligner-Produktion am Standort München wird ein wesentlicher Beitrag zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung umgesetzt. Diese Restrukturierung wird Ende des zweiten Quartals 2005 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus werden weitere kostensenkende Maßnahmen im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres eingeleitet. Dazu gehören unter anderem die Verbesserung der Prozesse in der Angebots- und Auftragsabwicklung, die Optimierung der Materialwirtschaft, die Vereinheitlichung von IT-Systemen sowie die Straffung der Organisation in der Verwaltung.

Langfristig gehen wir davon aus, das Wachstum der Halbleiter Equipment Industrie zu übertreffen. Diese Erwartungen stützen

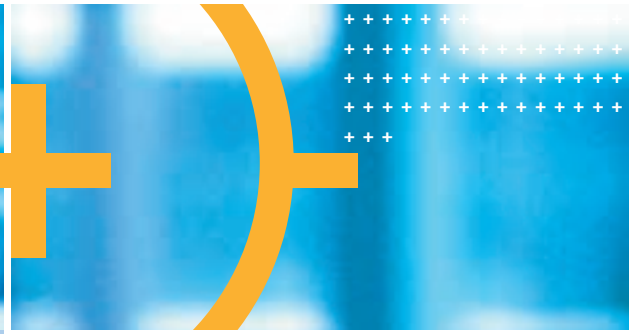
wir auf geplante Markteinführungen und die Marktdurchdringung neuer Maschinen für die Wachstumsmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Optoelektronik (LED). Im laufenden Jahr 2005 steht die Optimierung unserer Kostenstruktur deutlich im Mittelpunkt. Mehrere Projekte zur Senkung unserer Kosten werden sich noch in 2005 positiv auswirken.

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG, wir möchten uns an dieser Stelle für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Wir freuen uns auch im laufenden Geschäftsjahr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Garching, im März 2005

Dr. Stefan Schneidewind  
Vorstandsvorsitzender

Stephan Schulak  
Finanzvorstand



DR. WINFRIED SÜSS

## BERICHT DES AUFSICHTSRATS

### SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2004 regelmäßig durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in fünf gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands überwacht. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat die eingetretenen Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs von der Planung und die dafür maßgeblichen Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Stefan Schneidewind mit Wirkung vom 1. September 2004 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands und mit Wirkung vom 9. Dezember 2004 zu dessen Vorsitzenden bestellt. Herr Dr. Franz Richter, der seit dem 8. Juli 1998 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft war, ist am 9. Dezember 2004 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Dr. Süß als Vorsitzender sowie die Herren Schlytter-Henrichsen und Görtz als Mitglieder angehören, hat sich in drei Sitzungen mit Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen berichtet.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Schlytter-Henrichsen als Vorsitzender sowie die Herren Prof. Dr. Heuberger, Dr. Schücking und Dr. Süß als weitere Mitglieder angehören, hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in einer Sitzung unter anderem mit folgenden Fragen befasst:

- Auftrag an den Abschlussprüfer,
- Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
- Vergütung des Abschlussprüfers,
- Rationalisierungsmaßnahmen (einschließlich der Schließung des Standorts Aßlar), sowie
- Finanzierung der SÜSS MicroTec-Gruppe.

In diesen Angelegenheiten hat der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des Gesamtaufsichtsrats vorbereitet und den Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen unterrichtet.

Die Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats haben teilweise in Form von Telefonkonferenzen stattgefunden.

In seiner Sitzung vom 9. Dezember 2004 hat der Aufsichtsrat erneut die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft.



Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004, der nach den als US-GAAP bezeichneten Bilanzierungsregeln der Vereinigten Staaten von Amerika aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2004 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004 sowie den gemäß § 292 a des Handelsgesetzbuchs nach US-GAAP aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2004 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch

die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004 ist damit festgestellt. Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2004 ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Ungeachtet des unbefriedigenden Ergebnisses des Geschäftsjahrs 2004 dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften für ihren Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec-Konzern und den Betriebsräten und den Mitarbeitern der SÜSS MicroTec-Gruppe für ihr Verständnis für die unabwiesbaren Maßnahmen zur Anpassung an die veränderte Nachfrage nach den von der SÜSS MicroTec-Gruppe angebotenen Geräten.

Garching, im März 2005

Der Aufsichtsrat



Dr. Winfried Süß  
Vorsitzender

## INTERVIEW MIT DEM VORSTAND

Herr Dr. Stefan Schneidewind (49) ist seit 9. Dezember 2004 Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG. Der promovierte Diplom-Ingenieur startete vor 15 Jahren bei SÜSS MicroTec. Erst arbeitete er in Deutschland und in den USA im Bereich Forschung und Entwicklung, anschließend verantwortete der gebürtige Dresdener als Business Unit Manager bei der damaligen Karl Suss America Inc., in Waterbury, Vermont, den Bereich Test Systems. Anfang 2000 wechselte er als Geschäftsführer zur heutigen SÜSS MicroTec Test Systems GmbH nach Dresden.

Herr Stephan Schulak (36) absolvierte eine kaufmännische Lehre und studierte Betriebswirtschaft, er war unter anderem Konzernrevisor bei der Wacker-Chemie GmbH und übernahm Ende 2000 bei der SÜSS MicroTec die Leitung des Konzerncontrollings. Seit April 2002 ist Herr Schulak Finanzvorstand der SÜSS MicroTec AG.

**Herr Dr. Schneidewind, Sie haben erfolgreich den Bereich Test & Measurement in Dresden geleitet und entscheidend zu der weltweit sehr guten Marktposition des SÜSS MicroTec-Test-Equipment (Prober) beigetragen. Können Sie diese Erfahrungen in der neuen Position jetzt „antesten“?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Bei SÜSS MicroTec sind die einzelnen Geschäftsbereiche eng miteinander verknüpft. Hier findet ein intensiver und beständiger Austausch statt. Der Bereich Test & Measurement weist traditionell eine besonders enge Verknüpfung zu den anderen Produktlinien auf. Als Analysegeräte testen Prober am Endprodukt letztendlich die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Produktionsgeräte – und damit auch der SÜSS MicroTec-Geräte wie Mask Aligner, Bonder oder Developer. Deshalb war ich schon in der Vergangenheit immer eng in die Entwicklungs- und Herstellungsprozesse unserer weiteren Produkte eingebunden. Von diesen ausgeprägten Synergien im Unternehmen und meinem damit verbundenen Know-how kann und werde ich in meiner neuen Position sicherlich profitieren.

**SÜSS MicroTec ist in einem zyklischen Markt tätig, der das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder vor große Herausforderungen stellte. Wie wird sich das Unternehmen künftig in diesem Markt behaupten?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch aus schwierigen Marktsituationen gestärkt hervorgehen. Entscheidend dafür ist immer unser technologischer Vorsprung in Kombination mit der hohen Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und überragenden Wirtschaftlichkeit – „Cost of Ownership“ – unserer Produkte. So haben wir uns eine

weltweit anerkannte Position im Markt erobert und sind dem Wettbewerb gewöhnlich eine Nasenlänge voraus. Auf diese Kernkompetenzen konzentrieren wir uns auch in Zukunft. Daneben sind natürlich weitere Faktoren von großer Bedeutung. Wichtige Stichworte sind hier eine schlanke, effektive Unternehmensstruktur, ein hervorragender Kundenservice und starke Partnerschaften beziehungsweise Kooperationen.

**Um das letzte Stichwort aufzugreifen: Die Kooperation mit IBM im dritten Quartal 2004 war ein herausragender Meilenstein für SÜSS MicroTec. Wie geht es hier weiter?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Die Kooperation mit IBM ermöglicht uns, technologische Zukunft aktiv mitzugestalten. Erstmals wird der C4NP-Prozess von IBM kommerzialisiert und damit eine völlig neue Verfahrenstechnik für das Wafer-Bumping verwirklicht, die zudem umweltfreundlich ist. Dass die kommerzielle Umsetzung von C4NP mit SÜSS MicroTec-Geräten geschieht, ist ein deutlicher Beweis für unsere technische Kompetenz. Denn auf Basis unserer Kerntechnologien entwickeln wir eine komplette C4NP-Produktionslinie. Dieser Entwicklungsprozess hat für uns in 2005 eine hohe Priorität.

**Welchen Stellenwert haben Kooperationen künftig für SÜSS MicroTec?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Kooperationen sind für uns von großer Bedeutung – und SÜSS MicroTec hat seit den frühesten Anfängen erfolgreich mit wichtigen Partnern kooperiert. Ob mit IBM in den sechziger Jahren, mit Intel in den späten neunzigern oder mit dem Fraunhofer Institut – um hier nur einige Beispiele zu nennen. Von diesen Kooperationen hat SÜSS MicroTec in den verschiedensten Bereichen profitiert. Aktuellstes Beispiel ist das Techno-



logie-Abkommen, das wir im letzten September mit IBM abgeschlossen haben, bei dem es um eine zukunftsweisende neue Technologie, C4NP, geht: SÜSS MicroTec entwickelt und vermarktet hierfür das Equipment (siehe Seite 19). Natürlich analysieren wir genau, wo und in welchem Rahmen eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Bekanntheitsgrad und Größe der Unternehmen oder Institute sind dabei aber nicht die allein entscheidenden Kriterien. Wichtig ist das technologische Know-how des möglichen Partners und das Synergie- und Marktpotenzial für uns.

**Darüber hinaus hat sich SÜSS MicroTec mit Konsortien wie SECAP oder MEMUNITY in den letzten Jahren ein starkes Partnernetz aufgebaut. Werden Sie die Konsortien weiterführen?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Ja, es gibt in den wichtigen SÜSS MicroTec-Märkten Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik keine Alternativen zu Partnern und gleichzeitig Netzwerken wie es SECAP und MEMUNITY sind. Wir werden diese Partnerschaften auch künftig pflegen und intensivieren – und wenn es sinnvoll ist, weitere Partnerschaften in diesen Märkten eingehen. Jüngstes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit IMEC – Europas führendem unabhängigem Forschungszentrum für Mikroelektronik und Nanotechnologie. Mit IMEC erforscht und entwickelt SÜSS MicroTec erstmals neue Device-Bonder-Technologien für die Mikrosystemtechnik.

**Nach SÜSS MicroTec-Equipment für Advanced Packaging bestand im vergangenen Jahr eine besonders rege Nachfrage. Woran liegt das?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Advanced Packaging – die innovative Verbindungstechnologie für Chips – ist und bleibt für uns ein sehr bedeutender Markt. Mittelfristig wird kaum ein Halbleiterunternehmen ohne Advanced Packaging-Verfahren produzieren können, wenn es wettbewerbsfähig bleiben will. Hinzu kommt, dass im Advanced Packaging-Markt die Unternehmen neben 200mm- insbesondere auf die 300mm-Produktion umstellen und so weitere Nachfrage nach neuem Equipment entsteht. Im Advanced Packaging-Markt haben wir uns in jahrelanger intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine sehr starke Marktposition erarbeitet, die wir sichern und weiter ausbauen wollen. So hat unsere Entwicklungsarbeit in den vergangenen Jahren immer wieder neue Technologien für den Advanced Packaging-Prozess, wie beispielsweise „SupraYield“, hervorgebracht.

**Ist die „SupraYield“-Technologie ein zusätzlicher Wachstumstreiber?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** „SupraYield“ ist seit ihrer Markteinführung 2003 bereits von vielen Kunden bestellt worden. Die größte Nachfrage kommt derzeit aus dem Advanced Packaging-Markt. Mit der Fotolithografie-Technologie „SupraYield“ bieten wir dem Kunden maßgebliche Wettbewerbsvorteile im Rahmen der Produktion – etwa eine höhere Durchsatzquote bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Kosten. Das ist eines unserer wesentlichen Assets – die günstigste „Cost of Ownership“.

**Asien entwickelte sich in letzter Zeit zu einem starken Wachstumsmarkt für SÜSS MicroTec. Bleibt das so?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Aus heutiger Sicht hat Asien als Absatzmarkt auch in den kommenden Jahren eine sehr große



## INTERVIEW MIT DEM VORSTAND



Bedeutung für SÜSS MicroTec. Hier haben viele Länder in der jüngsten Vergangenheit einen enormen Wachstumsschub erlebt. Im Halbleiterbereich sind das insbesondere Taiwan und Japan – woher wir im Jahr 2004 eine Vielzahl auch strategisch wichtiger Aufträge erhielten, wie beispielsweise von den „Packaging-Foundries“ Unitive, ASE und XinTec. Da diese Foundries zu den ganz Großen gehören und Technologie-Führer sind, ist es besonders wichtig für uns, sie zu unseren Kunden zu zählen. Künftig wird die Halbleiterbranche sicherlich auch stärker vom Wachstum in China profitieren. Hier sehe ich einen weiteren asiatischen Markt für SÜSS MicroTec.

### Welches Wachstumspotenzial sehen Sie für ihre weiteren Märkte Mikrosystemtechnik, Test & Measurement und Verbindungshalbleiter?

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Die Mikrosystemtechnik ist ein äußerst diversifizierter und interessanter Markt. Die Vielfalt und außerordentliche Leistungsfähigkeit der winzigen Mikrosysteme gewinnt in vielen technischen Bereichen wie der Automobilindustrie, Medizintechnik oder Telekommunikation zunehmend an Bedeutung und Einsatz, weil diese winzigen elektromechanischen Bauteile in immer mehr Bedarfsartikel eingebaut werden (beispielsweise in GPS-Systeme, Reifendrucksensoren). SÜSS MicroTec ist in der Mikrosystemtechnik bereits präsent und gestaltet hier aktuelle und künftige technologische Anwendungen zunehmend mit. So etwa mit unserem „nano-REP“-Verfahren, das die Stabilität von Mikrosystemapplikationen erhöht und die Produktion der sensiblen Bauteile beschleunigt. Insgesamt hat dieses Segment aufgrund der Diversifikation unterschiedlichste Wachstumspotenziale.

Auch für Test & Measurement sehe ich weiterhin großes Potenzial. Die Halbleiterhersteller sind bei zunehmend komplexeren Bauteilen verstärkt auf die Detailanalyse der Chips angewiesen. Nur so kann späteren Fehlern in Endprodukten vorgebeugt werden. Mit oft einzigartigen und kundenspezifischen Entwicklungen haben wir hier unsere Marktposition in den vergangenen Jahren deutlich gestärkt. Daran arbeiten wir auch in Zukunft.

Der Markt für Verbindungshalbleiter stagnierte in den letzten vier Jahren, was insbesondere durch die entstandenen Überkapazitäten in der Hype-Phase um 2000 herum bedingt war. Für die Entwicklung in 2005 bin ich wieder etwas optimistischer. Insbesondere der Markt für Optoelektronik-Equipment belebt sich aktuell, zum Beispiel bei den LEDs.

### Spiegelt sich dieses Wachstumspotenzial bald auch in den Zahlen wider?

**HERR SCHULAK:** Unser Ziel ist klar definiert: SÜSS MicroTec will so schnell wie möglich den Break Even bereits auf Basis eines Umsatzes von 100 Millionen erreichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war hierfür noch ein Umsatz von 120 Millionen Euro notwendig. Dieses Ziel erreichen wir unabhängig von der allgemeinen Branchenentwicklung nur, wenn wir unser technologisches Potenzial in allen Segmenten erfolgreich nutzen und die Effizienz unserer Unternehmensstruktur laufend steigern.

### Was bedeutet das im Detail?

**HERR SCHULAK:** Viele Prozesse im Unternehmen sind technischer Natur, seien es im Bereich Vertrieb die Auftragsklärung oder die klassischen Entwicklungsleistungen. In einem sehr technisch orientierten Umfeld geht oft der Blick für das Wesentliche und Notwendige verloren: Manches stellt keinen Mehrwert für den Kunden dar und manche Dinge werden neu entwickelt, obwohl eine fertige Lösung für das Problem im Hause bereits existiert. In vielen Bereichen der Organisation müssen wir kritisch hinterfragen, welches Standardisierungs- und damit Kostensenkungspotenzial vorhanden ist. Dass dieses erheblich ist, zeigt beispielhaft die im Herbst 2004 durchgeführte Potenzialanalyse für unsere Standorte Garching, Aßlar und Vaihingen. Hier wurde offensichtlich, dass allein durch die Einführung gleicher Baugruppen bei verschiedenen Produkten ein erhebliches Einsparungspotenzial gehoben und die Produktionseffizienz deutlich gesteigert werden kann.

**Planen Sie auch weitere Restrukturierungen?**

**HERR SCHULAK:** Reduzierung der Kosten ist ein wichtiges Thema. Mit der Schließung unseres Werkes in Aßlar werden wir einen großen Beitrag zur Kosteneffizienz in der Unternehmensgruppe leisten. Weiter stehen Bereiche wie Einkauf, Entwicklung und Vertriebsadministration in unserem Fokus, da wir auch hier erkennbare Reserven sehen.

**Könnten Sie sich auch eine Straffung des Produktportfolios vorstellen?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Grundsätzlich muss man das Produktportfolio laufend auf Zukunftsfähigkeit und Profitabilität hin überwachen. Unsere verschiedenen Produktlinien bedienen die von uns adressierten Märkte derzeit sehr gut und ergänzen sich sinnvoll. Nur so konnten wir bisher in unseren Märkten mit Qualität und Innovationen überzeugen und werden das auch in Zukunft tun.

**Welche Bedeutung hat künftig der Bereich Forschung & Entwicklung für SÜSS MicroTec?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Forschung und Entwicklung (F&E) ist für ein Technologie-Unternehmen wie SÜSS MicroTec immer von größter Bedeutung. Nur mit einem starken F&E-Team ist ein interessanter Produkt-Mix, wie wir ihn haben, überhaupt möglich. Wir müssen äußerst zukunftsorientiert arbeiten und neue Technologie-Trends in der F&E-Abteilung nahezu vorhersehen. Zielgerichtete Forschung und Entwicklung treibt die Produktentwicklungen voran und erhält den Wettbewerbsvorsprung.

**Wie schätzen Sie die Entwicklung der Halbleiterbranche in 2005 ein?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Das ist eine schwierige Frage – die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass seriöse Prognosen immer schwieriger werden. Dies zeigt sich auch in den sehr unterschiedlichen Prognosen der verschiedenen Research- und Marktforschungsinstitute sowie von Banken und Investmenthäusern. Momentan könnte man diese folgendermaßen zusammenfassen: Der überwiegende Teil geht von einer leichten Abschwächung der Halbleiterbranche im ersten Halbjahr 2005 und einer anschließenden Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Leider fehlt uns die berühmte Glaskugel, mit der man die Zukunft weissagen kann. Insofern bleibt uns nur, uns an Faktoren wie Kundenanfragen und Auftragseingang zu orientieren. Die



sehen momentan zufriedenstellend aus. SÜSS MicroTec ist bekanntermaßen etwas spätzyklisch, das heißt, dass wir in 2004 am Aufschwung der Halbleiterindustrie nur teilweise partizipiert haben. Folglich gehen wir davon aus, dass wir in den ersten sechs Monaten 2005 keine wesentliche Geschäftsabschwächung sehen werden. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmals betonen, dass dies aktuelle Annahmen sind, die in ein paar Wochen auch schon überholt sein können.

**Werden sich die Markterwartungen auch auf den SÜSS MicroTec-Aktienkurs auswirken?**

**HERR SCHULAK:** Den Aktienpreis bestimmt der Markt – hier ist das Angebot-und-Nachfrage-Prinzip offensichtlich. Aus meiner Sicht bietet sich ein Potenzial für eine positive Kursentwicklung und wir werden unsere aktive Investor Relations-Arbeit weiter fortsetzen. Natürlich beeinflussen auch das allgemeine Klima an den Welt-Börsen und vor allem die Stimmung im Halbleitersegment den Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie.

**Was ist ihr Ziel für die SÜSS MicroTec-Gruppe in den kommenden Jahren?**

**HERR DR. SCHNEIDEWIND:** Primär profitables Wachstum in allen Geschäftsfeldern. SÜSS MicroTec muss weltweit in der Lage sein, positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Hierbei werden sicherlich Kostenreduzierungsprogramme eine große Rolle spielen – auf der anderen Seite aber auch unsere Marktposition. Mit der vorhin schon angesprochenen F&E-Arbeit müssen wir vor allem am Puls der Zeit sein, heute bereits Technologien von morgen entwickeln und so unsere Umsätze generieren.





++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++

++++++

# INNOVATIONSKRAFT IM FOKUS

++++++

++++++  
++++++  
++++++  
++++++

++++++  
++++++



>> Fortschrittliche Verbindungstechnologien für Chips und Mikrosysteme ermöglichen uns schon heute eine intelligente, vernetzte Umgebung: Technische Innovationen machen unser Leben in vieler Hinsicht einfacher und sicherer. Das Potenzial für zukünftige Entwicklungen liegt in der „Technologie hinter der Technologie“ – der vielschichtigen Hightech, in der sich SÜSS MicroTec bewegt. Unser Blickpunkt ist darauf gerichtet, die Lösungen von morgen zu entwickeln, so dass unsere Kunden von diesen neuen Technologien profitieren können. <<

Dr. Ralf Süß, Manager Produktentwicklung SMTL

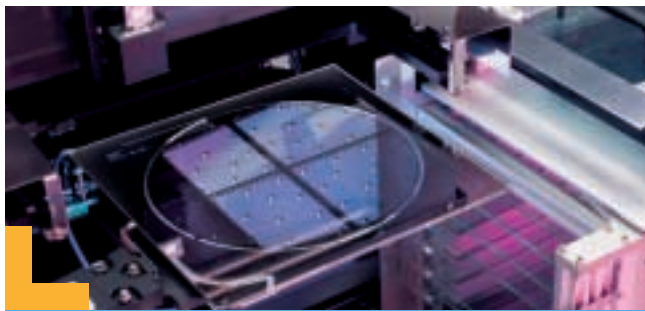


## HIGHLIGHTS 2004

### ZWEITES QUARTAL

#### Computerchips bei -269°C auf dem Prüfstand

Führende Halbleiterhersteller nutzen verstärkt den hochspeziellen „Cryogenic Prober PAC 200/300“: Als Kunden konnten wir einen der größten Chipproduzenten in den USA gewinnen. Er setzt den SÜSS MicroTec-Prober für den Test neuer Materialien im 300mm-Bereich ein, die künftig in den Chips von Supercomputern Platz finden. Der Cryogenic Prober bietet Testmöglichkeiten für Extreme: Er testet bei bis zu -269°C. Die tiefe Temperatur ist nötig, um in den neuartigen Chips so genannte Leckströme besser identifizieren und analysieren zu können und somit Designverbesserungen zu ermöglichen.



### ERSTES QUARTAL

#### Neue Zeitrechnung für Produktionstests

Die Produktlinie Prober wird um eine bedeutende Entwicklung erweitert. Das neue Cluster-Probe-System (CPS) verkürzt die analytischen Tests, da es während der Produktion Mikrochips schneller, effektiver und vielfältiger testet. Dieses neue Prober-System von SÜSS MicroTec ist besonders für die Märkte Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter von großem Vorteil. Denn hier waren Tests bislang sehr zeitintensiv und die Produktionsphasen dadurch lang und teuer.

#### Autoindustrie setzt auf SÜSS MicroTec-Produkte

SÜSS MicroTec-Produkte sorgen zunehmend für sichere Autos. Europas größter Mikrosystemhersteller für die weltweite Automobilindustrie, die Infineon-Tochter SensoNor, bezieht ihr Equipment von SÜSS MicroTec. Besonders überzeugte das Unternehmen die „Cost of Ownership“ der SÜSS MicroTec-Produkte (Mask Aligner und Substrat Bonder). Diese werden jetzt in der Volumenproduktion von Reifendrucksensoren eingesetzt. Die Automobilindustrie ist der zweitwichtigste Bereich im Markt Mikrosystemtechnik und wird weiterhin stark wachsen.

#### Bonding-Prozesse werden flexibler

SÜSS MicroTec und das Forschungszentrum IMEC entwickeln gemeinsam neue Device Bonder-Technologien für die Mikrosystemtechnik. IMEC ist Europas führendes unabhängiges Forschungszentrum für Mikroelektronik und Nanotechnologie mit Sitz in Belgien. Bislang können die Device Bonder erst nach der eigentlichen Chipproduktion eingesetzt werden – und dort die aus dem Wafer herausgesägten Bauteile mit dem Endprodukt verbinden. SÜSS MicroTec und IMEC wollen Device Bonder bereits auf Wafer-Ebene einsatzbereit machen und dort die Verbindung von Mikrosystemen ermöglichen. Damit wird der Device Bonder flexibler und erhält neue Einsatzmöglichkeiten.



++++++  
 ++++++  
 ++++++

## VIERTES QUARTAL

### Optimales Licht mit SÜSS MicroTec-Technologie

Immer mehr LEDs werden mit Hilfe von SÜSS MicroTec-Maschinen gefertigt. Die weltweit größten Unternehmen der Optoelektronik-Branche setzen weiter und verstärkt auf unser Equipment. So orderte OSRAM im vierten Quartal erneut die Systemlösung „LithoFab200“ OSRAM nutzt den LithoFab200 für die Massenproduktion von LEDs und vertraut aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen weiter auf SÜSS MicroTec-Produkte.



## DRITTES QUARTAL

### SÜSS MicroTec und IBM schließen Technologie-Abkommen

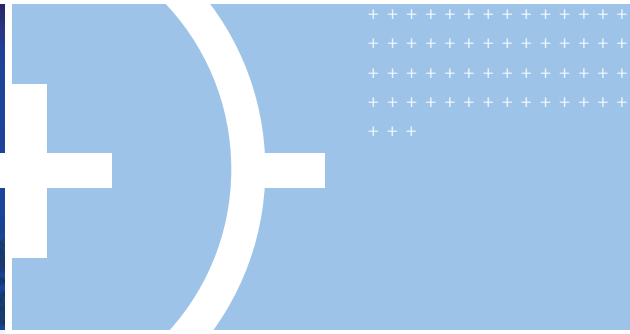
Technologie und Umwelt schienen bislang nur schwer vereinbar. SÜSS MicroTec entwickelt für IBM das technische Equipment für eine umweltfreundliche – weil bleifreie – Lösung bei der Flip-Chip-Verbindung (Packaging). Basis dafür ist IBMs patentierte C4NP-Packaging-Technologie. C4NP vereint als technische Lösung 100 %ige Bleifreiheit, hohe Zuverlässigkeit, so genannte Fine-Pitch-Fähigkeit, geringen Materialeinsatz, niedrigere Fertigungskosten und höchste Flexibilität. In der Halbleiterbranche ist die Kombination dieser Eigenschaften in einer Prozesslösung bislang einmalig.

Im Rahmen der Kooperation entwickelt SÜSS MicroTec das Equipment für eine komplette C4NP-Produktionslinie, die dem Markt dann als eigenständige Linie angeboten und vermarktet wird. Unter anderem überzeugte IBM die „Cost of Ownership“ der SÜSS MicroTec-Produkte, unsere bereits vorhandenen Produkte und Technologien und unser Know-how im Advanced Packaging-Markt. Die Finanzierung für das Projekt übernimmt die IBM Deutschland Kreditbank GmbH.

Für SÜSS MicroTec ist das Abkommen mit IBM ein wichtiger Meilenstein: Die erfolgreiche Entwicklung des C4NP-Equipments eröffnet uns eine einzigartige Marktposition und Wachstumspotenzial. Weitere Informationen zu dem Abkommen mit IBM geben wir Ihnen auf Seite 18 (Kapitel Der Advanced Packaging Markt).

### Service & Support überzeugen Kunden

SÜSS MicroTec erhielt zum elften Mal in Folge Spitzennoten für seine Kundenorientierung. Das zeigen die Ergebnisse der VLSI-Research-Befragung 2004. Das namhafte, auf die Halbleiterbranche spezialisierte Marktforschungsinstitut VLSI Research bewertet seit 1993 den Kundenservice von Equipment-Lieferanten. SÜSS MicroTec zählt damit seit Beginn der VLSI-Datenerhebung zu dem Unternehmen der Halbleiterbranche mit den zufriedensten Kunden. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie unter <http://www.vlsiresearch.com>.



CLUSTER-SYSTEM LITHOPACK300

## GESCHÄFTSFELDER

### DAS SÜSS MicroTEC-EQUIPMENT

#### SPIN COATER:

Der Spin Coater (Beschichtungsgerät) verteilt einen im Zentrum eines Wafers aufgetragenen flüssigen, fotoempfindlichen Lack durch schnelle Rotation über den Wafer. Das von SÜSS MicroTec patentierte GYRSET-Verfahren ermöglicht eine besonders gleichmäßige und kostensparende Erzeugung von besonders dicken (> 50 Mikrometer) Schichten auf dem Wafer. Diese fotoempfindliche Schicht ist mit dem lichtempfindlichen Film in einer Kamera vergleichbar, der dann, wenn man den Auslöser betätigt, ebenfalls belichtet wird.

#### MASK ALIGNER:

Der Mask Aligner (Belichtungsgerät) richtet eine Glasmasken submikrometer genau zum Wafer aus, auf der das mikroskopische Bild einer Schaltungsebene des Chips gespeichert ist. Durch Belichtung mit ultraviolettem Licht wird dann das Bild der Maske im Abbildungsverhältnis 1:1 fotolithografisch auf den mit Fotolack beschichteten Wafer übertragen. Das ultraviolette Licht führt zu einer Veränderung der molekularen Struktur in dem Fotolack, so dass die Bereiche, die dem UV-Licht ausgesetzt waren, im nachfolgenden Entwicklungsschritt mittels einer Entwicklerflüssigkeit chemisch aufgelöst werden können. Die so übertragenen Strukturen variieren in ihrer „Größe“ von unter einem bis zu 50 Mikrometer (zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist rund 50 Mikrometer dick).

#### DEVELOPER:

Der Developer (Entwicklungsgerät) löst mit Hilfe von Chemikalien das zuvor vom Mask Aligner erzeugte Abbild der Maskenstruktur aus der fotoempfindlichen Schicht auf dem Wafer heraus. Je nach Dicke der Fotolackschicht wird somit ein dreidimensionales Bild als Struktur auf dem Wafer erzeugt. Dieser Prozessschritt ist vergleichbar mit der Entwicklung eines Negativs, wobei ebenfalls die unterschiedlich belichteten Flächen eines Fotos durch chemische Behandlung in Erscheinung treten.

#### BONDER:

Ein Bonder (Gerät zum flächigen Verbinden von Wafern) verbindet zwei oder mehrere äußerst präzise zueinander ausgerichtete Wafer durch Löten, Kleben oder ein anderes physikalisch-chemisches Verfahren miteinander. Zusammen mit verschiedenen Ätz- und Belichtungsprozessen können mit Hilfe des Wafer-Bondens zwei- bis dreidimensionale Strukturen gefertigt werden. Es haben sich verschiedene Bonding-Verfahren im Markt etabliert, die je nach Wafer-Material unterschiedlichste Prozessbedingungen erfordern.

#### PROBER:

Der Prober (Prüfgerät) führt individuelle analytische Tests von Mikrochips auf Wafern durch. Mit Hilfe von Messspitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden und weisen frühzeitig auf Fehler hin.

## DER ADVANCED PACKAGING-MARKT

### HIGHTECH NACH MASS

Einer der beiden wichtigsten Hauptmärkte von SÜSS MicroTec führt in den Bereich der Chip-Verbindungstechnologie. Der Begriff Advanced Packaging – er steht für „Neue Verbindungstechnik“ – definiert den Markt und das Fertigungsverfahren zugleich. Advanced Packaging ist eine Verbindungstechnik für Halbleiter, mit der die Chips platzsparend und direkt, mit hoher Anschlussdichte auf das Substrat aufgebracht werden. Dieses Substrat ist die so genannte Platine – und damit der Bereich, der das „Herz“ unserer technischen Produkte abbildet: Je höher die Anschlussdichte der Chips, desto leistungsfähiger und hochwertiger ist das Endprodukt – beispielsweise unser Handy, unser Laptop oder unser PDA.

Das Advanced Packaging Verfahren kommt zum Einsatz, wenn die eigentliche Chipproduktion bereits abgeschlossen ist. Der Wafer, auf dem sich über tausend Chips befinden können, hat während mehrer Wochen bis zu 250 Fertigungsschritte durchlaufen und aufgrund dieser hohen Wertschöpfung bereits einen Wert von gegebenenfalls vielen Tausend Euro. Daher muss das SÜSS MicroTec-Equipment, das jetzt zum Einsatz kommt, sehr präzise und zuverlässig arbeiten – das heißt mit einem sehr hohen Yield beziehungsweise einer äußerst geringen Fehlerquote. Nur so spart Advanced Packaging unseren Kunden Produktionszeit und damit Geld.

SÜSS MicroTec hat sich mit seinem Equipment eine weltweit führende Position im Advanced Packaging-Markt gesichert – und diese 2004 weiter ausgebaut. Gefragt war 2004 zunehmend vollautomatisches Equipment für den 300mm-Bereich. Die Bestellungen für Advanced Packaging verteilten sich dabei auf fast alle Produktlinien von SÜSS MicroTec: Mask Aligner, Spin Coater und Developer, Device Bonder und Prober.

Entweder bestellten Kunden einzelne Geräte oder orderten direkt SÜSS MicroTec-Systemlösungen, in denen verschiedene Prozessschritte und damit mehrere SÜSS MicroTec-Produkte integriert sind (etwa LithoPack 300). Unter den Kunden sind Big Player der Halbleiterbranche – ob so genannte Packaging-Dienstleister (Foundries) oder auch Chipproduzenten.

Für alle SÜSS MicroTec-Kunden ist bei der Produktwahl stets ein Kriterium von größter Bedeutung: die Wirtschaftlichkeit des Equipments unter Berücksichtigung von Anschaffungskosten, Kosten für den Reinraum sowie Betriebs-, Verbrauchs- und Wartungskosten – kurz als „Cost of Ownership“ (CoO) zusammengefasst. Besonders bei der Massenfertigung von Mikrochips, wie beim Advanced Packaging, entscheidet die „Cost of Ownership“ letztlich darüber, wie erfolgreich Halbleiterhersteller die technologischen Herausforderungen meistern und sich im harten internationalen Wettbewerb behaupten können.

SÜSS MicroTec hat sein Equipment am jeweiligen Bedarf seiner Kunden ausgerichtet. Alle SÜSS MicroTec-Produkte für Advanced Packaging bieten jedem einzelnen Kunden eine herausragende „Cost of Ownership“. Darüber hinaus setzt SÜSS MicroTec weitere neue Standards für das Advanced Packaging-Verfahren. Ein Beispiel dafür ist „SupraYield“, die Fotolithografie-Technologie, mit der die Kostenreduktion in der Produktion – konkret beim Standardverfahren der Belichtung – weiter vorangetrieben wird.



## GESCHÄFTSFELDER

Beim Blick auf die Endprodukte lässt sich erahnen, welchen technischen Herausforderungen sich Halbleiterunternehmen heute stellen müssen. Ein zentrales Beispiel bleibt das Handy: Inzwischen gehört die Handykamera schon zur Grundausstattung unserer mobilen Telefone. Bei Aufnahmen mit den ersten Fotohandys freuten wir uns, wenn das Motiv überhaupt grob erkennbar war. Heute schon haben Handykameras nahezu den Standard „traditioneller“ Fotoapparate. Es ist absehbar, dass es dabei nicht bleibt. Auf mittlere Sicht werden Handykameras die Qualität digitaler Kameras erreichen – dank innovativer Technologien wie Advanced Packaging. Weitere aktuelle und auch künftig bedeutende Einsatzbereiche des Advanced Packaging finden sich bei Grafikchips für Endprodukte wie der Playstation® oder der X-Box®. Die Integration von passiven Bauelementen auf Wafer- oder Modulebene ist eine weitere aktuelle Anforderung an das Advanced Packaging.

Der Erfolg von SÜSS MicroTec ist neben der eigenen intensiven Forschung und Entwicklung auf die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zurückzuführen. Im Partnernetzwerk nimmt seit rund vier Jahren das Semiconductor Equipment Consortium for Advanced Packaging (SECAP) eine bedeutende Position ein. Gemeinsam mit SECAP setzt SÜSS MicroTec neue Meilensteine im Advanced Packaging-Bereich. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung und der Betrieb einer kompletten 300mm-Advanced Packaging-Produktionslinie bei Unitive, einer führenden Packaging Foundry mit Sitz in Taiwan. Durch die Partnerschaft mit SECAP kann SÜSS MicroTec in der Praxis das „Zusammenspiel“ von eigenen Geräten mit Partner-Equipment im Prozessablauf testen, kontrollieren, optimieren und letztlich für den Kunden perfektionieren.

Das qualitativ hochwertige und innovative SÜSS MicroTec-Equipment überzeugte auch den weltweit führenden Halbleiterhersteller IBM – und führte im Jahr 2004 zum Start einer ganz besonderen Kooperation für Advanced Packaging. In einem Technologie-Abkommen definieren SÜSS MicroTec und IBM neue Wege bei Chipverbindungen und gestalten jetzt gemeinsam technologische Zukunft. Basis dafür ist die patentierte C4NP-Packaging-Technologie von IBM (Controlled Collapse Chip Connection New Process). Einzigartig ist C4NP, weil durch niedrige Materialkosten die Prozesskosten für Wafer-Bumping, dem wesentlichen Fertigungsschritt beim Advanced Packaging-Verfahren, weiter gesenkt und dieser Prozessschritt erstmals zu 100 Prozent bleifrei durchgeführt werden kann. Bisher wird C4NP nur in der Forschung eingesetzt. In naher Zukunft soll der C4NP-Prozess dem gesamten Markt zur Verfügung stehen. SÜSS MicroTec entwickelt deshalb im Rahmen der Kooperation das Equipment für eine komplette C4NP-Produktionslinie. Dabei kann SÜSS MicroTec zum Großteil auf die bisherigen Kerntechnologien von Mask Aligner, Device Bonder und Prober zurückgreifen und diese für die Integration von C4NP weiterentwickeln. Hier verfügt SÜSS MicroTec über hochentwickelte, ausgereifte Kerntechnologien – dank der Konzentration auf unsere Kernkompetenzen. Die Kooperation mit IBM unterstreicht SÜSS MicroTec's besondere Position im Advanced Packaging-Markt und erweitert die Möglichkeiten, diesen Zukunftsmarkt verstärkt mitzugestalten. Für uns Endverbraucher bedeutet das noch leistungsfähigere, günstigere und dann auch umweltfreundlichere elektronische Geräte.



## DER MIKROSYSTEMTECHNIK-MARKT

### UNSIHTBARE KRÄFTE

Die Mikrosystemtechnik (MEMS) versetzt uns in die Welt der modernen „Heinzelmännchen“. Dynamisch, leistungsstark und in unglaublicher Vielfalt wirken hier unsichtbare Kräfte. Unserem bloßen Auge bleiben die Mikrowelten verschlossen. Entspricht doch ein Mikrometer gerade einem Tausendstel Millimeter. Erst durch den Einsatz von Mikrosystemen entstehende Effekte sind für uns wieder sichtbar. Denn täglich bewegen wir uns mit und zwischen Mikrosystemen. Besonders im Auto und im Bereich Consumer Electronics sind wir von den winzigen Systemen umgeben. Im Auto sorgen Mikrosystemtechniken etwa in Sensoren für Sicherheit und Komfort. Heutige Standards wie Navigations- und Antiblockiersystem oder Air Bags sind nur durch den Einsatz von Mikrosystemen möglich. Sie leisten vielfältigste wichtige Aufgaben auf engstem Raum.

Ein ganz anderes Beispiel lässt uns die Bandbreite von Anwendungsbereichen für Mikrosystemtechnik langsam erahnen. So ist im Bereich Consumer Electronics der Videoprojektor (Beamer) „Lebensraum“ von Mikrosystemen. Im Büro zählt der Beamer mittlerweile zur Grundausstattung, zu Hause ersetzt er zunehmend den Fernseher. Über die Qualität der Beamer-Wiedergabe entscheiden erneut Mikrosysteme. In unzähligen beweglichen Minispiegeln im Projektordisplay des Beamers erbringen sie technische Höchstleistung für glasklare Bilder.

Nur größte Präzision bei der Fertigung garantiert später die einzigartige Leistung und Vielfalt von Mikrosystemen.

Neben Advanced Packaging ist Mikrosystemtechnik der wichtigste Markt von SÜSS MicroTec. SÜSS MicroTec bietet seit Jahren das mit Abstand umfassendste Equipment zur Herstellung von MEMS-Bausteinen. Alle Produktlinien kommen im Herstellungsprozess für Mikrosystemtechnik zum Einsatz. Besonders Mask Aligner und Bonder von SÜSS MicroTec gehören bei den Mikrosystemherstellern bereits zum Standardequipment. Eine große Nachfrage bestand 2004 auch nach Coatern (Spray Coater), die im Vergleich zur Standardmethode die Wafer per Sprühverfahren beschichten. Mit diesem zum Patent angemeldeten SÜSS MicroTec-Verfahren werden so selbst kleinste oder dreidimensionale Strukturen noch mit einer Lackschicht überzogen. Weiterhin wurden SÜSS MicroTec-Bonder im abgelaufenen Geschäftsjahr verstärkt bestellt. Besonders der Substrat Bonder ist im Bereich MEMS zunehmend gefragt. Mit seiner äußersten Präzision und Positioniergenauigkeit bewirkt er bereits auf Wafer-Ebene die exakte Verbindung der kleinsten und hochsensiblen Mikrosysteme – selbst bei höheren Produktionsvolumina.

Im Unterschied zum Advanced Packaging werden bei der MEMS-Produktion noch überwiegend manuelle oder halbautomatische Maschinen eingesetzt. Nur bei wenigen Produkten –





## GESCHÄFTSFELDER

etwa den genannten Beispielen Auto und Consumer Electronics – erfolgt bereits eine Massenherstellung. Für hohe Produktionsvolumina bestellen Unternehmen wie die Infineon-Tochter SensoNor ihr Equipment bei SÜSS MicroTec. Ein weiterer Kundenkreis sind international namhafte Forschungs- und Entwicklungszentren wie die Fraunhofer Institute, die mit Hilfe von SÜSS MicroTec-Maschinen die Entwicklung und Fertigung von MEMS-Bauteilen vorantreiben. Damit die individuellen Forschungsschritte direkt auf die Produktionsebene übertragen werden können, arbeitet SÜSS MicroTec mit seinen Kunden „Hand in Hand“. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sind oft wegweisend, wie das Verfahren „nanoPREP“ zeigt, das SÜSS MicroTec in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut entwickelt hat.

Für eine übergreifende Kooperation im Markt Mikrosystemtechnik besteht auf Initiative von SÜSS MicroTec seit 2003 zudem das weltweit erste Test-Forum MEMUNITY (The MEMS Test Community). Zielsetzung von MEMUNITY ist die Entwicklung von Testverfahren vor und während der Mikrosystemproduktion. Dadurch kann die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Miniwelten bereits vor dem Herstellungsprozess erprobt werden. Mikrosystemherstellern bringt das eine Kostenersparnis für die Produktion von bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig können in dem Forum neue Produktionsstandards für Mikrosysteme vorangetrieben werden.

Die permanente Verfeinerung von Fertigungsverfahren sowie Initiativen wie MEMUNITY ermöglichen letztlich die raschere Umsetzung von MEMS-Entwicklungen für eine breitere Zielgruppe. Darunter sind Entwicklungen für die verschiedensten Bereiche wie die Computerindustrie, Humanmedizin und Umweltanalyse. Aber auch für Haushalt, Telekommunikation oder Sportartikel kündigen sich neue Applikationen an. Beim Sport tragen wir möglicherweise demnächst intelligente Sportschuhe, die durch Sensoren mit unserer Gangart und Kondition „Schritt halten“ und uns per Signal darauf aufmerksam machen, wenn der Körper eine Ruhepause wünscht. In der Telekommunikation bewahren uns Mikrosysteme in Zukunft vor laut klingelnden Handys im Kino, in der Oper oder in Besprechungen. Denn mit Hilfe intelligenter Mikrosysteme nehmen Handys dann ihre Umgebung wahr, passen ihr Signal dieser an oder schalten sich sogar automatisch ganz aus – auch wenn das für uns noch wie Zukunftsmusik „klingelt“.

## DER VERBINDUNGSHALBLEITER-MARKT

### KLARE SICHT DANK LEDs

Vor rund 120 Jahren revolutionierte die Glühbirne von Edison unsere Umgebung. Heute führt die Leuchtdiode zu einschneidenden Veränderungen in der Beleuchtungswelt. Die „Nachfolgerin“ der Glühbirne basiert auf den optoelektronischen Eigenschaften von Verbindungshalbleitern (Compound Semiconductor), die den elektrischen Strom mit sehr hoher Effizienz in Licht umwandeln. Im Jahr 2004 profitierte der SÜSS MicroTec-Markt Verbindungshalbleiter besonders von der starken Nachfrage nach Leuchtdioden (LEDs – Light Emitting Diodes). Denn immer sichtbarer werden die Vorteile und immer vielseitiger die Einsatzbereiche von LEDs. Zu den vielen Vorzügen von LEDs gehört, dass sie klein, kompakt, stabil, effizient und von hoher Lebensdauer sind. In Kombination mit ihrer deutlich höheren Lichtausbeute und Farbvielfalt im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren begleiten uns LEDs inzwischen durch Tag und Nacht. Wir begegnen ihnen in ihrem heute schon traditionellen Einsatzgebiet, dem Auto – in Bremslichtern, Rückleuchten und als Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum. In der neuen Generation technischer Endprodukte bringen LEDs verstärkt Handys die „Erleuchtung“ – im Display, der Tastatur oder für das Kamerablitzlicht. Im Fußballstadion sorgen LEDs auf den Großbildschirmen für klare Signale und auch in Flachbildschirmen bringen sie uns immer öfter sichtbar strahlende Farben in neuer Qualität. Spezielle Einsatzbereiche für LEDs ergeben sich auch aufgrund ihrer UV-freien Strahlung und ihrer geringen Wärmeerzeugung: Dank der niedrigen Betriebsspannung können LEDs selbst in einem feuchten oder nassen Umfeld sicher eingesetzt werden.

Die Lichtausbeute und Lebensdauer von LEDs wird weiter optimiert. Eine Qualitätssteigerung ist durch stetig verbesserte Herstellungsverfahren möglich. SÜSS MicroTec ist im Rahmen der Herstellung von LEDs mit allen Produktlinien vertreten. Wichtigster Prozessschritt ist hierbei die Fotolithografie, entsprechend stark nachgefragt sind die Mask Aligner-Produkte von SÜSS MicroTec. Zunehmend greifen die Kunden aber auch auf integrierte Systemlösungen zurück. Mit der Integration von Spin Coater, Mask Aligner und Developer in ein so genanntes Cluster deckt der Kunde drei wesentliche Prozesse bei der Herstellung von LEDs ab – und kann so seine Produktionskosten signifikant senken.

Für die Produktion extrem leistungsfähiger LEDs – etwa für den Einsatz in großen Bildschirmen oder in anspruchsvollen automobilen Applikationen – sind auch im Markt Verbindungshalbleiter verstärkt die Substrat Bonder von SÜSS MicroTec im Einsatz. Ihre hohe Flexibilität ist besonders gefragt, wenn LED-Komponenten mit internen Spiegelflächen versehen werden, um die Lichtausbeute weiter zu steigern. Dank dieses Verfahrens wird alles Licht, das von einem LED ausgeht, in eine Richtung – nach außen – gerichtet; statt nach innen, wo es nutzlos reabsorbiert würde.





## GESCHÄFTSFELDER

Mit steigender Bedeutung und höheren Produktionsvolumina von LEDs gewinnt die Qualitätskontrolle an Bedeutung. Halbleiterunternehmen setzen deshalb als Standardequipment inzwischen Testgeräte zur Prozessanalyse und -überwachung im Rahmen der LED-Herstellung ein. SÜSS MicroTec hat diesen Zukunftsmarkt erkannt, das spezielle Testprodukt „Cluster Probe System“ auch für LED-Tests entwickelt und sich hiermit schon jetzt die führende Position in seinem Marktsegment Verbindungshalbleiter gesichert (siehe Kapitel: Der Test & Measurement Markt).

Die zunehmende Bedeutung von LEDs hat das Wachstum von SÜSS MicroTec im Markt Verbindungshalbleiter klar vorangetrieben. Dazu kommt: durch den verstärkten Einsatz von SÜSS MicroTec-Equipment in diesem Markt gestaltet das Garchingener Unternehmen die aktuelle und künftige LED-Entwicklung inzwischen zunehmend mit. Erwartet wird, dass LEDs die Beleuchtungstechnik in allen Bereichen in ähnlicher Weise beeinflussen und „umformen“, wie es die Halbleitertechnologie bereits im Bereich Elektronik vorgeführt hat. Im Bereich LED-Bauelemente wird in den nächsten sieben Jahren von einem durchschnittlichen Wachstum von über zehn Prozent ausgegangen.

## DER TEST & MEASUREMENT-MARKT

### CHIPS MIT GARANTIE

Mit Test & Measurement fokussiert SÜSS MicroTec ein besonderes Marktsegment. Hier steht nicht die Produktion, sondern die Analyse von Bauteilen im Blickpunkt. Bei Test & Measurement (Testen und Prüfen) wird das elektrische Verhalten von Bauteilen auf einem Chip analysiert und bewertet – in Forschung, Entwicklung und bei der Produktion. Für diese individuellen analytischen Aufgaben hat SÜSS MicroTec die Produktlinie Prober entwickelt. Keine andere Produktlinie von SÜSS MicroTec ist so stark diversifiziert: für rund 15 manuelle, halb- oder vollautomatische Prober gibt es rund 1.000 Zubehörteile wie Prüfköpfe, Messkabel oder Mikroskope – und diese Zahl steigt. Je ausgefeilter und komplexer die Chipherstellung wird, desto individuellere Tests sind gefordert. Nur analytische Tests (zum Beispiel Fehleranalyse oder Lebensdauertests) garantieren uns letztlich einwandfreie Endprodukte. Prober werden deshalb in allen Produktionsmärkten eingesetzt. Besonders wichtige Analysebereiche sind der allgemeine Halbleitermarkt, die Hochfrequenztechnik, Mikrosystemtechnik und Optoelektronik. Wie hochspeziell, individuell und flexibel die „Tester“ in diesen Märkten arbeiten, zeigt sich etwa am Prober-System „Cluster Probe System“.

SÜSS MicroTec entwickelte das 2004 im Markt eingeführte Cluster Probe System speziell für Produktionstests von Mikrochips für Märkte wie die Optoelektronik und die Mikrosystemtechnik. Ziel war, die sehr langwierigen Tests in diesen sensiblen Bereichen bei gleicher Qualität zu straffen – und dadurch die Produktionsphasen zu beschleunigen. Dafür konzipierte SÜSS MicroTec das Cluster Probe System, basierend auf dem bewährten Clusterkonzept, das bereits beim sonstigen Produk-





tionsequipment von SÜSS MicroTec verwendet wird: Bis zu sechs Prober werden um einen zentralen PC und eine Ladestation zusammengebaut. Dieses Konzept spart Platz – ein sehr teures Gut in Reinräumen – und, da alle Prober parallel arbeiten, spart diese Herangehensweise auch Zeit. Jeder einzelne Prober des Clusters kann, je nach Anforderung, unterschiedlichst konfiguriert werden und somit Tests unter Hitze, mit Strom oder Luftdruck durchführen oder auch die Lichtintensität von Leuchtdioden analysieren.

Neben den beschriebenen Funktionstests werden SÜSS MicroTec-Prober auch für die Chipcharakterisierung, Fehleranalyse und für Zuverlässigkeitstests eingesetzt. Alle Testbereiche gewinnen zunehmend an Bedeutung – und alle stellen die gleichen hohen Anforderungen an die Entwicklungen von SÜSS MicroTec: Tests müssen immer schneller, kostensparender, individueller und gleichzeitig präziser ablaufen. Für uns Endnutzer lässt sich das im Hightech-Kosmos noch am ehesten beim Blick in den PC nachvollziehen: Anfang der neunziger Jahre fanden sich hier noch unter 4 Millionen Transistoren. Heute sind es schon um die 50 Millionen Transistoren, die unserem PC zur aktuellen Leistungsfähigkeit verhelfen. Und künftig sollen 400 Millionen Transistoren und mehr in unserem Computer Platz finden – obwohl er immer kleiner wird. Die Optimierung von Test- und Produktionsverfahren muss deshalb im Einklang verlaufen – mit einem „kleinen Vorsprung“ für das Testequipment. Nur dann können Halbleiterhersteller die Roadmap einhalten.

Deutlich wird das wiederum am Beispiel PC: Für eine einwandfreie PC-Funktionalität müssen Zuverlässigkeitstests durchgeführt werden. Bislang fanden diese nacheinander an den Hunderten von Chips statt oder nach dem Vereinzeln und Verkapseln der Bauelemente. Die Tests dauerten folglich pro Wafer bis zu 300 Stunden. Erst durch neue Prober-Entwicklungen reduziert sich die Testzeit jetzt von Wochen auf Stunden. So analysiert ein neuer manueller SÜSS MicroTec-Prober bereits auf Wafer-Ebene viele winzige Teststrukturen gleichzeitig. Diese Analysemethode ist weltweit ein absolutes Novum. Kunden profitieren davon in doppelter Hinsicht: die Testdurchläufe sind erheblich schneller, die Produktionskosten deutlich geringer.

Die Beispiele zeigen, wie individuell die intelligenten Testlösungen sind. Jeder Prober wird für jede einzelne Analyse kundenspezifisch ausgestattet. Nur so sind 100 Prozent genaue Messergebnisse überhaupt erst möglich. Die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden ist deshalb integraler Bestandteil des Marktes Test & Measurement und wichtiger Baustein des Prober-Erfolgskonzeptes von SÜSS MicroTec. Mit seinem Angebot an Probern stärkte SÜSS MicroTec seinen Markt Test & Measurement 2004 nachhaltig.

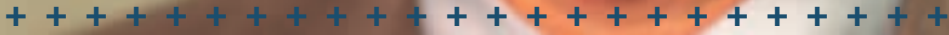


>> Für uns steht der individuelle Kundenwunsch im Fokus. So entspricht jede Maschine, die unseren Produktionsprozess verlässt, dem jeweiligen Kundenbedürfnis und ist nicht selten ein Unikat. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam: Sie müssen hochgenau arbeiten; denn nur so optimieren sie die Produktionsprozesse und verbessern Qualität und Funktion der Produkte unserer Kunden. Mit ihrer herausragenden Präzision sind unsere Produkte in ihrem Segment weltweit führend – und bei nahezu allen namhaften Herstellern und Dienstleistern der Halbleiterbranche installiert. <<

+ + +

Stefan Daub-Klose, Produktionsleiter SMTL





# PRÄZISION IM FOKUS





## DIE AKTIE

### SÜSS MicroTEC-AKTIE MIT ABSCHLÄGEN

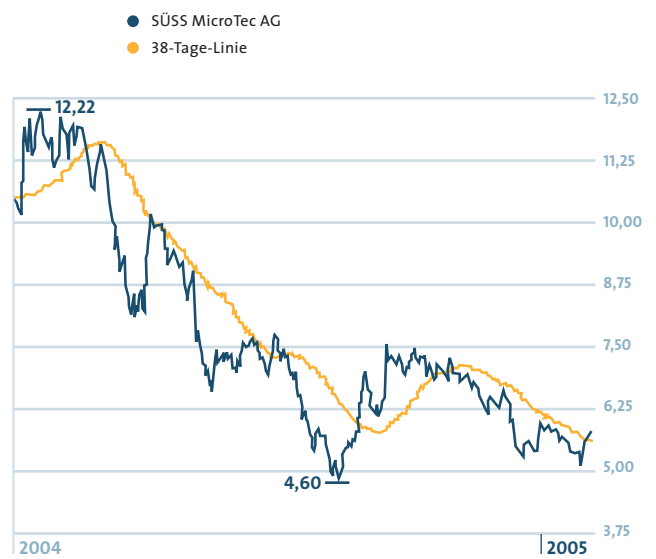
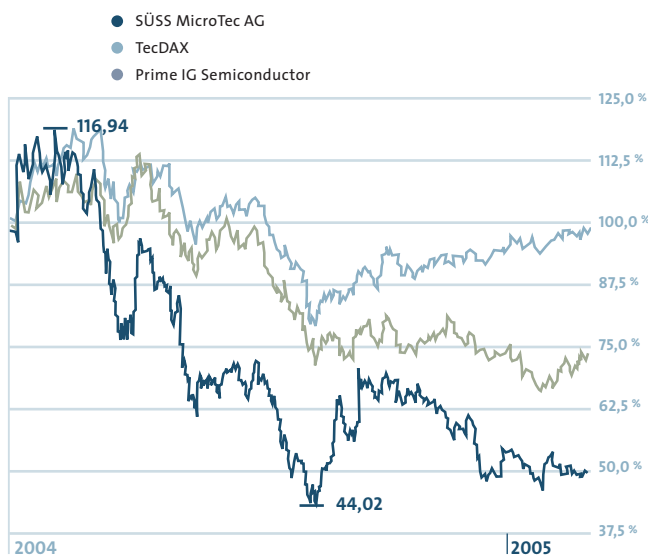
Das Jahr 2004 war zusammenfassend von einer verhaltenen Stimmung an den deutschen Aktienmärkten geprägt. Der Deutsche Aktienindex (DAX) schloss am Jahresende mit 4.256 Punkten und gewann 7,3 Prozent im Vergleich zu 2003. Der für SÜSS MicroTec wichtige Vergleichsindex TecDAX verlor im Berichtszeitraum 3,9 Prozent. Generell ließ sich 2004 kein richtiger Börsentrend ausmachen und es kristallisierten sich keine klaren Anlagestrategien heraus. Institutionelle Anleger agierten sehr zurückhaltend; die Zahl der privaten Aktien- und Fondsbesitzer ging weiter zurück. Die Unsicherheit über eine nachhaltig positive Entwicklung der Aktienmärkte überwog bei den Anlegern auch noch im Jahr 2004. Die Aktien der Halbleiterunternehmen entwickelten sich im vergangenen Jahr schlechter als die Aktienmärkte gesamt. Obwohl die Halbleiterindustrie in diesem Zeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnete, spiegelten die Kurse der Unternehmen diese Entwicklung nicht wider. Es ist davon auszugehen, dass die schon seit einiger Zeit widersprüchlichen Erwartungen für die Halbleiterindustrie in 2005 bereits 2004 in die Kurse „eingepreist“ wurden.

Die Entwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie war besonders enttäuschend: In den ersten drei Monaten bewegte sich die Aktie parallel zum TecDAX. Von April bis August verlor die Aktie überproportional zum Index. Erst ab dann konnte innerhalb von sechs Wochen der entstandene Spread zu einem großen Teil verringert werden. Ab Oktober zeigte die Aktie dann wieder eine deutliche Underperformance gegenüber dem TecDAX. Sie verlor im Berichtsjahr 44,7 Prozent ihres Wertes und notierte am 31. Dezember 2004 mit 5,61 Euro deutlich unter Buchwert.

Bezeichnend für die Kursperformance der SÜSS MicroTec-Aktie in 2004: Die positiven Nachrichten des Unternehmens konnten den Kurs nicht beeinflussen. Besonders deutlich zeigte sich das im dritten Quartal 2004. Die Bekanntgabe der strategischen Kooperation mit IBM bildete sich bis zum Jahresende nicht im Kurs ab. Im Gegenteil: Der Abwärtstrend setzte sich – wenn auch verlangsamt – fort. Zu stark wirkten sich Einflüsse wie widersprüchliche Branchenprognosen oder zurückhaltendes Anlegerverhalten auf unsere Aktie aus. Die Geschäfts- und Kursentwick-

<b>AKTIONÄRSSTRUKTUR:</b>	
<b>DR. WINFRIED SÜSS</b>	<b>6,76 %</b>
<b>FREEFLOAT</b>	<b>93,24 %</b>

WKN	722670
ISIN	DE 0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG.F
Bloomberg-Kürzel	SMH GR
Anzahl ausgegebener Aktien	15.156.884
Jahresanfangskurs	10,10
Schlusskurs	5,61
Prozentuale Jahresentwicklung	-44,7 %
Marktkapitalisierung 31.12.2004	85,03 Mio.
Durchschnittliches Handelsvolumen / Tag 2004	87.459
Beginn der Börsennotierung	18.05.99
Designated Sponsors	equinet AG
Jahreshoch / -tief	12,60 / 4,50



lung im Jahr 2003 verlief genau spiegelbildlich: Trotz negativer Geschäftsentwicklung war unsere Aktie im klaren Aufwind. Unsere Börsenjahre 2003 und 2004 veranschaulichen, welche vielfältigen Einflüsse in Aktienkurse eingepreist werden, was die Kursentwicklung zum Teil unvorhersehbar macht.

Trotz oder gerade wegen des für uns unerfreulichen Börsenjahres 2004 wurde die intensive Investor-Relations-Arbeit fortgeführt. Der Vorstand und die Investor-Relations-Abteilung pflegten engen Kontakt zu Investoren, Analysten sowie Vertretern der Wirtschaftspresse. Roadshows, Investorenkonferenzen und Einzelgespräche dienten als Plattform für die Darstellung der aktuellen Geschäftsentwicklung und als Forum für den intensiven Austausch über Themen wie Strategie und Zukunftspotenzial von SÜSS MicroTec. Den offenen Dialog mit der Financial Community setzen wir auch 2005 fort. Zusätzlich werden wir unseren Standard der transparenten, offenen und zeitnahen Kommunikation mit dem Kapitalmarkt weiter erhöhen. Basis

dafür ist unter anderem das Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG), das seit 30. Oktober 2004 in Kraft ist. Einige der sehr hohen und aufwendigen Anforderungen des AnSVG – wie beispielsweise die Erstellung und Führung so genannter Insiderlisten – haben wir bereits umgesetzt. Unser Anliegen bleibt weiterhin, den Schutz unserer Aktionäre stetig zu verbessern und so umfassend wie möglich zu gewährleisten.

Wir ermöglichen unseren Anlegern, aber auch allen Interessenten, gerne jederzeit Einblick in öffentliche Dokumente, die über den Wert und die Zukunftsperspektiven der SÜSS MicroTec Aufschluss geben. Dazu gehören der Einzelabschluss 2004 der SÜSS MicroTec AG, bislang publizierte Geschäfts- und Quartalsberichte sowie unsere Satzung. Zusätzlich erhalten sie weiterführende und aktuelle Informationen in Deutsch und Englisch auf unserer Website <http://www.suss.com>.





## CORPORATE GOVERNANCE

Das Ziel des Corporate Governance Kodex ist eine gute und verantwortliche Unternehmensführung, transparent für den Aktionär und die Öffentlichkeit. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG setzen die Standards des Regelwerks aktiv um und sehen den Corporate Governance Kodex als wichtigen Teil der Unternehmenskultur. Bereits 2002 wurde eine Corporate Governance Beauftragte berufen, die direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Seither wird die Corporate Governance in der SÜSS MicroTec AG in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt.

Im Sommer 2004 veröffentlichte die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik eine Studie, in deren Rahmen untersucht wurde, inwieweit die Unternehmen des H-DAX (DAX, M-DAX, TecDAX) dem Kodex entsprechen. Die gute Performance der SÜSS MicroTec zeigt das Ergebnis dieser Studie: Mit einem Erfüllungsgrad von 93 Prozent belegte SÜSS MicroTec Platz 3 im Gesamtranking TecDAX.

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit über 70 Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktiengesetz jährlich eine Erklärung über etwaige Abweichungen abgeben muss. Die Entsprechenserklärung der SÜSS MicroTec AG, der der aktuelle Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 zugrunde liegt, wurde in der Vorstands- und Aufsichtsratssitzung im Dezember 2004 verabschiedet und der Öffentlichkeit umgehend auf unserer Homepage zugänglich gemacht.

Gemäß dieser Erklärung entspricht die SÜSS MicroTec AG den Empfehlungen des aktuellen Corporate Governance Kodex und wird diesen voraussichtlich auch künftig entsprechen – mit den folgenden zwei Ausnahmen (im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Änderungen ergeben):

Der Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Handeln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert. Es ist deshalb auch keine Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In Ziffer 5.4.5 empfiehlt der Corporate Governance Kodex eine feste Vergütung, die unter anderem den Vorsitz in Ausschüssen sowie eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigt. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell eine feste Vergütung des Aufsichtsrats vor. Der Vorsitz in Ausschüssen wird dabei nicht zusätzlich berücksichtigt.

Von den Anregungen des Corporate Governance Kodex können die Unternehmen auch ohne Erklärungspflicht abweichen. Wir ermöglichen unseren Aktionären und der Öffentlichkeit eine größtmögliche Transparenz und legen daher unsere Umsetzung beziehungsweise die vier Abweichungen von den Anregungen im Folgenden offen (die Einhaltung ist mit einem Plus gekennzeichnet, die Abweichungen mit einem Minus):

- + Der Stimmrechtsvertreter ist während der Hauptversammlung erreichbar.
- Die Hauptversammlung kann bisher noch nicht via Internet verfolgt werden. Im Hinblick auf zusätzliche Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung derartiger Maßnahmen abgesehen.

- Es findet keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt, da es keinen mitbestimmten Aufsichtsrat gibt.
- + Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf ohne den Vorstand.
- + Im Falle eines Übernahmeangebots wird eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
- + Zu den Kodexanregungen wird Stellung genommen.
- + Der Vorstand erhält einmalige sowie jährlich wiederkehrende variable Vergütungskomponenten.
- + Die Vorstandsvergütung enthält an den geschäftlichen Erfolg gebundene variable Vergütungskomponenten;
- + ebenso variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung;
- + und variable Vergütungskomponenten mit Risikocharakter.
- + Ein Aufsichtsratsausschuss für Vorstandspersonalien ist etabliert.
- + Eine kürzere Bestelldauer bei Erstbestellungen von Vorstandsmitgliedern ist vorgesehen.
- + Der Aufsichtsratsvorsitzende hat nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss (Audit Committee).
- + Kein ehemaliges Vorstandsmitglied ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses.
- + Der Aufsichtsrat übergibt weitere Sachthemen zur Behandlung an einen oder mehrere Ausschüsse.
- + Der Aufsichtsrat hat Sitzungsvorbereitungen und Entscheidungen zum Teil an Ausschüsse übertragen.
- Bislang sind die Bestellperioden der Aufsichtsräte noch nicht flexibilisiert.
- Der Aufsichtsrat erhält keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Vergütungskomponente, sondern eine feste Vergütung. Um die Überwachungsaufgaben zweckgemäß und unabhängig durchführen zu können, erhält der Aufsichtsrat eine vom Unternehmenserfolg abhängige Vergütung für nicht zielführend.
- + Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in englischer Sprache.

Auch in diesem Jahr werden Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG wieder eine Entsprechenserklärung gemäß dem dann aktuell geltenden Kodex abgeben.

Garching, im März 2005

für den Aufsichtsrat  
Dr. Winfried Süß

für den Vorstand  
Dr. Stefan Schneidewind





>> Für den Erfolg unserer Produkte spielt Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. So gilt die Kenngröße „Cost of Ownership“ als zentrales Entscheidungskriterium für unsere Kunden. Auch innerhalb des SÜSS MicroTec-Konzerns gilt: Profitabilität durch wirtschaftliches Arbeiten erreichen. Dazu gehört die laufende Überprüfung aller internen Prozesse auf Effizienz und Optimierungspotenziale. <<

Dirk Bergner, Leiter Konzern-Controlling

+ + +







# WIRTSCHAFTLICHKEIT IM FOKUS

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++



## LAGEBERICHT

### KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2004

#### DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-systemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Marktnischen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigen Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern, z. B. im Rahmen des SECAP-Konsortiums, Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan, Taiwan, Thailand und China.

#### MARKTENTWICKLUNG

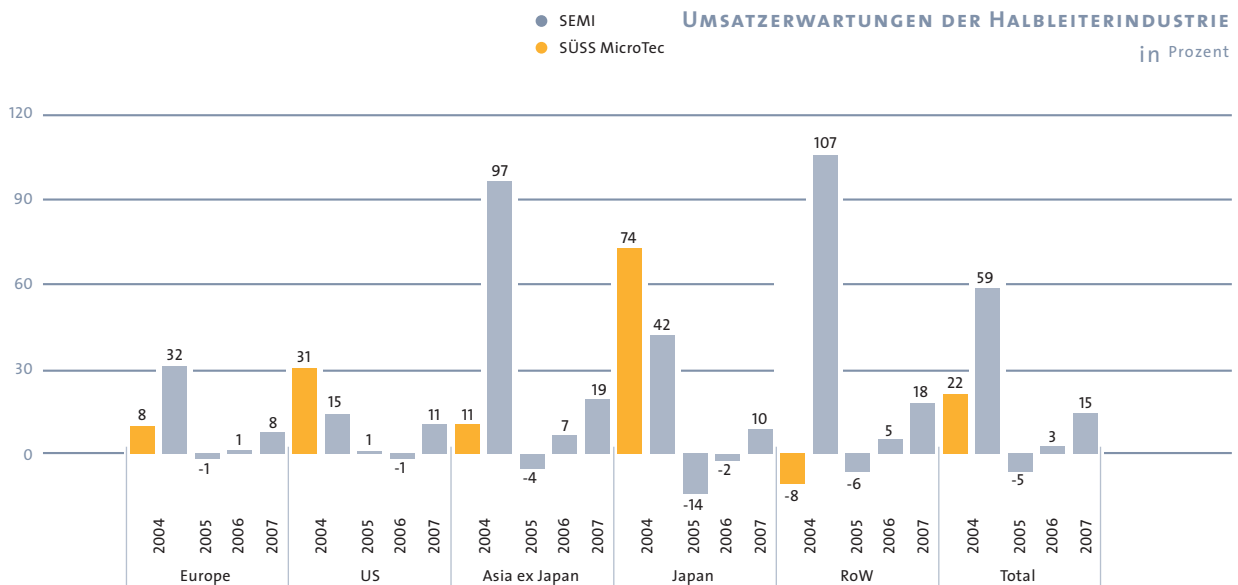
Insgesamt zeigte die Weltwirtschaft in 2004 eine stabile Entwicklung, was sich deutlich positiv auf die Entwicklung der Halbleitersysteme auswirkte. Die Branche konnte 2004 einen Zuwachs von rund 60 Prozent im Vergleich zu 2003 aufweisen, und somit nach vier Jahren wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.

Für das laufende Geschäftsjahr 2005 sind die Prognosen widersprüchlich. Gesamtwirtschaftlich wird in den USA ein verlangsamtes Wachstum erwartet, wobei hier die Defizitsituation und

die damit verbundene Wechselkursproblematik auch in 2005 ein weiter diskutiertes Thema bleiben wird. In China arbeitet man weiterhin an einer sanften Landung der überhitzten Konjunktur, so dass wir dort ein rückläufiges Investitionsklima erwarten. Unverändert sehen wir für 2005 – auch als Belastung für unser Unternehmen – weiteren Aufwertungsdruck beim Euro. Die Unsicherheit für das folgende Jahr zeigen auch die verschiedenen Prognosen der Research-Institute: der aktuelle Forecast des SEMI-Verbandes (siehe Grafik) zeigt für 2005 einen Rückgang um 5 %, während andere Verbände ein leichtes Wachstum erwarten. Zumindest besteht Einigkeit darüber, dass kein massiver Abschwung zu erwarten ist.

Wir weisen wie im Vorjahr darauf hin, dass der prognostizierte Rückgang einen typischen zyklischen Verlauf der Gesamtindustrie darstellt. Wir folgen aufgrund unserer Nischenposition nicht zwingend diesem Zyklus, sind aber grundsätzlich von der Gesamtstimmung in der Industrie abhängig.

In den neuen Schätzungen des SEMI-Verbandes wird deutlich, dass das Wachstum der Branche zwar weiterhin über dem durchschnittlichen Gesamtwachstum liegt. Jedoch wird auch erkennbar, dass sich die Wachstumsraten in Prozent vermindern, was ein Indiz für eine steigende Reife dieser Branche ist. Die dadurch bedingt stärker ansteigenden Konsolidierungstendenzen sind bereits heute erkennbar: Die M&A-Aktivitäten nehmen aktuell deutlich zu, und für die nächsten zehn Jahre erwartet man einen erheblichen Rückgang der Anzahl der selbstständig agierenden Halbleitersysteme. Manche Schätzungen gehen davon aus, dass die Anzahl der Unternehmen 2015 nur noch ein Zehntel betragen wird. Die Rolle von SÜSS MicroTec in dieser Konsolidierungsphase hängt vor allem von der Entwicklung unserer Marktkapitalisierung ab, die aktuell im Branchenvergleich sehr niedrig ist.



### GESCHÄFTSVERLAUF 2004

Das Jahr 2004 stellte nach den schwierigen Jahren 2002 und 2003 auch für uns wieder ein Wachstumsjahr dar. Der Umsatz 2004 konnte im Jahresvergleich von 92,6 Mio. EUR auf 112,9 Mio. EUR (+ 22 %) gesteigert werden, der Auftragseingang stieg von 101,0 Mio. EUR auf 119,1 Mio. EUR (+18 %). Grundsätzlich folgt auch SÜSS MicroTec den Zyklen der Gesamtindustrie, wobei sich SÜSS MicroTec bereits im letzten Zyklus spätzyklisch entwickelte: 2001 konnten wir ein erhebliches Umsatzwachstum generieren, während die Halbleiterausrüster bereits Umsatzrückgänge verzeichnen mussten. Auch die Entwicklung der Auftragseingänge pro Quartal im Vorjahresvergleich zeigt auf, wann sich die Belegung bei uns eingestellt hat:

- 1. Quartal 2004: - 4 %
- 2. Quartal 2004: + 44 %
- 3. Quartal 2004: + 24 %
- 4. Quartal 2004: + 7 %

Die Auftragslage stabilisierte sich bei unserem Unternehmen seit dem zweiten Quartal auf einem Niveau von über 30 Mio. EUR. Träger dieser Entwicklung waren neben wiederkehrenden Aufträgen von Produktionsequipment – hier insbesondere für das Advanced Packaging – die Länder USA und Japan. Erfreulich positionierten sich unsere neuen Produktionsmaschinen im Bereich Bonding im Markt, wo 2004 eine ausbaufähige installierte Basis bei wichtigen Kunden geschaffen wurde. Sehr schwierig blieb jedoch das Umfeld für unsere Produktlinie Device Bonder, wo ein weiterer Umsatzrückgang um 33 % verzeichnet werden musste. Die Situation bei den Verbindungshalbleitern (Telekommunikation) verbesserte sich auch in 2004 nicht. Abgesehen von dieser Produktlinie konnten alle anderen Produkte des Portfolios die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr steigern.



## LAGEBERICHT

Dass SÜSS MicroTec beim Wachstum unter dem Wert der Branche lag, ist vor allem auf den Umstand zurückzuführen, dass wir nur einen Teilmarkt (Advanced Packaging) mit hochpreisigen Produktionsmaschinen bedienen – diese erzeugen grundsätzlich die erheblichen Umsatzschwankungen (so genannte Front-End-Stepper, z. B. von ASML, kosten rund 15 Mio. EUR pro Stück). Das Wachstum von SÜSS MicroTec in 2004 wurde im Wesentlichen durch die stark angestiegene Nachfrage nach Produktionsmaschinen (plus 250 % gegenüber 2003) für das Advanced Packaging angetrieben. Dabei trägt dieser Markt nur rund 30 % zum Gruppenumsatz bei. Die anderen Märkte weisen geringere Wachstumsraten aus, so dass sich das Gruppenwachstum letztendlich bei etwas über 20 % einstellte.

In den anderen adressierten Teilmärkten (Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Testsysteme) sind wir nur in geringerem Umfang im Produktionsumfeld tätig. Daher müssen wir Wachstum vor allem durch gezielte Lösungen für Nischenmärkte erzeugen. In 2004 konnten wir in den Bereichen Optoelektronik und Mikrosystemtechnik Grundsteine für Wachstumspotenziale in 2005 legen.

Die wesentlichen Entwicklungen in 2004 lassen sich wie folgt darstellen:

- Mehrere Foundry-Kunden weiteten 2004 ihre 300mm-Kapazitäten aus. Erfreulicherweise stellte sich auch bei 200mm-Equipment wieder eine Belebung ein.
- Die SECAP-Linie für 300mm Advanced Packaging-Anwendungen wurde 2004 wie geplant verkauft. Das Investment in diese ehemalige Demonstrationslinie hat sich gelohnt, denn die Möglichkeit der Prozessdemonstration auf unseren Maschinen war auch für unsere Kunden ein Entscheidungskriterium für weitere Aufträge.

- Die ersten Bond Cluster-Systeme mit der SÜSS MicroTec „nanoPREP – Technologie“ wurden 2004 bei mehreren Kunden installiert. „nanoPREP“ ist eine neue Technologie, die das Bonden von Siliziumscheiben bei so niedrigen Temperaturen ermöglicht, dass Halbleiterschaltkreise diese Temperaturen schadlos überstehen. Bei diesem Produkt bieten sich 2005 besondere Umsatzpotenziale.

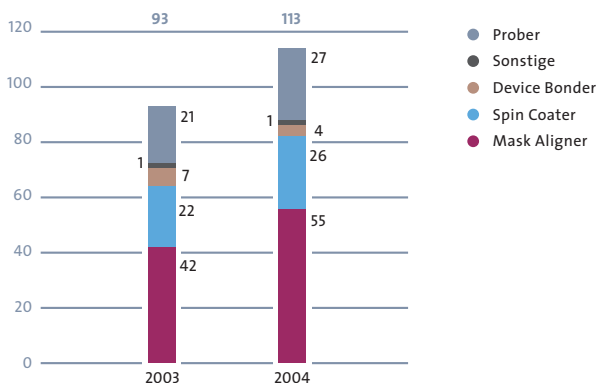
- Das Interesse an Probe Cluster-Systemen stieg weiter an. Im Bereich LED bietet dieses System derzeit die weltweit einzigartige Möglichkeit, bereits auf dem Wafer die Tests der Mikrosysteme durchzuführen. Die bereits installierten Systeme funktionieren hervorragend und stimmen uns auch für das laufende Jahr zuversichtlich.

### UMSÄTZE UND AUFTRAGSLAGE DER PRODUKTLINIEN

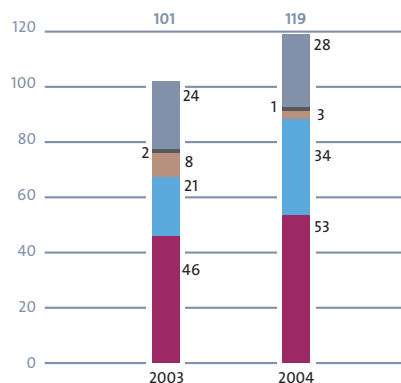
Bei der Umsatzverteilung nach Produktlinien entfielen unverändert rund zwei Drittel auf die Produktlinien Mask Aligner und Spin Coater. Beim Auftragseingang stellten diese beiden Produktlinien sogar knapp drei Viertel des Gesamtwertes dar. Dies ist vor allem in der Tatsache begründet, dass die anderen Produktlinien kaum Produktionskunden – die hauptverantwortlich für das Wachstum zeichnen – adressieren.

Der Umsatz mit Mask Alignern (inklusive Bonder) steigerte sich von 41,9 Mio. EUR auf 54,9 Mio. EUR (+ 31 %). Hauptverantwortlich für den Zuwachs war vor allem die zyklisch wieder vorhandene Nachfrage nach 200mm- und 300mm-Produktionsgeräten. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich daher auch beim Auftragseingang, der von 45,6 Mio. EUR auf 53,0 Mio. EUR (+ 16 %) gesteigert werden konnte. Die hohen Verkaufspreise dieser Geräte schlugen sich in den Zahlen 2004 dahingehend nieder, dass sich die Umsatz- und Auftragseingangsanteile der Mask Aligner an den Gesamtzahlen in 2004 wieder erhöhten.

UMSATZ NACH PRODUKTLINIEN  
in Mio. Euro



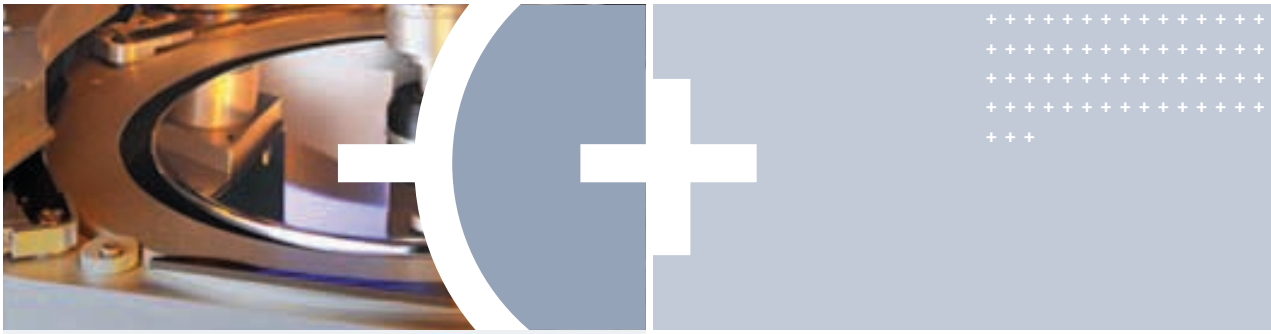
AUFTRAGSEINGANG NACH PRODUKTLINIEN  
in Mio. Euro



Bei den Spin Coatern mit einem Umsatz von 25,7 Mio. EUR (Vorjahr: 21,9 Mio. EUR; + 17 %) stellten die 300mm-Geräte einen wesentlichen Umsatzanteil dar. Das geringere Wachstum bei den Spin Coatern im Vergleich zu den Mask Alignern lag an der hier vorherrschenden höheren Wettbewerbsintensität. Aufgrund der Konkurrenzsituation wurde für den umkämpften 200mm-Produktionsmarkt ein kostengünstiger Spin Coater (Produktserie Gamma) entwickelt, der insbesondere für die Foundry-Anforderungen positioniert wurde. Diese neue Linie war 2004 bereits sehr erfolgreich, was sich aber nicht direkt an den Umsatzzahlen ablesen lässt. Denn im Vergleich zu unseren hochwertigen 200mm-Produktions-Coatern sind die Durchschnittspreise der Gamma-Serie ca. 30 % niedriger. In puncto Auftragseingang erholte sich die gesamte Produktlinie: nach dem deutlichen Rückgang in 2003 (- 35 %) konnte dieser im Berichtsjahr von 21,0 Mio. EUR auf 34,1 Mio. EUR (+ 63 %) gesteigert werden. Nicht zuletzt eine erfreulich hohe Anzahl an Aufträgen für die Gamma-Serie trugen zu diesem Wachstum bei.

Die Device Bonder mussten nach 2003 (- 23 %) einen weiteren Umsatzrückgang hinnehmen. 2004 sank der Wert erneut von 6,5 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR (- 33 %). Insgesamt ist die Entwicklung enttäuschend, vor allem unter Berücksichtigung des Einbruchs beim Auftragseingang. Dieser sank auf den sehr niedrigen Wert von 2,8 Mio. EUR, was einem Rückgang um 64 % im Vorjahresvergleich (7,9 Mio. EUR) entspricht. Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2005 wird entscheidende Bedeutung für die Zukunft dieser Produktlinie haben.

Unsere Prober konnten mit einer Steigerung des Umsatzes von 21,4 Mio. EUR auf 26,7 Mio. EUR (+ 25 %) ebenfalls auf den Wachstumspfad zurückkehren. Erfreulicherweise hat diese Produktlinie den letzten Abschwung sehr gut verkraftet und zeigt sich relativ stabil auch in schwierigerem Marktumfeld. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 14 % von 24,4 Mio. EUR auf 27,7 Mio. EUR in 2004. Dieses Wachstum erscheint auf den ersten Blick



## LAGEBERICHT

gering, jedoch wurde bereits 2003 eine Steigerung dieses Wertes um 20 % erzielt. Im Unterschied zu unserer Prognose aus dem Vorjahr erwarten wir von dieser Produktlinie langfristig nun eher höhere Umsatzanteile im Bereich von 25 %, nicht zuletzt aufgrund der Erfolge mit den hochpreisigen Cluster-Systemen.

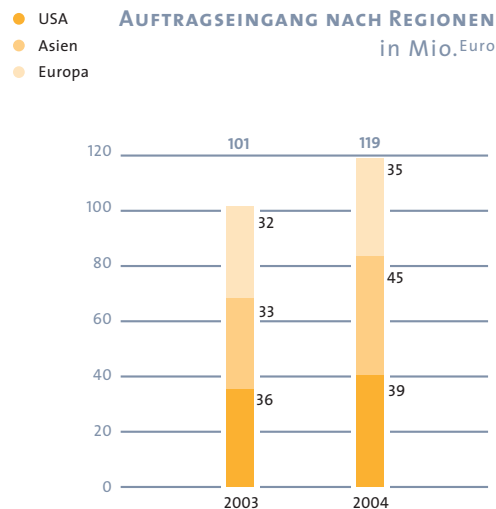
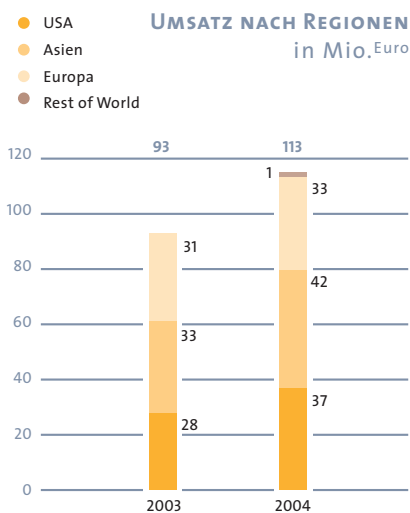
### UMSÄTZE UND AUFTRAGSLAGE IN DEN REGIONEN

Bei der Betrachtung der Regionen überzeugte beim Umsatz neben Asien vor allem die USA, die sich trotz des weiteren Verfalls des US-Dollars auch im Vergleich zum Branchentrend sehr positiv entwickelte. Europa hingegen setzte sich 2004 nur wenig vom Vorjahresniveau ab und blieb hinter den Erwartungen zurück. Beim Auftragseingang ist die Abhängigkeit des Produktions-equipments von der Region Asien deutlich erkennbar.

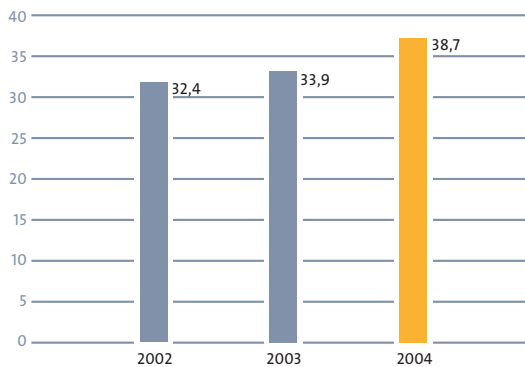
In Nordamerika konnten die Umsätze von 28,3 Mio. EUR auf 37,0 Mio. EUR (+ 31 %) gesteigert werden. Der Auftragseingang stieg von 35,6 Mio. EUR auf 39,4 Mio. EUR (+ 11 %). Neben Testsystemen werden unverändert vor allem die Segmente Ver-

bindungshalbleiter und Mikrosystemtechnik bedient. Beim Advanced Packaging sind die mittelfristigen Erwartungen in dieser Region eher zurückhaltend.

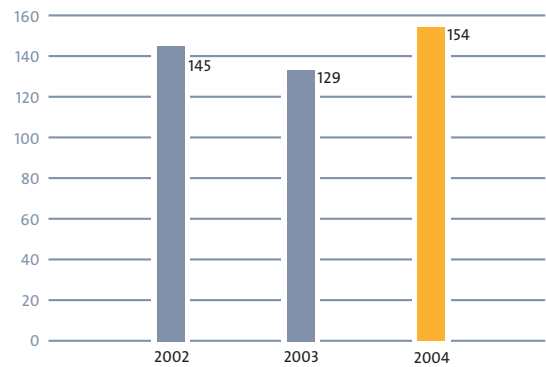
An der Entwicklung der Region Asien kann der Branchenzklus sehr gut abgelesen werden. Nach einem Rückgang um 26 % im Vorjahr konnte der Umsatz in 2004 wieder um 28 %, von 33,1 Mio. EUR auf 42,2 Mio. EUR, gesteigert werden. Vor allem das Wachstum in Japan ist mit 74 % (15,3 Mio. EUR nach 8,8 Mio. EUR) erwähnenswert, während sich Restasien um 11 % verbesserte (27,0 Mio. EUR nach 24,3 Mio. EUR). Der Auftragseingang stieg in Asien deutlicher als der Umsatz: von 32,7 Mio. EUR auf 44,5 Mio. EUR (+ 36 %). Anders als beim Umsatz ist der Auftragseingang in Restasien stark gewachsen (31,4 Mio. EUR nach 21,3 Mio. EUR; + 47 %), während Japan ein abgeschwächtes Wachstum beim Auftragseingang (13,2 Mio. EUR nach 11,4 Mio. EUR, + 16 %) verzeichnete. Taiwan, Singapur und Südkorea sind unsere wichtigsten Märkte für Produktionsgeräte im Bereich Advanced Packaging.



**AUFTRAGSBESTAND ZUM JAHRESENDE**  
in Mio. Euro



**UMSATZ MITARBEITER**  
in Tausend Euro



In Europa, wo vor allem die Mikrosystemtechnik und Testsysteme vertreten sind, stieg der Umsatz um 8 % von 30,9 Mio. EUR auf 33,3 Mio. EUR. Der Auftragseingang konnte im selben Zeitraum ebenfalls um 8 % von 32,4 Mio. EUR auf 35,1 Mio. EUR nur leicht gesteigert werden.

**AUFTRAGSBESTAND**

Der Auftragsbestand am 31.12.2004 betrug 38,7 Mio. EUR. Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und den realisierten Umsätzen, die so genannte Book-to-bill-Ratio, lag 2004 kaum verändert bei 1,06 (2003: 1,09). Wesentlicher Sonder-effekt in 2004 war die Herausnahme eines Auftrags in Höhe von 3,8 Mio. EUR, bei dem wir nicht von einer Lieferung in 2005 ausgehen.

Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge für die nächsten drei bis sechs Monate, wobei in Ausnahmefällen auch spätere und frühere Liefertermine fixiert sein können.

Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerechnet) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19 % von 129 TEUR auf 154 TEUR an.

**ERTRAGS-, VERMÖGENS- UND FINANZLAGE**

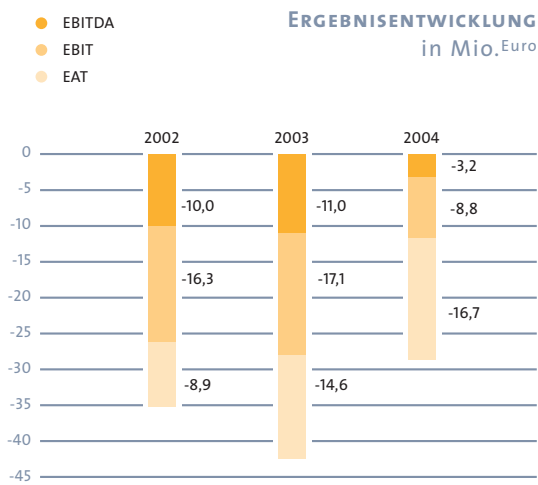
**ERTRAGSLAGE**

Die Ertragssituation bei der SÜSS MicroTec-Gruppe ist stärker als bei anderen Unternehmen von der Entwicklung der Umsätze abhängig. Oftmals verwendet man hierfür den Begriff „hohes Operational Gearing“, was auch für SÜSS MicroTec gilt. Darunter versteht man eine höhere Schwankung der Ergebnisveränderung im Vergleich zur Umsatzveränderung, so kann ein Umsatzwachstum von z. B. 20 % zu einer Ergebnisverbesserung von 40 % führen. In unserem Fall führt ein steigender Umsatz bei relativ konstanten Kosten für Verwaltung, Vertrieb und Forschung&Entwicklung in der Regel zu einem deutlich gestiegenen EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen).

Bei den verschiedenen Ergebniskennzahlen konnte im Vergleich der letzten drei Jahre nur die Kennzahl EBITDA die deutlich



## LAGEBERICHT



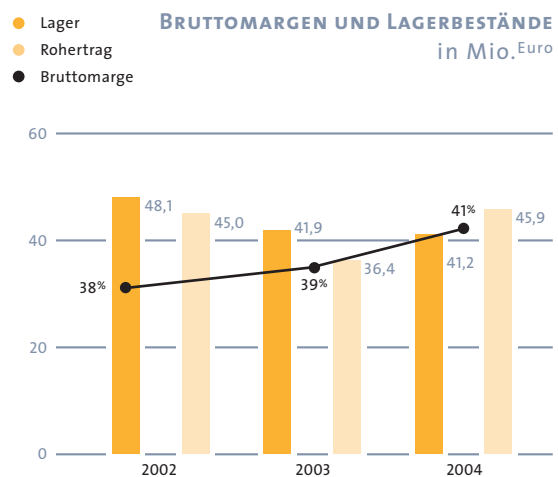
verbesserte operative Performance aufzeigen. Dieses verbesserte sich von - 11,0 Mio. EUR auf - 3,2 Mio. EUR. Eine ähnliche Verbesserung konnte beim EBIT registriert werden, wo die Verluste von - 17,1 Mio. EUR auf - 8,8 Mio. EUR eingedämmt werden konnten. Beim Ergebnis nach Steuern ist die gestiegene operative Performance mit einem Wert von - 16,7 Mio. EUR im Vergleich zu 2003 (- 14,6 Mio. EUR) nicht sofort erkennbar. Denn in 2004 wurde eine signifikante Wertberichtigung auf aktive latente Steuern in Höhe von 9,4 Mio. EUR (2003: 1,8 Mio. EUR) im Ergebnis nach Steuern (EAT) wirksam. Die Wertberichtigung reduziert die aktiven latenten Steuern auf einen Betrag, der nach derzeitiger Auffassung der Gesellschaft eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich realisiert werden kann. Daher würde sich in der Zukunft bei positiver Ergebnissituation nur eine sehr geringe Steuerquote ergeben.

Der Rohertrag und die Rohertragsmarge als wesentliche Indikatoren für die Ertragskraft veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

- Der Rohertrag stieg vor allem aufgrund des Umsatzwachstums von 36,4 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR.

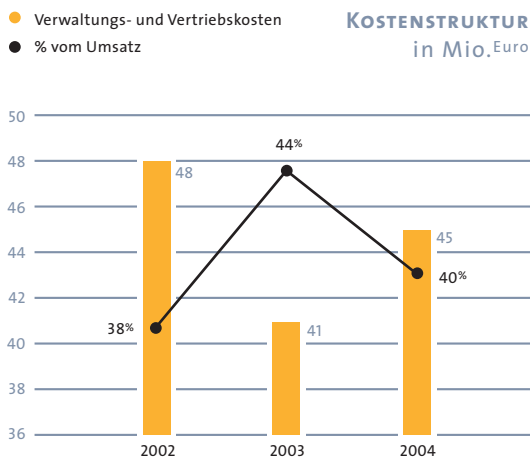
- Die Bruttomarge erholte sich nur leicht von 39 % auf 41 %, was vor allem aufgrund noch niedriger Lernkurven (kostensenkende Erfahrungswerte in der Produktion) bei der Produktlinie Substrat Bonder und mit strukturellen Problemen bei der Produktlinie Device Bonder zusammenhängt. Zudem sind die Herstellkosten im Geschäftsjahr durch die Schließung des Werkes Aßlar in Höhe von 0,9 Mio. EUR belastet.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Überkapazitäten im Produktionsbereich deutlich zurückgegangen. Auslastungsprobleme bestehen heute vor allem in den USA (Substrat Bonder), wo das Produkt sich noch in der Umsatzwachstumsphase befindet, und in Frankreich (Device Bonder), wo die strukturellen Marktprobleme zu sehr niedrigen Umsätzen führen.



Mittelfristig liegt unsere Zielmarge bei Annahme eines US-Dollar-Wechselkurses im Bereich von 1,35 USD/EUR bei etwa 42 %. Nach Abschluss der Restrukturierung soll die Zielmarge langfristig wieder stabil den Wert von etwa 45 % erreichen.





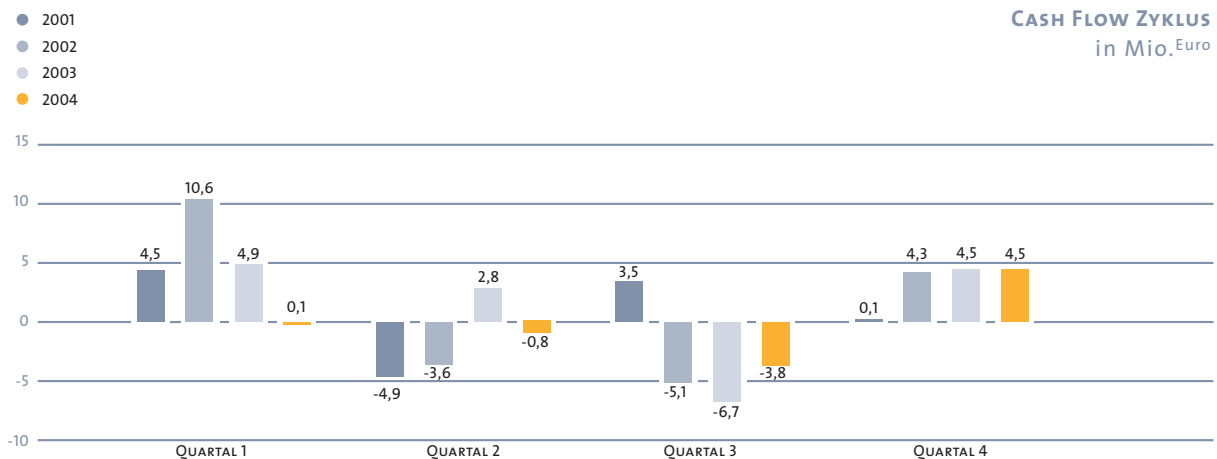
Bei den Verwaltungs- und Vertriebskosten waren Restrukturierungskosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR als Sondereffekte zu berücksichtigen. Diese beinhalten im Wesentlichen außerplanmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie die Beratungskosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung. Zudem enthalten die Verwaltungs- und Vertriebskosten die kalkulierte Abfindungszahlung für den ehemaligen Vorsitzenden des Vorstands. Ohne diesen Betrag ist die Kostenstruktur im

Wesentlichen mit 2003 vergleichbar, da erhöhte Kosten im Berichtsjahr dann vor allem auf höhere Vertriebskosten in Verbindung mit dem gestiegenen Umsatz zurückzuführen sind.

Im Finanz- und sonstigen Ergebnis führte der weiter steigende Euro wie bereits in den Vorjahren zu Buchverlusten in Höhe von 1,2 Mio. EUR bei internen US-Dollar-Darlehen. Diese Buchverluste würden bei einer Abschwächung des Euro wieder anteilig zu Buchgewinnen führen.

**VERMÖGENS- UND FINANZLAGE**

Auch in 2004 gab es eine saisonal typische Entwicklung der Liquidität, da im ersten Quartal die höheren Umsätze des vorangegangenen vierten Quartals zu entsprechenden Zahlungen führten. Da der Forderungseingang aber bereits im vierten Quartal des Vorjahres 2003 relativ hoch war, wirkte dieser Effekt im ersten Quartal des Berichtsjahres nicht so stark. Dies lässt sich auch an der Entwicklung der Außenstandstage (Days Sales Outstanding, DSO) ablesen, die 2003 einen sehr guten Wert von 67 Tagen aufwiesen. Für 2004 betrug dieser Wert wieder den langfristig üblicheren Wert von 69 Tagen.





## LAGEBERICHT

Der Verlauf des operativen Cash Flow folgte den bekannten internen Zyklen, wobei vor allem auf den Lageraufbau im zweiten und dritten Quartal mit anschließendem Abbau im vierten Quartal an dieser Stelle nochmals hingewiesen wird. Die Kundenanzahlungen verbesserten sich nur leicht von 2,7 Mio. EUR (2003) auf 3,4 Mio. EUR. Wir erwarten unverändert auch in 2005 keine erheblichen positiven Effekte aus einem Anstieg der Anzahlungsquote von Kunden.

Das Working Capital hat weiterhin nicht die von uns gewünschte Größenordnung und bindet noch immer zu hohe Finanzmittel. Bei den Lagerbeständen konnten wir zwar keinen erheblichen Abbau erzielen, jedoch wurde unter Berücksichtigung des deutlich gestiegenen Umsatzes die Reichweite von ca. 270 Tagen in 2003 auf nur noch knapp über 220 Tage reduziert.

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zu 2003 – neben den deutlich über den Investitionen liegenden Abschreibungen – vor allem durch die Wertberichtigung auf aktive latente Steuern verringert.

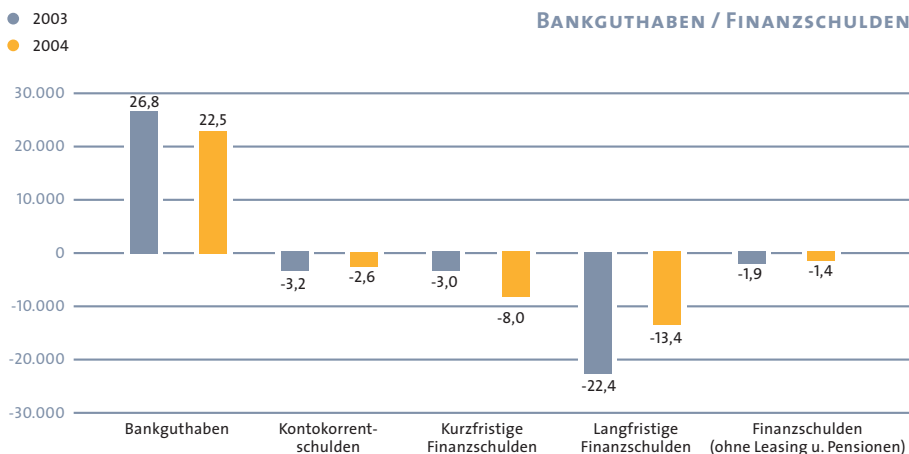
Auf der Passivseite führte der Verlust zu einer entsprechenden Verringerung des Eigenkapitals, wobei als vorherrschender positiver Effekt die Wandlung von 200.000 Aktien aus der Wandelanleihe dem Eigenkapital rund 2 Mio. EUR zuführten.

Der deutliche Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist auf folgende Punkte zurückzuführen:

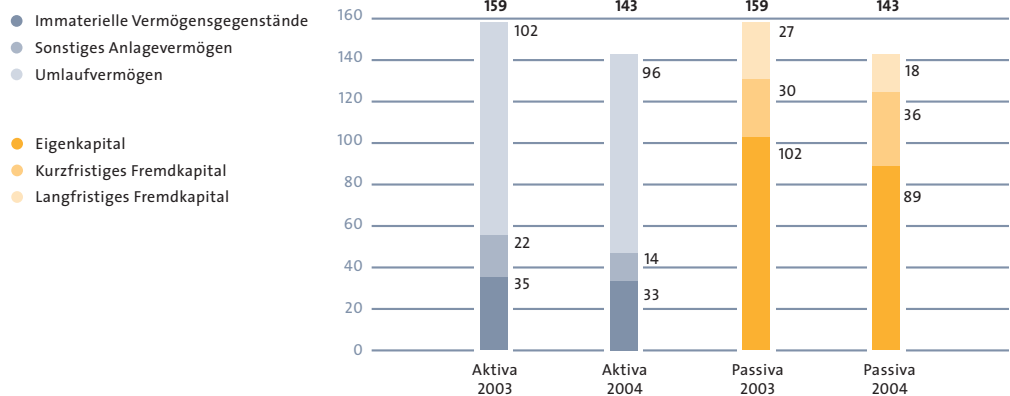
- Die Kosten der Restrukturierung in Höhe von 2,5 Mio. EUR sind zu einem großen Teil erst in 2005 auszahlungswirksam
- Die kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten die kalkulierte Abfindungszahlung für die ehemaligen Vorsitzenden des Vorstands
- Die erste Tranche aus der Wandelanleihe in Höhe von 5,6 Mio. EUR ist bei Nichtwandlung Ende Oktober 2005 zurückzuzahlen. Daher wurde dieser Betrag von den langfristigen in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umgegliedert

Die Bilanzstruktur des Konzerns stellt sich unverändert als solide dar. Per Ende des Jahres 2004 verfügte der Konzern über 22,5 Mio. EUR (Vorjahr: 26,8 Mio. EUR) liquide Mittel, denen 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR) kurzfristige Bankverbindlichkeiten gegenüberstanden.

Zusammenfassend ist für 2004 eine deutliche Verbesserung bei der Ertragslage festzustellen, die fast ausschließlich auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist. Jedoch ist die Entwicklung bei der Rohertragsmarge nicht zufrieden stellend, da letztend-



### BILANZSTRUKTUR KONZERN in Mio. Euro



lich keine wesentlichen Skaleneffekte (Degression der Fixkosten) wirksam wurden. Somit hat vor allem die nicht zufrieden stellende Ergebnisentwicklung die Notwendigkeit der aktuell laufenden Restrukturierungsmaßnahmen aufgezeigt. Bei der Vermögens- und Finanzlage entspricht die Entwicklung im Wesentlichen den Erwartungen, wobei sich die bereits genannte fehlende Ertragskraft in zu geringen operativen Cash Flows niederschlägt. Die immer noch zu hohe Kapitalbindung bei den Lagerbeständen ist im Rahmen des Restrukturierungsprojektes ebenfalls ein Schwerpunkt. Für 2005 ist jedoch noch kein wesentlicher Abbau der Lagerbestände zu erwarten.

#### INVESTITIONEN

Investitionen erfolgten in 2004 unverändert zum Vorjahr nur im Rahmen von dringend notwendigen Ersatzinvestitionen für Büroeinrichtungen und Equipment für die Fertigungsbereiche. Ausnahme stellten Investitionen im Bereich der EDV dar, wo als wesentliches Projekt die Einführung eines CRM-Systems im Vordergrund stand. Insgesamt betragen die Investitionen in 2004 1,2 Mio. EUR nach 1,0 Mio. EUR im Vorjahr.

Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis darauf, dass bei unserem Unternehmen die Investitionstätigkeit keinen wesentlichen Indikator für die Zukunftsfähigkeit darstellt. Diese ist primär durch die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten geprägt.

#### DIE HOLDING – SÜSS MicroTEC AG

Hinweis: den Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Investor-Relations-Abteilung.

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den in dem Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften.



## LAGEBERICHT

Ohne Sondereffekte erzielt die SÜSS MicroTec AG in der Regel einen Jahresüberschuss aus Ergebnisbeiträgen von den Beteiligungen sowie aus dem Finanzergebnis, wo durch interne Darlehensvergaben und kurzfristige Finanzierungen entsprechende Zinseinkünfte entstehen.

Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesellschaft an verbundene Unternehmen veränderten sich von 43 Mio. EUR in 2003 auf 47 Mio. EUR in 2004.

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2004 waren folgende Sondereffekte für den Jahresfehlbetrag von -3,4 Mio. EUR (Vorjahr: -9,0 Mio. EUR) verantwortlich:

- 1,2 Mio. EUR Buchverluste auf gegebene, nicht gesicherte US-Dollar-Darlehen (dieser Effekt war ebenfalls in 2002 und 2003 vorhanden)
- 0,5 Mio. EUR Kosten für Beratungen im Rahmen der Restrukturierung
- 2,2 Mio. EUR Abwertungen auf Vermögensgegenstände im Rahmen der Restrukturierung und Vorsorgen, die auch die Änderungen im Vorstand beinhalten

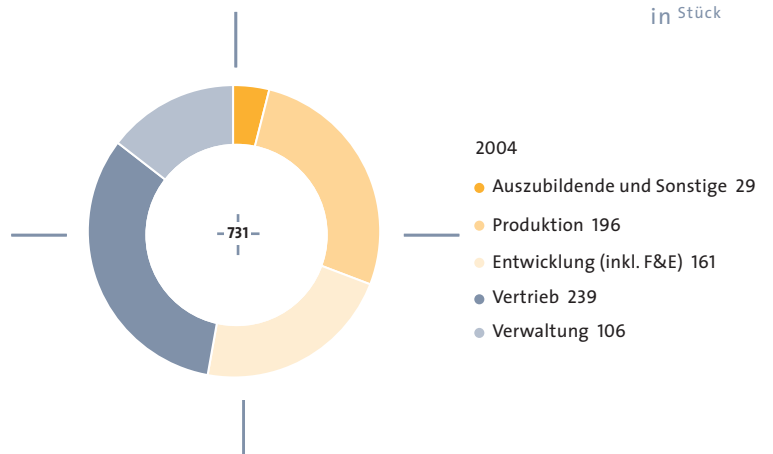
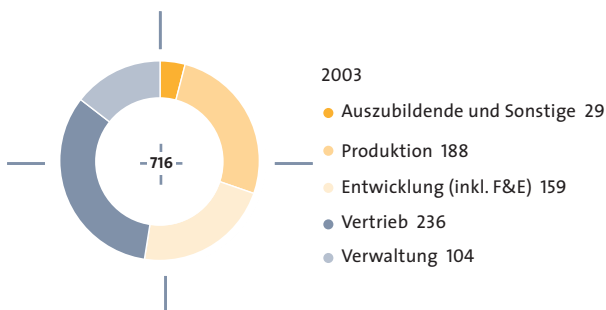
In der SÜSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2004 20 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter und zwei Vorstände aktiv tätig.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding und des Konzerns (TEUR):

	SMT AG (Handelsrecht)				Konzern (US-GAAP)			
	2004	2003	Änderung	in %	2004	2003	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag	-3.417	-8.962	5.545	-62	-16.690	-14.553	-2.137	15
Eigenkapital	92.215	92.870	-655	-1	88.552	102.409	-13.857	-14
Bilanzsumme	116.575	117.519	-944	-1	142.917	158.853	-15.936	-10
EK-Quote in %	79	79			62	64		
Anlagevermögen	84.562	81.065	3.497	4	46.669	56.774	-10.105	-18
in% der Bilanzsumme	73	69			33	36		
Umlaufvermögen*	32.013	36.454	-4.441	-12	96.248	102.079	-5.831	-6
in% der Bilanzsumme	27	31			67	64		

\* Einschließlich aktiver Rechnungsabgrenzung.

MITARBEITER NACH FUNKTIONSBEREICHEN  
in Stück



MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswertes dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter. In der Darstellung nach Segmenten wird deutlich, dass die Entwicklung und der Vertrieb (hier vor allem die Vertriebsingenieure) einen wesentlichen Teil der Belegschaft repräsentieren.

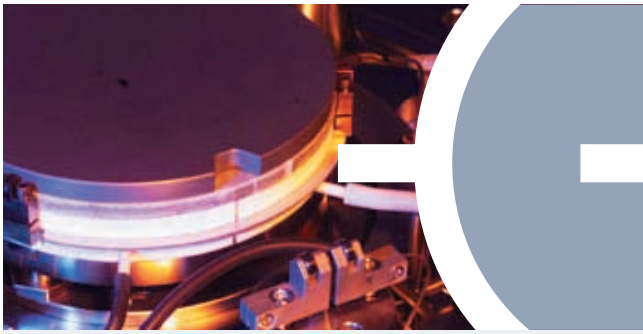
Zum Ende des Jahres 2004 waren 731 (Vorjahr: 716) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen Aktivitäten, die zu einer Erhöhung oder Verminderung der Anzahl der Mitarbeiter geführt hätten. Daher ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr auch keine wesentlichen Änderungen in der Struktur.

Im Frühsommer 2004 wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen ein umfassendes Kostensenkungsprojekt initiiert. Dieses führte auch zu der Entscheidung, das Werk Aßlar im Verlauf des Jahres 2005 zu schließen und die Aktivitäten in das

Werk Garching bei München zu integrieren. Als Konsequenz wird sich die Zahl der Mitarbeiter um zirka 50 verringern, wobei vor allem die Bereiche Produktion und Entwicklung davon betroffen sein werden.

Weitere Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Personalstruktur sind im Frühjahr 2005 nicht auszuschließen. Hier ist vor allem die Entwicklung des Auftragseinganges entscheidend, denn abhängig von den zu erwartenden Umsätzen ist die Kostenstruktur entsprechend kurzfristig anzupassen. Wir versuchen weiterhin, Personalabbaumaßnahmen sozialverträglich zu gestalten und den betroffenen Mitarbeitern Hilfestellung zu geben.

Langfristiges Ziel der Restrukturierung ist auch eine stabile Stammbesetzung zu definieren, der eine weit reichende Perspektive innerhalb der SÜSS MicroTec-Gruppe offeriert werden kann.



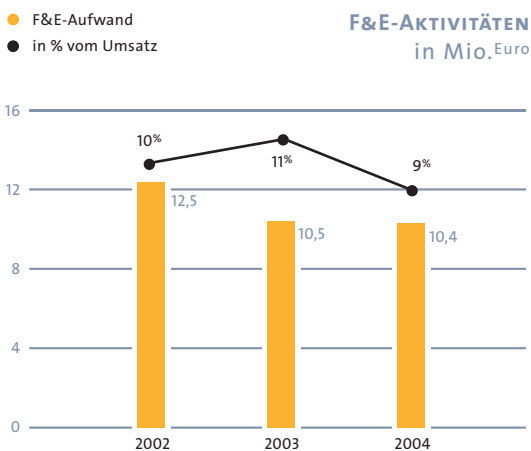
## LAGEBERICHT

### FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind von wesentlicher Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowohl der bestehenden als auch zukünftiger Produkte. Sie stellen für unser Unternehmen Investitionen in die Zukunft dar.

Entwicklungsaufwendungen werden unverändert für alle Produktlinien in erheblichem Umfang getätigt, da nur durch die permanente Weiterentwicklung der technologische Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern gehalten oder sogar weiter ausgebaut werden kann. Stets erfolgt ein entsprechender Anteil der F&E-Aktivitäten direkt im Bezug zu Kundenaufträgen, daher befindet sich ein Teil der F&E-Kosten in den Herstellkosten des Umsatzes. Der absolute Rückgang der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung ist auf Großprojekte in 2003, vor allem im Bereich der Substrat Bonder, zurückzuführen.

In 2004 standen folgende wesentliche Projekte im bestehenden Produktportfolio im Blickpunkt:



Bei der für SÜSS MicroTec wichtigsten Produktlinie Mask Aligner wurde eine tief greifende Produkterneuerung eingeleitet, an deren Ende die neue Produktfamilie „MA compact“ steht. Wie der Name schon andeutet, entstehen hier Produktionsmaschinen höchster Integrationsdichte mit sparsamem Platzbedarf, was die Aufstellfläche betrifft. Das ist ein wichtiges Merkmal bei den hohen Infrastrukturkosten der Reinräume in den Halbleiterfabriken, den „Fabs“. Diese Maschinengeneration weist weiterhin – dank intelligenter Temperaturkompensation und neuer Imagingtechniken – eine verbesserte Justiergenauigkeit auf. Sie hat auch die neue Steuerungselektronik und Software des „Flaggschiffs“ MA300 erhalten. Die erste Maschine dieser Art kommt bereits Anfang 2005 zur Auslieferung.

Spin Coater: Für die Belackung von Wafern, die eine ausgeprägte 3-D-Struktur mit „Bergen und Tälern“ aufweisen, ist das von SÜSS MicroTec zur Reife gebrachte Spraycoating-Verfahren die erste Wahl. Nach sorgfältiger Grundlagenentwicklung im eigenen Haus wurde das Verfahren 2004 für Produktionsmaschinen mit hohem Durchsatz weiterentwickelt und diese neuen Maschinen erfolgreich in den Markt eingeführt.

Substrat Bonder: die im Vorjahr entwickelte Bonder-Technik zur Plasmabehandlung von Wafern wurde für den Einsatz bei strukturierten Wafern verbessert und schließlich erfolgreich in Bond-Cluster für die Produktion eingeführt. Diese Produktionsmaschinen vereinen automatische Justierung im Submikronbereich mit dem Wafer freundlichen Niedertemperatur Bonden. Trotz der schonenden Methode entstehen dank integrierter Plasmabehandlung am Ende des Herstellprozesses Wafer Paare, die die gewünschte hohe Bondfestigkeit aufweisen. Diese Methode eröffnet insbesondere für das Packaging von komplexen MEMS-Systemen neue Möglichkeiten. Neben einem neuen „klassischen“ Bonder wurde eine völlig neue Generation von Hochdruck-

bondern entwickelt. Bei Temperaturen bis über 400° C werden mit einem Anpressdruck von über fünf Tonnen zwei individuell fertig prozessierte Wafer mit Hilfe spiegelbildlich angebrachter Kupferflächen mechanisch und elektrisch leitend verbunden. Dieses so genannte Cu:Cu-Bondverfahren wird seine Zukunft in der 3-D-Integration von Schaltungen haben.

Im Bereich Testsysteme wurde das MFI-Probe-System I zur Marktreife gebracht. Dabei handelt es sich um ein Kontaktsystem mit feinsten Messspitzen aus der Nanotechnologie für elektrische Messungen. Dieses System ist in der Lage, Strukturen von 130 nm Größe sicher zu treffen. Außerdem wurde die berührungsfrei arbeitende Version dieser Prüfeinrichtung soweit weiterentwickelt, dass erste erfolgreiche Messungen auf Kundenchips möglich wurden und somit einer Markteinführung im Jahr 2005 nichts mehr im Wege steht. Für den rasant wachsenden Markt Leuchtdioden (LED) wurde ein kostengünstiger Hochgeschwindigkeitstester zur Reife gebracht, der bis zu zehn Kontaktierungen pro Sekunde durchführen kann.

Im Bereich Nanotechnologie wurden besonders große Anstrengungen unternommen. Seit März 2004 ist SÜSS MicroTec der größte industrielle Partner des Förderprojekts „Emerging Nanopatterning Methods“ (NaPa), des neuen Rahmenprogramms 6 der Europäischen Union. Über vier Jahre wird sich SÜSS MicroTec hier mit ca. 2,7 Mio. EUR engagieren und entsprechend gefördert werden. Das erste Produkt, das mit anteiliger Förderung der EU in 2004 entwickelt wurde, ist der nahezu universell einsetzbare Nanostepper NPS, der ab Frühsommer dieses Jahres zur Auslieferung kommen wird. Mit dieser hochpräzisen Maschine wird den Prozessentwicklern eine flexible Basis für die Optimierung künftiger Produktionsprozesse für die Nanolithografie an die Hand gegeben.

Darüber hinaus hat vor allem das Gemeinschaftsprojekt mit IBM, kurz C4NP, erheblichen Stellenwert. Parallel an mehreren Standorten wurde mit der Entwicklung der neuen Maschinengeneration für das von IBM lizenzierte C4NP-Verfahren begonnen.

Für den Einsatz dieses sehr zukunftssträchtigen Verfahrens benötigt ein Hersteller eine Produktionslinie, die aus folgenden Komponenten besteht: das Mold Fill Tool füllt unzählige kleine Vertiefungen einer Trägerplatte mit dem bleifreien Lot (solder). Nach dem Füllen wird der Erfolg dieses Vorgangs mit einem Mold Inspection Tool mittels elektronischer Bildverarbeitung überprüft. Das Solder Transfer Tool schließlich ist ein Bonder-ähnliches Gerät, das Wafer und gefüllte Trägerplatte genau zueinander justiert und in Kontakt bringt. Anschließend wird in dieser Maschine unter erhöhter Temperatur das Lot exakt auf die Kontaktflächen des Wafers übertragen. Diese „Fertigungsstraße“ wird in 2005 in Erprobung gehen.

**F+E-STRATEGIE**

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt darin, Neuentwicklungen schnell an den Kunden zu bringen und entsprechend zeitnah umsatzwirksam werden zu lassen. Angesichts der Marktsituation wurden insbesondere im Bonder-Bereich bereits in 2003 auch einige Spezialentwicklungen für 2004 als Aufträge angenommen, die im Endeffekt das Bonder-bezogene Know-how der SÜSS MicroTec-Gruppe verbreitert haben. Gerade im Produktsegment Bonder bestehen für SÜSS MicroTec echte Wachstumschancen, da wir in diesem Bereich bisher unterrepräsentiert waren. Wie die obige Liste der Neuentwicklungen deutlich zeigt, wurde die mittel- und langfristige Innovation in 2004 zusätzlich sehr stark betont. Grund war, dass sehr große Halbleiterhersteller in 2003 und 2004 mit sehr konkreten Zukunftsprojekten an SÜSS MicroTec herantraten.





## LAGEBERICHT

Angesichts der gesteigerten Innovationstätigkeit blieb die Mitarbeiterzahl im Bereich F+E über das ganze Jahr mit 103 Mitarbeitern zum Jahresende nahezu konstant, war also von den Maßnahmen zur Personalreduzierung kaum betroffen. Auch hierin zeigt sich die unverändert auf Wachstum ausgerichtete Strategie der SÜSS MicroTec-Gruppe, die den Kern aller Innovationen – das Wissen und die Erfahrung von Wissenschaftlern und Ingenieuren – zu erhalten gebietet.

### MARKETING UND VERTRIEB

Unsere Marketingaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf Fachmessen und Fachzeitschriften, die primär unsere Zielgruppe adressieren. So sind die jährlich wiederkehrenden Messen des SEMI-Verbandes (SEMI = Semiconductor Equipment and Materials International) in den USA, Asien und Europa unsere wichtigsten Messen. Daneben nehmen wir an weiteren, teilweise kleineren Messen teil, die vor allem für spezielle Produktlinien in unserem Portfolio geeignet sind.

Eine besondere Maßnahme war in 2004 die Vermarktung des gemeinsamen Entwicklungsprojektes mit IBM, das sogenannte C4NP-Projekt. Hier wurden Anzeigen und Artikel in diversen Fachmagazinen veröffentlicht. Daneben werden kontinuierlich Anzeigen und Artikel betreffend der Kernmärkte in Fachmagazinen veröffentlicht. Weiterhin werden Kundenveranstaltungen zum Beispiel betreffend das Advanced Packaging abgehalten, vor allem im Rahmen des SECAP-Konsortiums. Konsortien und ähnliche Zusammenschlüsse bilden ein Fundament unseres unternehmerischen Netzwerkes.

Die Vertriebsaktivitäten sind hauptsächlich in dem dichten weltweiten Netzwerk von Account Managern, Vertriebsingenieuren und Servicemitarbeitern begründet. Über 30 % der Mitarbeiter

sind in diesem Bereich tätig. Dies hängt vor allem mit der technischen Komplexität unserer Produkte und der Serviceanforderung von Produktionskunden zusammen. Daher befinden sich an allen wesentlichen SÜSS MicroTec-Standorten Kompetenzzentren für die wichtigsten Produktlinien, um sowohl in der Angebotsphase als auch im Servicefall kurzfristig kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stellen zu können.

### UMWELT

Die Produktionsstätten unseres Unternehmens erzeugen prinzipiell keine in hohem Maße umweltschädlichen Schadstoffe. Daher stellt vor allem der Energieverbrauch die größte Umweltbelastung aufgrund unserer unternehmerischen Tätigkeit dar. Hier leisten wir unseren Beitrag vor allem durch Sensibilisierung der Mitarbeiter, mit den Ressourcen verantwortungsvoll und sparsam umzugehen. Denn neben dem Umweltbeitrag handelt es sich auch um einen Beitrag zur Kostensenkung.

Den wesentlichen Beitrag für eine umweltfreundlichere Zukunft liefern wir durch das gemeinsame Projekt mit IBM (C4NP), wo wir eine bleifreie Methode in der Chipverbindungstechnologie bereitstellen wollen. Blei ist hochgiftig und baut sich auch nicht ab. Viele elektronische Konsumgüter enthalten Bleikomponenten und werden insbesondere beim Privatverbraucher nicht vollständig ordnungsgemäß entsorgt – Beispiel hierfür ist das Mobiltelefon. Bei Anwendung unserer in Entwicklung befindlichen Fertigungstechnologie könnten solche Produkte zukünftig bleifrei sein und so zumindest bei der Entsorgung die Umwelt vor weiterer Belastung in diesem Bereich schützen. Somit sehen wir für C4NP nicht nur eine sehr gute Möglichkeit der deutlichen Ausweitung unseres Umsatzvolumens, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt für heutige und zukünftige Generationen.

### RISIKEN FÜR DIE WEITERE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

#### ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

##### Politische Rahmenbedingungen

Neben dem weiter bestehenden Konfliktpotenzial im Nahen Osten könnten die Spannungen zwischen China und Taiwan erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2005 nehmen. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Ländern bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem Ausmaß sind.

##### Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die anhaltende Unsicherheit des Halbleitermarktes und die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehören unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesen Risiken begegnen wir durch eine Anpassung der Strukturen, während bei wieder zunehmender Geschäftstätigkeit Kapazitätsspitzen vor allem extern – durch Outsourcing – ausgeglichen werden sollen.

##### Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

### Abhängigkeit von einzelnen Know-how-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

#### BETRIEBLICHE RISIKEN

##### Vermögens- und Ertragslage

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbilanz könnten bei anhaltend ausbleibender Profitabilität signifikante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hätten wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Muttergesellschaft und des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen werden bei Lagerwerten durch entsprechende Wertberichtigungen latente Überbewertungen vermieden.

##### Preisdruck und Währungsentwicklung

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. Weniger kontrollierbar ist die aktuell sehr rasche Abschwächung vor allem des US-Dollars, da Geschäfte in diesem Währungsraum in der Regel mit unverändertem US-Dollar-Preis getätigt werden. Hier haben wir bereits aktiv reagiert und werden die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöhen. Jedoch kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen, wie es derzeit bei der Währungsentwicklung der Fall ist. Ein grundsätzliches Risiko könnte ein weiteres lang-



## LAGEBERICHT

fristiges Erstarren des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschöpfung nicht mehr ergebnisoptimal wäre. Kurzfristige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschäfte aus. Die Währungssicherung wurde für 2005 nun von sechs Monaten auf zwölf Monate ausgeweitet, wobei grundsätzlich aufgrund der branchenbedingten Unvorhersehbarkeit des Geschäftsverlaufes nur ein Teilbetrag abgesichert wird.

### Zugang zu Fremdkapital und Zinsänderungsrisiko

Wir erwarten zukünftig geänderte Rahmenbedingungen in der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Einführung von „Basel II“. Die Minimierung der Abhängigkeit insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem mit dem Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Das Zinsänderungsrisiko ist begrenzt, da die wesentlichen Fremdkapitalpositionen auf Darlehensbeträgen mit festen Zinssätzen basieren. Die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kreditlinien gelten als wichtiger Parameter bei Bonitätsprüfungen durch potenzielle Kunden. Gelingt es dem Unternehmen nicht, nach dem 30. April 2005 eine neue Kreditlinie in ähnlichem Umfang wie bisher zu vereinbaren, besteht das Risiko, dass künftige Kundenaufträge wegfallen können.

### Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2004 keine bestandgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit über dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil darstellt, der zur Deckung potenzieller Verluste mindestens vorgehalten werden muss.

### RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr sind wir stets darauf aus, ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz zu erreichen. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

### Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

### Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, sicherzustellen, dass die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik eingeübt wird.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

### Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. EUR erreichen oder übertreffen.

### Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Zur weiteren Minderung unserer Risikoposition wurde Anfang 2004 das bestehende konzernweite Versicherungsprogramm optimiert. Es konnten mit Hilfe eines weltweit agierenden Maklers sowohl hinsichtlich der Versicherungssummen als auch bezüglich des inhaltlichen Versicherungsschutzes deutliche Verbesserungen erzielt werden.

### EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag bis zur Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses keine angabepflichtigen Ereignisse ergeben.

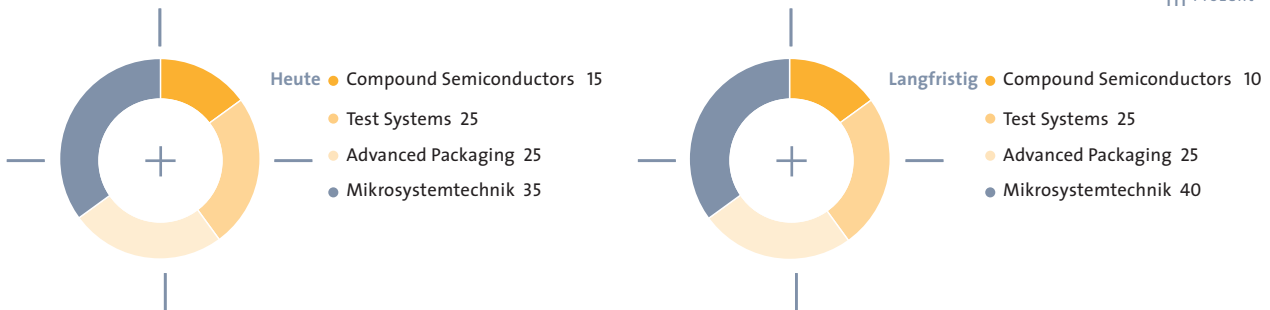
### AUSBLICK

Eine Prognose für 2005 stellt sich unverändert schwierig dar, da digitale Signale die Einschätzung der heutigen Situation erschweren (digital in dem Sinne, dass sich sehr positive und sehr negative Signale gegenüberstehen):



## LAGEBERICHT

### ERWARTETE ANTEILE DER MÄRKTE AM SÜSS MICROTEC-GESAMTUMSATZ in Prozent



Positive Signale sind ein höherer Auftragsbestand als im Vorjahr zum Jahresanfang sowie eine Stabilisierung der Auftragslage seit dem zweiten Quartal 2004. Auch die Vertriebs-Pipeline, wo alle wesentlichen möglichen Aufträge verfolgt werden, zeigt für 2005 ausreichende Potenziale für eine stabile Auftragsentwicklung auf. Negative Signale sind der zurückhaltende Ausblick für die Branche und damit verbundene Auswirkungen auf die Stimmung bei unseren Kunden.

Das zukünftig sehr wichtige Segment des Advanced Packaging wird im Bereich der Speicherchips (DRAM) liegen. Während die DRAM-Fertigung sich heute noch ausschließlich klassischer Packaging-Techniken bedient, wird auch dieser Markt zukünftig mehr und mehr die Vorteile des Advanced Packaging nutzen. Vor allem bei der Fertigung von DRAM-Chips auf den neuen 300mm Wafer-Formaten erwarten wir erst in den Jahren 2005 und 2006 nennenswerte Investitionen der DRAM-Hersteller in diese Technologie. Das Berichtsjahr war in diesem Markt bereits sehr erfolgreich, daher soll in 2005 das Niveau von 2004 erneut erreicht werden.

Der Bereich Verbindungshalbleiter ist im Wesentlichen durch Anwendungen der Telekommunikation beeinflusst. In den Jahren 1999 und 2000 ist es zu erheblichen Überinvestitionen, insbesondere bei den optischen Datennetzwerken gekommen. Diese Überkapazitäten in den Produktionsstätten

der Hersteller optischer Übertragungselemente sind immer noch vorhanden. Das Segment schätzen wir unverändert pessimistisch ein. Der Bereich LED-Produktion und Laserdioden entwickelt sich positiv; 2005 bieten sich hier weiterhin Wachstumspotenziale. Insgesamt sind die Erwartungen für diesen Markt 2005 jedoch sehr zurückhaltend.

Die Mikrosystemtechnik unterscheidet sich von den anderen Feldern durch eine deutlich höhere Diversifizierung, sowohl bei den Produkten selbst als auch bei den Herstellern dieser Produkte. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen extrem kostengünstig gefertigt wird, sind bei den Mikrosystemen die Stückzahlen deutlich geringer und die Variantenvielfalt deutlich höher. Damit hängt die Mikrosystemtechnik nicht an einzelnen Endmärkten, sondern wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima generell beeinflusst. Die derzeit stärksten Impulse für die Mikrosystemtechnik kommen nach wie vor aus der Automobilindustrie und den Computer-Peripheriegeräten wie Tintenstrahldrucker oder Projektordisplays. Aber auch andere Endmärkte, wie die Umweltsensorik, die Biotechnologie, die chemische Industrie und die neuen Nanotechnologien bieten neue Produktchancen für die Mikrosystemtechnik. 2005 und auch in den Folgejahren bietet sich in diesem breit gefächerten Markt das größte Potenzial.

Die Produktlinie der Testsysteme hängt für SÜSS MicroTec historisch weit weniger von den Halbleiterzyklen ab, da hier keine Produktionsgeräte, sondern Geräte für Anwendungen im analytischen Bereich der Entwicklung oder der Fehleranalyse angeboten werden. Der Umsatz in diesem Bereich war über die letzten Jahre sehr stabil, und auch für 2005 erwarten wir Umsätze in einer ähnlichen Größenordnung wie 2004.

Ein Sondereinfluss kann sich durch die Markteinführung von dem gemeinsam mit IBM durchgeführten C4NP-Projekt ergeben. Die Zielpreise für diese Geräte liegen deutlich über denen unseres bestehenden Portfolios, so dass bereits wenige Aufträge einen erheblichen Anstieg des Gruppenumsatzes bedeuten würden. 2005 stehen aber vor allem die notwendigen Entwicklungen im Vordergrund. Erst ab 2006 sind entsprechende Aufträge zu erwarten, wobei durchaus die Möglichkeit besteht, bereits in 2005 den ersten Auftrag zu erhalten und gegebenenfalls auch die Umsatzrealisierung nach Abnahme durch den Kunden. Sollte sich C4NP am Markt durchsetzen, würde sich einerseits das Umsatzvolumen der SÜSS MicroTec-Gruppe strukturell deutlich erhöhen. Andererseits wäre der Anteil des Advanced Packaging am Gesamtumsatz der Gruppe sehr viel höher als die geplanten 25 %.

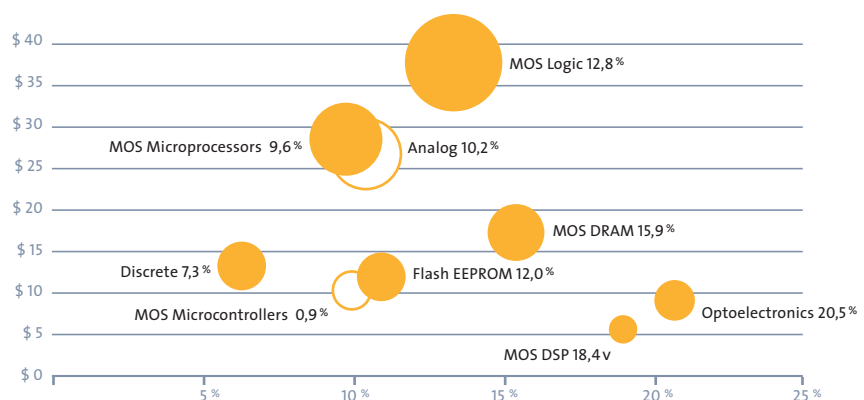
Innerhalb der Regionen sehen wir 2005 und auch langfristig unverändert Nordamerika und Europa mit jeweils ca. 30 % gleich stark, während Asien die stärkste Region darstellen wird.

Insgesamt bewegt sich die Halbleiterindustrie zunehmend auf eine „reife“ Industrie zu. Die Wachstumsraten werden nicht mehr die vergangenen Werte erreichen.

Die großen Wachstumsraten bei den Investitionen basierten auf so genannten Killer-Applikationen: der Siegeszug des PC in den siebziger und achtziger Jahren sowie das Internet in den neunziger Jahren. Für die Zukunft sehen die Analysten in diesem Beispiel das allgegenwärtige Netz, wo z. B. überall eine mobile Verbindung hergestellt werden kann. Die großen Märkte werden zukünftig mit Wachstumsraten unter 20 % erwartet (Quelle: SIA).

Wir gehen davon aus, dass sich unsere langfristige Wachstumsrate in unserem Kerngeschäft bei etwa 10 % bis 15 % einstellen wird, was zwar immer noch deutlich über dem gesamten Wirtschaftswachstum liegt, aber frühere Werte nicht mehr erreicht. Spezielle Wachstumsfelder für SÜSS MicroTec mit höherem Wachstumspotenzial sind im Bereich Verbindungshalb-

**WACHSTUM NACH KATEGORIE**  
Zusammengesetztes jährliches Wachstum 2003 – 2007 in %





## LAGEBERICHT

leiter die LEDs (siehe Optoelectronics) und im Bereich Mikrosystemtechnik DLP (Kippspiegeltechnologie für Projektions-TV). Das größte Potenzial besitzt C4NP, wobei diesbezüglich erst im Laufe des Jahres 2005 verlässliche Aussagen getroffen werden können. Während die Bereiche LED und DLP nach 2004 auch in 2005 Umsatzanteile liefern können, ist dies bei C4NP noch nicht der Fall.

Auch ist möglicherweise die starke Volatilität unserer Industrie in der Zukunft nicht mehr gegeben. Dies erhöht die Planungssicherheit und verbessert auch die Qualität strategischer Entscheidungen. Zurückzuführen ist diese Änderung auf eine Verschiebung der Endkunden, die sich über die Jahre ergeben hat: Der Endkunde gewinnt immer mehr Bedeutung für die Halbleiterindustrie, und die Schwankungen in dieser Konsumentengruppe sind in der Regel deutlich geringer als die bei den Industriekunden.

Zusammenfassend erwarten wir für unser Marktumfeld folgende Entwicklungen:

- langfristige Wachstumsrate auf einen Bereich um 10 % bis 15 % verringert
- höhere Potenziale im Bereich LED, DLP und C4NP
- rückläufige Volatilitäten

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen werden wir unsere Struktur so ausrichten, dass langfristig eine ausreichende Ergebnisperformance erreicht werden kann.

Im laufenden Jahr 2005 steht die weitere Optimierung der Kostenstruktur deutlich im Mittelpunkt. Mehrere Projekte zur Senkung unserer Kosten werden sich bereits in 2005 positiv auswirken. Das größte Potenzial stellt gleichzeitig die größte Herausforderung dar: die Integration der Fertigung des Standortes Aßlar in den Standort Garching bei München.

Weitere Maßnahmen zur Senkung des Break Even werden vor allem innerhalb der nächsten Monate eingeleitet. Das Ziel, ab 2007 bei einem Umsatz von ca. 100 Mio. EUR bereits ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, wird abhängig von der Entwicklung unserer Märkte weiter verfolgt und gegebenenfalls bei Bedarf angepasst. Die erfolgreiche Durchführung notwendiger Kostensenkungsmaßnahmen ist für die nachhaltige Profitabilität und die Werthaltigkeit wesentlicher Aktiva des Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Langfristig soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, stabile Margen im Bereich von 45 % zu erzielen. Die EBIT-Marge soll in Aufschwungzyklen deutlich über 10 % erreichen können.

Aufgrund dieser Kostensenkungsstrategie ist mit einem Rückgang der Anzahl der Mitarbeiter im laufenden Jahr auf zirka 650 auszugehen. Inwieweit ein weiterer Rückgang der Mitarbeiterzahl mit der Senkung des Break-Even-Punktes einhergeht, kann heute nicht abschließend beantwortet werden.

Beim Cash Flow ist bereits im ersten Quartal 2005 von einem erheblichen Liquiditätsabfluss aufgrund des Sozialplans für die Mitarbeiter am Standort Aßlar und der Abfindungszahlung an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden auszugehen. Daher ist ein – für unseren Geschäftszyklus typischer – deutlich positiver operativer Cash Flow im ersten Quartal nicht geplant. Im dritten Quartal ist die erste Tranche der Wandelanleihe in Höhe von 5,6 Mio. EUR zur Tilgung fällig. Wir planen derzeit die Rückzahlung ein, da das aktuelle Kursniveau unserer Aktie zu weit von einem möglichen Wandlungskurs entfernt ist. In 2005 wird sich daher die Barliquidität deutlich verringern, sofern aus dem operativen Geschäft kein erheblicher positiver Cash Flow generiert wird. Zukünftig soll vor allem aus überschüssigen operativen Cash Flows sowie einer Reduzierung des Working Capital (hier mit Schwerpunkt geringerer Lagerbestände) ausreichend Liquidität erzeugt werden, um aus einer stabilen Barliquidität heraus den Fremdkapitalbedarf für das laufende Geschäft und auch das organische Wachstum gering zu halten.



Auch steht 2005 die Änderung der Rechnungslegung an. Planmäßig werden wir erstmals den Jahresabschluss der Gruppe nach den Vorschriften der IFRS veröffentlichen und somit die Berichterstattung nach US-GAAP einstellen. Aus heutiger Sicht gehen wir unter anderem bei folgenden Punkten von wesentlichen Änderungen im Vergleich zu heute aus:

- Die Aktivitäten der Forschung und Entwicklung werden in Teilen aktiviert und über die geplante Laufzeit abgeschrieben (derzeit werden alle damit verbundenen Kosten voll aufwandswirksam verbucht). Diese Änderung kommt dem Ansatz näher, dass unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten „Investitionen“ in die Zukunft sind – zukünftig wird ein Teil auch als Investitionen ausgewiesen.
- Der Goodwill wird zukünftig schwankende Beträge aufweisen (derzeit stabil bei 28 Mio. EUR). Zwar gibt es in IFRS ebenfalls keine planmäßigen Abschreibungen auf den Goodwill, jedoch wird dieser in seiner Währung jeweils zum Stichtag direkt umbewertet. Dadurch sind einige Goodwill-Positionen, die auf US-Dollar basieren, zukünftig Schwankungen ausgesetzt. In US-GAAP erfolgt diese Umbewertung indirekt über das Eigenkapital bei gleichbleibendem Goodwill.
- Die Segmentberichterstattung wird detaillierter ausfallen als bisher. Wir werden planmäßig primär vier Segmente berichten, die sich an den Produktlinien orientieren. Sekundär werden wir eine Sicht nach Regionen aufzeigen.

Insgesamt sehen wir diese Änderungen positiv, da wir von einer erweiterten Informationsbasis für Leser und Investoren ausgehen – was grundsätzlich begrüßenswert ist.

SÜSS MicroTec wird weiterhin die Besetzung lukrativer Nischen in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie verfolgen. Wir wollen durch eine klare Positionierung stets innerhalb

der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten agieren. Die Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; nur im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

#### VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Sämtliche im Lagebericht enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie in dem US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 festgelegt. Worte wie „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „rechnen mit“, „schätzen“, „sollen“, „sollten“, „können“, „werden“ und „planen“ sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf das Unternehmen sollen solche vorausschauenden Aussagen anzeigen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse zahlenmäßig von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden.

Garching, 15. März 2005

Der Vorstand  
Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak

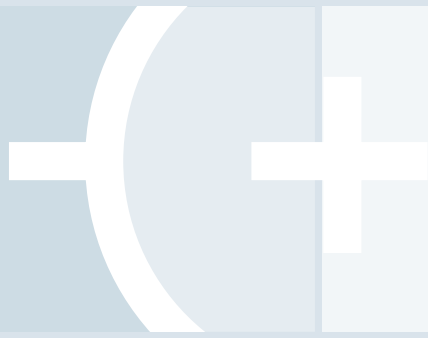


## KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	Anhang Nr.	01.01.-31.12.2004	01.01.-31.12.2003
<b>Umsatzerlöse</b>	VI.4	<b>115.972</b>	<b>95.500</b>
Frachtkosten und Provisionen		-3.105	-2.885
<b>Umsatzerlöse netto</b>		<b>112.867</b>	<b>92.615</b>
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		66.963	56.168
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		<b>45.904</b>	<b>36.447</b>
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten		-44.602	-40.985
Forschungs- und Entwicklungskosten		-10.371	-10.496
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	V.1	1.466	859
Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung		-1.217	-2.916
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-8.820</b>	<b>-17.091</b>
Zinsaufwendungen		-1.520	-1.245
Zinserträge		383	358
Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis		-11	24
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-9.968</b>	<b>-17.954</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	V.2	-6.722	3.401
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-16.690</b>	<b>-14.553</b>
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*		-8.831	-17.067
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*		-3.224	-10.996
Pro Aktie	IV.6		
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR		-1,10	-0,97
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR		-1,10	-0,97
<b>Überleitung zum Comprehensive Income</b>			
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-16.690</b>	<b>-14.553</b>
<b>Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern</b>			
Fremdwährungsdifferenzen		47	-2.255
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung		17	-14
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren		-35	47
<b>Comprehensive Income</b>		<b>-16.661</b>	<b>-16.775</b>

\* Ungeprüft.

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.



## KONZERNABSCHLUSS

### KONZERNBILANZ

#### AKTIVA

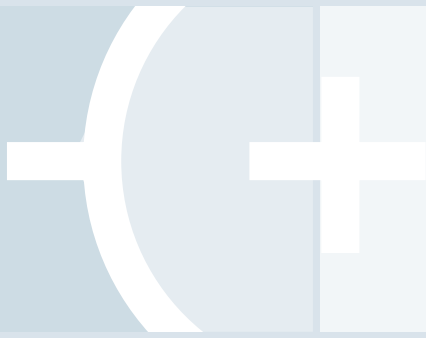
TEUR	Anhang Nr.	31.12.2004	31.12.2003
Flüssige Mittel		22.534	26.785
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	III.3	27.093	23.606
Sonstige kurzfristige Forderungen	III.4	2.742	6.603
Vorräte, netto	III.5	41.245	41.900
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	III.6	1.079	1.094
Kurzfristige aktive latente Steuern	V.2	1.555	2.091
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>96.248</b>	<b>102.079</b>
Sachanlagen	III.7	9.023	11.935
Immaterielle Vermögensgegenstände	III.8	5.355	7.305
Goodwill	III.8	28.009	28.009
Finanzanlagen	III.9	55	144
Langfristige aktive latente Steuern	V.2	2.374	7.480
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	III.10	1.853	1.901
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>46.669</b>	<b>56.774</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>142.917</b>	<b>158.853</b>

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

## KONZERNBILANZ PASSIVA

TEUR	Anhang Nr.	31.12.2004	31.12.2003
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	IV.1	2.550	3.154
Kurzfristiger Teil der Leasingverpflichtungen	IV.2	137	158
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.676	5.972
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	IV.3	255	214
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	IV.1	7.982	2.991
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	IV.4	19.879	16.929
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>36.479</b>	<b>29.418</b>
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	IV.1	13.417	22.423
Langfristiger Teil der Leasingverpflichtungen	IV.2	388	473
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	IV.3	3.385	3.581
Langfristige passive latente Steuern		224	0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	IV.5	430	517
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften		42	32
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>17.886</b>	<b>27.026</b>
Gezeichnetes Kapital Genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd) 22.635 (31.12.2004) bzw. 22.423 (31.12.2003); davon ausgegeben (in tsd.) 15.157 (31.12.2004) bzw. 14.957 (31.12.2003)		15.157	14.957
Kapitalrücklage		84.165	81.561
Gewinnrücklagen		433	433
Bilanzverlust/-gewinn		-5.606	11.084
Kumuliertes Other Comprehensive Income	IV.6	-5.597	-5.626
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>88.552</b>	<b>102.409</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>142.917</b>	<b>158.853</b>

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.



## KONZERNABSCHLUSS

### KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.-31.12.2004	01.01.-31.12.2003
<b>Mittelabfluss /-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
Jahresfehlbetrag	-16.690	-14.553
Wechselkursbedingte Veränderung des kurzfristigen Nettovermögens	757	134
<b>Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelabfluss /-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	750	650
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.855	1.965
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	89	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	3.462	3.784
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	290	322
Änderung der aktiven latenten Steuern	5.642	-1.271
Änderung der passiven latenten Steuern	224	0
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	65	551
Verlust / Gewinn aus Beteiligungen	0	4
Änderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-417	333
Änderung der Wertberichtigung auf Vorräte	763	337
<b>Veränderungen von Aktiva und Passiva</b>		
Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3.070	10.166
Änderung der Vorräte	-108	5.825
Änderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	15	366
Änderung der sonstigen Aktiva	3.909	2.685
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-296	2.038
Änderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.960	-7.503
Änderung der Pensionsverbindlichkeiten	-155	-8
Änderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-87	-238
<b>= Mittelabfluss /-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>5.587</b>

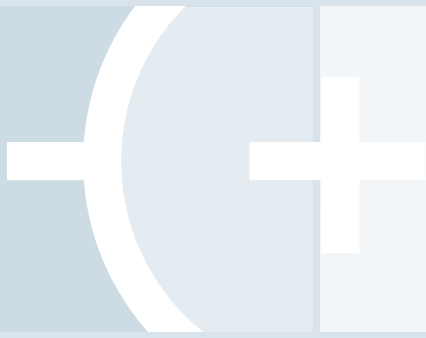
Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

## KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.-31.12.2004	01.01.-31.12.2003
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.239	-1.010
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-7	-10
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	32	3
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.214</b>	<b>-1.017</b>
<b>Mittelabfluss /-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe	0	11.642
Kosten der Wandel- und Optionsanleihe	0	-502
Aufnahme von Bankdarlehen	1.250	0
Tilgung von Bankdarlehen	-3.211	-4.275
Änderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-604	-377
Tilgungen / Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-106	-257
<b>Mittelabfluss /-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.671</b>	<b>6.231</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-3.927</b>	<b>10.801</b>
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-324	-930
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	26.785	16.914
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	22.534	26.785
<b>Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung</b>		
Zinszahlungen während der Periode	1.405	773
Einkommensteuererstattungen /- zahlungen während der Periode inkl. Vorauszahlungen	-1.830	3.767
<b>Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten</b>		
Zugang zum Finanzierungsleasing	94	0

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.





## KONZERNABSCHLUSS

### ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS (ANLAGENSPIEGEL)

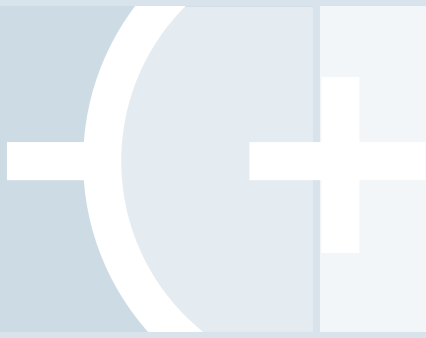
	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2004	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Abgang	31.12.2004
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.592	-203	7	9	14.387
2. Geschäfts- oder Firmenwert	40.581	0	0	0	40.581
	<b>55.173</b>	<b>-203</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>54.968</b>
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Gebäude, Grundstücke	7.544	-126	52	70	7.400
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.537	-549	216	65	9.139
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.783	-108	834	421	13.088
4. Fahrzeuge	577	-6	43	73	541
5. Aktivierte Leasinggegenstände					
Gebäude, Grundstücke, Einbauten	600	0	32	0	632
Technische Anlagen und Maschinen	880	-6	0	0	874
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.464	-65	62	50	1.411
	<b>33.385</b>	<b>-860</b>	<b>1.239</b>	<b>679</b>	<b>33.085</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Equity-konsolidierte Beteiligungen	2.183	0	0	89	2.094
2. Übrige Beteiligungen	202	0	0	0	202
	<b>2.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>2.296</b>
	<b>90.943</b>	<b>-1.063</b>	<b>1.246</b>	<b>777</b>	<b>90.349</b>

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

Kumulierte Abschreibungen

Restbuchwerte

	01.01.2004	Währungs- differenz	Zugang	Abgang	31.12.2004	01.01.2004	31.12.2004
	7.287	-101	1.855	9	9.032	7.305	5.355
	12.572	0	0	0	12.572	28.009	28.009
	<b>19.859</b>	<b>-101</b>	<b>1.855</b>	<b>9</b>	<b>21.604</b>	<b>35.314</b>	<b>33.364</b>
	3.391	-84	515	27	3.795	4.153	3.605
	5.963	-334	1.252	58	6.823	3.574	2.316
	9.475	-87	1.655	374	10.669	3.308	2.419
	538	-6	40	73	499	39	42
	246	0	70	0	316	354	316
	648	-3	68	0	713	232	161
	1.189	-44	152	50	1.247	275	164
	<b>21.450</b>	<b>-558</b>	<b>3.752</b>	<b>582</b>	<b>24.062</b>	<b>11.935</b>	<b>9.023</b>
	2.073	0	0	0	2.073	110	21
	168	0	0	0	168	34	34
	<b>2.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.241</b>	<b>144</b>	<b>55</b>
	<b>43.550</b>	<b>-659</b>	<b>5.607</b>	<b>591</b>	<b>47.907</b>	<b>47.393</b>	<b>42.442</b>



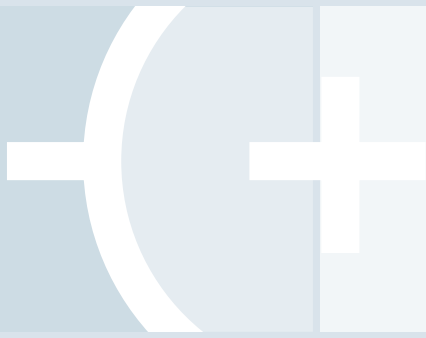
## KONZERNABSCHLUSS

### KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	
<b>Stand 01.01.2003</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>	<b>80.911</b>	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			650	
Jahresfehlbetrag				
Fremdwährungsanpassung				
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt				
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren				
<b>Stand 31.12.2003</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>	<b>81.561</b>	
<b>Stand 01.01.2004</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>	<b>81.561</b>	
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital	200	200		
Zuführung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen			1.854	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			750	
Jahresfehlbetrag				
Fremdwährungsanpassung				
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt				
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren				
<b>Stand 31.12.2004</b>	<b>15.157</b>	<b>15.157</b>	<b>84.165</b>	

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

	Gewinn- rücklage	Bilanzgewinn / -verlust	Kumuliertes Other Comprehensive Income	Total
	433	25.637	-3.404	118.534
				650
		-14.553		-14.553
			-2.255	-2.255
			-14	-14
			47	47
	433	11.084	-5.626	102.409
	433	11.084	-5.626	102.409
				200
				1.854
				750
		-16.690		-16.690
			47	47
			17	17
			-35	-35
	433	-5.606	-5.597	88.552



## KONZERNABSCHLUSS

### ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2004

#### I. BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) ist durch Umwandlung der Karl Süss Verwaltungs GmbH entstanden. Das Unternehmen ist ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen, Deutschland, Waterbury und Palo Alto, USA, und Saint Jeoire, Frankreich. Der Standort Aßlar, Deutschland, wird im Wesentlichen als verlängerte Werkbank (vor allem Auslagerung von Montageleistungen) benutzt. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China. In den Ländern, in denen die Gesellschaft nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

#### II. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

##### II.1 GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Die Gesellschaft ist seit dem 18. Mai 1999 am geregelten Markt in Frankfurt notiert und ist eines der 30 Tec-DAX-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften der US-amerikanischen Rechnungslegung (US-GAAP) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsvorschriften wie US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsmöglichkeit des § 292a HGB in Anspruch. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 3,5 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

##### II.2 WESENTLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HGB UND US-GAAP

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für die Investoren legt, ist die Rechnungslegung nach HGB von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und des Vorsichtsprinzips geprägt. Nachstehend befindet sich eine Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen US-GAAP und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die für die Gesellschaft von besonderer Relevanz sind.

##### Gliederungsvorschriften

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Gliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke orientiert sich an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

##### Sachanlagen

Bewegliche Sachanlagen werden im Konzernabschluss nach US-GAAP linear abgeschrieben, während nach deutschen Grundsätzen in Anwendung steuerlicher Vorschriften Abschreibungen auch degressiv vorgenommen werden.

Nach US-GAAP werden gemietete Grundstücke, Gebäude und betriebliche Anlagen aktiviert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter oder über die Laufzeit des Leasingvertrages vorgenommen, je nachdem welche kürzer ist. Die sich aus zukünftigen Leasingzahlungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen werden als Verbindlichkeiten erfasst. Nach deutschen Grundsätzen ist die buchhalterische Behandlung der Anlagengegenstände entsprechend, allerdings sind die zu erfüllenden Kriterien abweichend.

#### **Goodwill**

Nach US-GAAP wird Goodwill seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Nach deutschem Recht wird Goodwill weiterhin planmäßig über die geschätzte Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren abgeschrieben. Eine Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt nur, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen.

#### **Latente Steuern**

Nach deutschen Grundsätzen werden aktive latente Steuerabgrenzungsposten, die von einem steuerlichen Verlustvortrag herühren, nicht angesetzt. Allein aus den Bewertungsunterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften sich ergebende aktive latente Steuerabgrenzungsposten dürfen angesetzt werden. Für die passive latente Steuerabgrenzung ist eine Rückstellung zu bilden.

Nach US-GAAP besteht eine Aktivierungspflicht für aktive latente Steuern, unabhängig von ihrem Ursprung, und eine Passivierungspflicht für passive latente Steuern. Hinsichtlich des Bilanzausweises als kurz- und langfristig folgen diese Abgrenzungsposten der Klassifizierung derjenigen Posten, die zu den Bewertungsunterschieden Anlass gaben. Aktive latente Steuerabgrenzungsposten werden daraufhin untersucht, ob die Realisierung dieser Posten wahrscheinlich ist und, falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

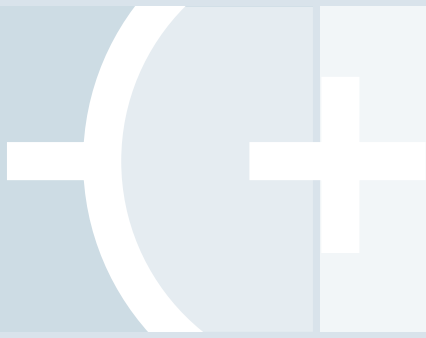
#### **Sonstige Rückstellungen**

Nach US-GAAP sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nur zu bilden, wenn mit dem Eintritt der Verpflichtung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist und der Verpflichtungsbetrag hinreichend sicher geschätzt werden kann. Nach deutschen Grundsätzen sind Rückstellungen auch dann zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme gerechnet wird, d. h. diese hinlänglich wahrscheinlich ist.

#### **Pensionsrückstellungen**

Nach US-GAAP werden die entstandenen Rentenverpflichtungen nach dem Ansammlungsverfahren der „Projected Unit Credit“ Methode berechnet. Dabei wird der rückstellungspflichtige Barwert der Pensionsverpflichtung von Jahr zu Jahr um den Barwert des von den Arbeitnehmern hinzuverdienten Anspruchs erhöht. Berechnungsgrundlage für diese jährlichen Pensionskosten ist der Barwert der verdienten Pensionsanwartschaft unter Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltsanpassungen. Der Abzinsungssatz basiert auf dem langfristigen Zinssatz.

Nach deutschen Grundsätzen werden Rückstellungen für Pensionsverbindlichkeiten, die am Abschlusstichtag existieren, gemäß dem steuerlichen Teilwertverfahren ermittelt. Angleichungen für zukünftige Lohn- und Gehaltssteigerungen bleiben unberücksichtigt. Die Verbindlichkeiten werden vollständig als Leistungspflicht gemäß versicherungsmathematischer Bewertung im Hinblick auf Rentenalter, Lebenserwartung und andere Faktoren unter Verwendung eines festen Jahreszinssatzes von üblicherweise 6 % angesetzt.



## KONZERNABSCHLUSS

### Wandel- und Optionsanleihe

Nach US-GAAP ist der bei der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung vereinnahmte Betrag in voller Höhe als Verbindlichkeit zu passivieren. Eine Aufteilung in einen Fremdkapitalteil einerseits und einen den Wert des Wandlungsrechtes darstellenden Eigenkapitalteil andererseits ist nicht vorgesehen. Die Aufteilung kann nach HGB vorgenommen werden. Entsprechend wird der zugeflossene Betrag für das Wandlungsrecht als Aufgeld in die Kapitalrücklage eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem zu passivierenden Rückzahlungsbetrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht hat Zinscharakter und kann als Disagio aktiviert werden.

Durch die atypische Ausgestaltung der Optionsanleihe, wonach im Ergebnis das Gläubigerrecht bei Optionsausübung untergeht, entfällt die grundsätzlich nach US-GAAP vorgesehene Trennung in Eigen- und Fremdkapital. Folglich erfolgt wie bei der Wandelanleihe eine Passivierung des zugeflossenen Betrages als Verbindlichkeit.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Wandel- und Optionsanleihe sind nach US-GAAP nicht bei ihrer Entstehung als Aufwand zu erfassen, sondern von der passivierten Verbindlichkeit abzugrenzen.

### Bilanzierung von Derivaten

Nach US-GAAP werden Derivate am Bilanzstichtag mit ihrem Marktwert erfasst. Nach den handelsrechtlichen Vorschriften werden derivative Finanzinstrumente als schwebende Geschäfte nur dann bilanziert, wenn durch ihre Bewertung am Bilanzstichtag ein Verlust droht.

### Fremdwährungsumrechnung

Nach US-GAAP werden Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden erfolgswirksam behandelt. Nach deutschen Grundsätzen gilt für Fremdwährungsforderungen das Niederstwertprinzip und für Fremdwährungsverbindlichkeiten das Höchstwertprinzip. Daraus folgt, dass nur unrealisierte Verluste erfolgswirksam antizipiert werden, während unrealisierte Gewinne aus Wechselkursentwicklungen zum Bilanzstichtag unberücksichtigt bleiben.

## II.3 WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN NACH US-GAAP

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt.

### Derivative Finanzinstrumente

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß SFAS Nr. 133 „Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities“ ergänzt durch SFAS Nr. 137, SFAS Nr. 138 und SFAS Nr. 149. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

### Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten sowohl Bankguthaben als auch kurzfristige Kapitalanlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als drei Monaten.



### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen.

Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen gegenüber einzelnen Kunden.

### Wertpapiere

Wertpapiere und Beteiligungen werden mit Marktpreisen bewertet, sofern diese verfügbar sind. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die nach SFAS Nr. 115 als zum „Verkauf bestimmt“ klassifiziert werden („available for sale“), werden unter Berücksichtigung von Steuern im übrigen Comprehensive Income ausgewiesen. Die sonstigen Wertpapiere werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Auf alle Wertpapiere oder Beteiligungen werden bei nicht vorübergehenden Wertminderungen Abschreibungen vorgenommen.

### Vorräte

Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten unter Berücksichtigung des lower-of-cost-or-market-principle bewertet. Herstellungskosten beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Für alle Vorräte mit Ausnahme von halbfertigen und fertigen Erzeugnissen wird die FIFO-Methode (first-in, first-out) für die Bewertung verwendet. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer oder geminderten Verwendbarkeit ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

### Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer für die wesentlichen Anlagekategorien ist nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Außenanlagen und Mietereinbauten	10 – 40 Jahre
Standard-Software	3 – 5 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Wesentliche Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen werden, soweit sie den Wert des Anlagegegenstandes erhöhen bzw. dessen Nutzungsdauer wesentlich verlängern, aktiviert. Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Fremdkapitalzinsen, die für einen Vermögensgegenstand während seiner Bauzeit anfallen, werden aktiviert und beginnend mit der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme über die voraussichtliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes abgeschrieben.



## KONZERNABSCHLUSS

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird zwischen Finanzierungsleasing und Operating Lease unterschieden. Finanzierungsleasinggegenstände werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim Operating Lease erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der Leasingzahlungen im Aufwand.

### Goodwill

Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden gemäß SFAS Nr. 142 „Goodwill and Other Intangible Assets“ seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Goodwill wird jährlich bzw. bei Eintritt besonderer Ereignisse, die zu einer Verringerung des Marktwertes der jeweiligen Berichtseinheit (Reporting Unit) führen können, auch unterjährig, einer Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) unterzogen. Als Reporting Units identifizierte das Unternehmen im Wesentlichen die einzelnen Konzerngesellschaften.

Die Werthaltigkeitsprüfung des Goodwill umfasst zwei Schritte: in einem ersten Schritt wird der Marktwert einer Reporting Unit mit dem Buchwert einschließlich Goodwill verglichen. Falls der Buchwert den Marktwert einer Reporting Unit übersteigt, gilt dieses als Anzeichen für einen möglichen Wertberichtigungsbedarf des Goodwill, und es ist ein zweiter Schritt erforderlich. In diesem zweiten Schritt wird der implizite Marktwert des Goodwill einer Reporting Unit mit dem Buchwert dieses Goodwill verglichen. Der implizite Marktwert des Goodwill entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert der Reporting Unit und den auf sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Reporting Unit zugeordneten Marktwerten, ähnlich der Vorgehensweise im Rahmen einer Unternehmensakquisition gemäß SFAS Nr. 141. Unterschreitet der implizite Marktwert den Buchwert dieses Goodwill, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen.

Im Rahmen der Anwendung von SFAS Nr. 142 führte das Unternehmen den Goodwill-Impairment-Test durch, der zu keiner Wertberichtigung des Goodwill führte.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Diese Vermögensgegenstände werden jährlich – bzw. im Falle von Ereignissen, die auf eine Wertminderung hindeuten können – auch unterjährig auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Der Impairment Test für immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmbarer Nutzungsdauer basiert auf einem Vergleich des Marktwertes mit dem Buchwert des immateriellen Vermögensgegenstands. Sollte der Buchwert den Marktwert übersteigen, wird eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung gebucht.

Immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

### Außerplanmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögensgegenstände

Entsprechend den Vorschriften von SFAS Nr. 144 „Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets“ überprüft der Konzern langfristiges Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer auf Werthaltigkeit, sobald Ereignisse oder veränderte Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögensgegenstandes oder einer Gruppe von Vermögensgegenständen den beizulegenden Wert überschreiten könnte. Die Werthaltigkeit des langfristig genutzten Vermögens wird durch Vergleich des Buchwertes mit den zukünftig aufgrund seiner Nutzung erwarteten Netto-Cash-Flows beurteilt. Ist ein Vermögensgegenstand oder eine Gruppe von Vermögensgegenständen nicht mehr werthaltig, so wird die vorzunehmende Abschreibung als Unterschied zwischen dem bisherigen Buchwert und dem

Marktwert bestimmt. Sachanlagen, die gemäß den Voraussetzungen als zum Verkauf bestimmt gelten, werden zum niedrigeren Wert aus Buchwert und Marktwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet.

#### **Pensionsverpflichtungen**

Die Pensionsverpflichtungen werden bilanziert gemäß SFAS Nr. 87, „Employers Accounting for Pensions“. Die Verpflichtungen, die sich aus den Plänen der deutschen Gruppengesellschaften ergeben, werden mittels der „Projected Unit Credit“-Methode berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Zudem wendet die Gesellschaft das im Jahr 2003 überarbeitete SFAS Nr. 132 „Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits“ an, welches zusätzliche Ausweispflichten für Pensionszusagen und pensionsähnliche Leistungszusagen vorsieht.

#### **Other Comprehensive Income**

US-GAAP erfordern die Darstellung von Other Comprehensive Income innerhalb des Konzernabschlusses. Other Comprehensive Income wird dabei folgendermaßen definiert.

Alle Veränderungen des Eigenkapitals innerhalb des Geschäftsjahres, die nicht durch Anteilseigner verursacht sind und gewöhnlich nach US-GAAP nicht in den Konzernabschluss eingehen. Solche Vorgänge betreffen Fremdwährungsanpassungen, bestimmte unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren und den über die ansetzbaren immateriellen Vermögensgegenstände hinausgehenden Teil der Mindestverpflichtung aus Pensionsverpflichtungen.

#### **Aktienoptionspläne**

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus Aktienoptionsplänen nach SFAS Nr. 123, „Accounting for Stock-Based Compensation“, unter Anwendung der Fair-Value-Methode.

#### **Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)**

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach SFAS Nr. 128, „Earnings per Share“.

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

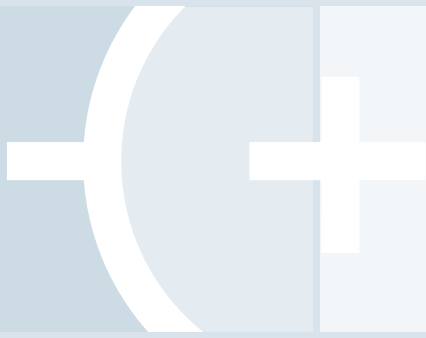
Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

#### **Umsatzrealisierung**

Das Unternehmen wendet für Produktverkäufe das SAB Nr. 104 „Revenue Recognition“ an. Ergänzend kommt für Verkaufsverträge, die mehrere Komponenten enthalten, EITF 00-21 „Revenue Arrangements with Multiple Deliverables“ zur Anwendung. Danach werden die auf die einzelnen Elemente entfallenden Umsatzanteile entsprechend ihrem relativen Verhältnis der Marktwerte bestimmt. Der zu realisierende Betrag wird zudem vom maximal bis zur Lieferung des jeweiligen Elements abzurechnenden Teilbetrag begrenzt.

Umsätze aus Produktverkäufen werden mit Eigentumsübergang an den Kunden realisiert, wenn das Entgelt vertraglich festgesetzt oder bestimmbar und die Erfüllung der damit verbundenen Forderungen wahrscheinlich ist. Umsätze werden erst nach erfolgter Abnahme durch den Kunden realisiert. Soweit die noch zu erbringenden Leistungen nach der Lieferung wesentlich im Sinne des Auftrages sind, erfolgt eine Realisierung erst nach vollständig erbrachter Leistung.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert.



## KONZERNABSCHLUSS

### Garantieverbindlichkeiten

Nach FIN 45 „Guarantors Accounting and Disclosure Requirements for Guarantees, Including Indirect Guarantees of Indebtness of Others“ muss der Garantiegeber Verpflichtungen aus bestimmten eingegangenen Garantien zum Marktwert bilanzieren.

### Frachten und Provisionen

Ausgangsfrachten und Provisionszahlungen an Dritte werden, soweit sie mit dem Verkauf und Vertrieb der Produkte verbunden sind, als Umsatzzminderung ausgewiesen. Eingangsfrachten für erworbene Produkte im Herstellungsprozess werden den Herstellkosten zugeordnet. Provisionszahlungen an Mitarbeiter des Konzerns werden in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten ausgewiesen.

### Aufwendungen für Werbung, Forschung + Entwicklung

Aufwendungen für Werbung, Forschung + Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

### Sonstige Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

### Ertragsteuern

Das Unternehmen wendet SFAS Nr. 109 „Accounting for Income Taxes“ an. Nach der „Liability-Method“ werden dabei für künftige Steuerzahlungen, die sich aus den Unterschieden von Vermögensgegenständen und Schulden zwischen US-GAAP und lokalen steuerlichen Vorschriften ergeben, aktive und passive latente Steuern als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als sonstige Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden die jeweils gültigen bzw. erwarteten Steuersätze (aktuelle Rechtslage) angewendet, die zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Unterschiede gelten. Verlustvorträge werden ebenfalls aktiviert und auf ihre zukünftige Realisierbarkeit untersucht. Falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

Der jeweils verwendete Durchschnittssteuersatz wird in der Überleitungsrechnung dargestellt. Hierzu verweisen wir auf V.2. Nur für 2003 erhöhte sich der Körperschaftsteuersatz aufgrund des Flutopfersolidaritätsgesetzes von 25 % auf 26,5 %. Die Effekte wurden bei der Berechnung der latenten Steuern in 2002 berücksichtigt.

Die Verlustbehandlung im deutschen Steuerrecht wurde durch das am 22. Dezember 2003 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz (sog. Korb-II-Gesetz) geändert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 sind grundsätzlich künftige Verlustvorträge bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR voll und darüber zu 60 % verrechenbar. Diese Regelung gilt entsprechend für gewerbesteuerliche Verlustvorträge. Außerdem wurde durch das Korb-II-Gesetz ein pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften sowie für Inlandsdividenden eingeführt. 5 % dieser Veräußerungsgewinne unterliegen als nicht abziehbare Betriebsausgabe der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

### Bilanzierung von Zuschüssen

Bei der Bilanzierung von Zuschüssen wird zwischen Investitionszuschüssen und Zuschüssen für Forschungs- und Entwicklungskosten bzw. anderen Aufwandszuschüssen unterschieden. Investitionszuschüsse werden bei Zahlungseingang direkt von den Anschaffungskosten der erworbenen Anlagegüter abgezogen. Die anderen Zuschüsse werden bei Zahlungseingang erfolgswirksam unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

### Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen verlangt Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung, die die im Konzernabschluss aufgeführten Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Werte können von den geschätzten Beträgen abweichen.

## II.4 KONSOLIDIERUNG

### Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50 %), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausüben kann, werden nach der Equity-Methode bewertet.

Andere Beteiligungen und Unternehmen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

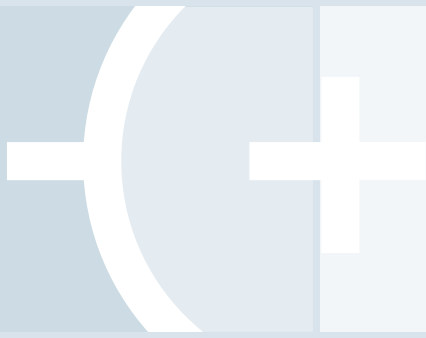
### Transaktionen in Fremdwährungen

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Tageskurs umgerechnet. Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam als Aufwand oder Ertrag im Fremdwährungsergebnis gebucht.

### Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die funktionale Währung des Konzerns ist der Euro. Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2004		2003	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR vs 1 USD	1,36	1,25	1,26	1,13
1 EUR vs 100 JPY	139,83	133,92	134,85	131,17
1 EUR vs 1 GBP	0,71	0,68	0,71	0,69
1 EUR vs 1 CHF	1,54	1,55	1,56	1,52
1 EUR vs 100 NTD	43,63	41,67	42,83	39,04
1 EUR vs 100 CNY	11,12	10,21	10,41	9,38
1 EUR vs 100 THB	53,08	50,17	49,94	47,52



## KONZERNABSCHLUSS

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (OCI – Other Comprehensive Income) ausgewiesen.

### II.5 ANGABEN ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2004 sind folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Wahrung; (\*) = untestiert):

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MICROTEC AG, Garching	15.156.884,00 €	Holding	92.214.726,86 €	-3.417.336,04 €	
SUSS MICROTEC LITHOGRAPHY GMBH, Garching	2.000.100,00 €	100 %	14.143.436,81 €	-4.297.658,20 €	voll
SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH, Sacka	511.291,88 €	100 %	7.917.093,85 €	-107.426,46 €	voll
SÜSS MICROTEC LAB. EQUIPMENT GMBH, Singen (*)	26.000,00 €	100 %	208.459,25 €	145.390,71 €	voll
SUSS MICROTEC LTD., Wokingham Berkshire (*)	£10.000,00	100 %	£1.428.945,00	-£36.550,00	voll
SUSS MICROTEC KK, Yokohama	30.000,00 TJPY	100 %	320.219,00 TJPY	9.064,00 TJPY	voll
SUSS MICROTEC S.A.S., St. Jeoire	1.275.000,00 €	100 %	1.648.759,00 €	-160.896,00 €	voll
SUSS MICROOPTICS S.A., Neuchatel (*)	500.000,00 CHF	85 %	407.631,19 CHF	143.674,45 CHF	voll
SUSS MICROTEC INC., Waterbury	\$105.000,00	100 %	\$11.368.836,31	-\$3.289.473,86	voll
SUSS MICROTEC (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (*)	5.000.000,00 NTD	100 %	27.037.680,00 NTD	18.109.702,00 NTD	voll
SUSS MICROTEC Company Ltd., Shanghai (*)	1.655.320,00 CNY	100 %	2.731.806,60 CNY	751.136,70 CNY	voll
IMAGE TECHNOLOGY INC., Palo Alto (*)	\$24.287,00	100 %	\$240.176,49	\$234.298,42	voll
MFI TECHNOLOGIES Group (*)	\$2.737.476,00	100 %	-\$3.848.755,00	-\$53.555,00	voll
HUGLE LITHOGRAPHY INC., Sunnyvale (*)	\$1.190.442,00	53,1 %	n/a	n/a	at equity
SUSS MICROTEC COMP. LTD, Bangkok (*)	4.000,00 TTHB	49 %	12.020,00 TTHB	1.011,00 TTHB	voll
KARL SÜSS GESCHÄFTSFÜHRUNGSGMBH, Garching (*)	25.564,59 €	100 %	40.913,43 €	-26,99 €	at cost
Zentrum für Technologiestruktur-entwicklung, Glaubitz (*)	51.129,19 €	10 %	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*)	n/a	10 %	n/a	n/a	keine

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Die SUSS MicroTec Company Ltd., Bangkok, wurde erstmals im Geschäftsjahr 2004 voll in den Konzernabschluss einbezogen. Erstkonsolidierungszeitpunkt war der 31. Dezember 2004. Die SÜSS MicroTec AG hält unmittelbar 49 % an dieser Gesellschaft. Die

SUSS MicroTec Company Ltd., Bangkok, ist als weitere Vertriebsgesellschaft für die SÜSS-Gruppe im Anim tätig und wird von der SÜSS MicroTec AG kontrolliert.

#### II.6 UNTERNEHMENSERWERBE

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2004 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

#### II.7 NEUE RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Im Geschäftsjahr 2004 wurden keinerlei neue Rechnungslegungsvorschriften veröffentlicht, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der SÜSS MicroTec AG wesentlich betreffen.

### III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZAKTIVA (WERTE IN TEUR)

#### III.1 MARKTWERTE DER FINANZINSTRUMENTE

Die geschätzten Marktwerte der nichtderivativen Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde.

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

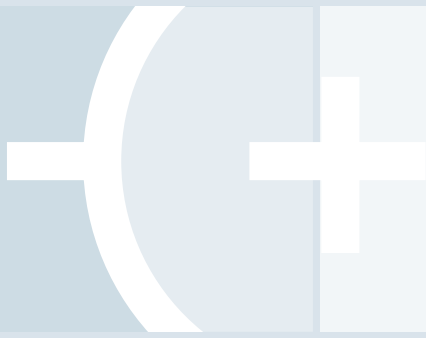
**Flüssige Mittel:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

**Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Langfristige Darlehen:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten wird durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Bei variabel verzinsten Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte annähernd ihren Marktwerten, da die Zinssätze auf variablen Zinsen basieren, die sich an den Marktsätzen orientieren.

**Wandelanleihe:** Zur Ermittlung des fairen Wertes der auf Basis der Wandelanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Wandelanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

**Derivative Instrumente** sind zu Marktwerten gemäß den Bankmitteilungen angesetzt.



## KONZERNABSCHLUSS

Marktwerte der Finanzinstrumente, die sowohl Aktiv- als auch Passivpositionen der Bilanz betreffen:

	2004		2003	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Flüssige Mittel	22.534	22.534	26.785	26.785
Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.417	21.417	17.634	17.634
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-2.550	-2.550	-3.154	-3.154
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. kurzfristiger Teil)	-11.770	-11.811	-13.772	-14.144
Wandel- und Optionsanleihe	-9.629	-8.457	-11.642	-10.233

### III.2 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen. Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt.

Zum 31. Dezember 2004 und 2003 bestanden folgende Devisentermingeschäfte:

	2004		2003	
	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR
Verkauf von US-Dollar (in TUSD)	3.560	182	5.621	599
...davon bis zu einem Jahr	3.560	182	5.261	556
...davon bis zu zwei Jahren	0	0	360	43
Verkauf von Yen (in Mio JPY)	306,2	97	28,5	5
...davon bis zu einem Jahr	306,2	97	28,5	5
Kauf von US-Dollar (in TUSD)	0	0	400	-25
...davon bis zu einem Jahr	0	0	400	-25

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen ermittelt. Zum 31. Dezember 2004 wurden die Devisentermingeschäfte mit ihren Marktwerten bilanziert und unter Rückstellungen bzw. sonstigen kurzfristigen Forderungen ausgewiesen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2004 bestehenden Verpflichtungen dar. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.



### III.3 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

	2004	2003
Forderungen gegen Dritte	28.531	25.461
Wertberichtigungen	-1.438	-1.855
<b>Forderungsbestand netto</b>	<b>27.093</b>	<b>23.606</b>

### III.4 SONSTIGE KURZFRISTIGE FORDERUNGEN

Als „available for sale“ im Sinne von SFAS Nr. 115 weist die Gesellschaft unter dieser Position den Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc., aus, der aus der Veräußerung von Patenten und der Technologie betreffend Röntgenlithografie im Geschäftsjahr 2001 stammt.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Börsenkurs abgeleitet wurde. Der durch die Marktwertänderung entstandene unrealisierte Verlust in Höhe von 35 TEUR wurde ergebnisneutral innerhalb des Eigenkapitals im Other Comprehensive Income (OCI) ausgewiesen. Der Wert der Aktien in den sonstigen kurzfristigen Forderungen beträgt zum Jahresende 75 TEUR (2003: 110 TEUR).

In den sonstigen kurzfristigen Forderungen sind folgende Positionen enthalten:

	2004	2003
Steuervorauszahlungen	1.590	4.180
Devisentermingeschäfte	279	604
Umsatzsteuer	218	548
Geleistete Anzahlungen	160	208
Sonstiges	495	1.063
<b>Sonstige kurzfristige Forderungen</b>	<b>2.742</b>	<b>6.603</b>

### III.5 VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

	2004	2003
Materialien und Hilfsstoffe	15.969	18.767
Unfertige Erzeugnisse	13.876	12.668
Fertigerzeugnisse	8.696	6.788
Demonstrationsgeräte	10.556	10.745
Handelswaren	141	162
Wertberichtigungen	-7.993	-7.230
<b>Vorräte netto</b>	<b>41.245</b>	<b>41.900</b>



## KONZERNABSCHLUSS

### III.6 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen und die Kosten der Wandel- und Optionsanleihe.

### III.7 SACHANLAGEN

Für die Darstellung der Sachanlagen verweisen wir auf den beigefügten Anlagenspiegel.

	2004	2003
Abschreibung auf Sachanlagen	3.752	4.106

Änderungen in der künftigen IT-Ausrichtung des Konzerns machten in Deutschland außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 411 TEUR (2003: 0 TEUR) auf Standard-Softwarelizenzen notwendig. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen sind in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten enthalten.

#### Leasing

Das Unternehmen hat bestimmte Sachanlagen über langfristige Mietverträge angemietet. Diese Verträge stellen aufgrund ihrer Charakteristika Finanzierungsleasing dar und werden entsprechend buchhalterisch behandelt. Zur detaillierten Darstellung verweisen wir auf den Anlagenspiegel und auf IV.2. Daneben mietet das Unternehmen Gebäude, Büroeinrichtungen und Fahrzeuge, die Operating Lease darstellen.

### III.8 GOODWILL UND IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

#### Goodwill

Entsprechend den Regelungen des SFAS Nr. 142 wird Goodwill in Höhe von 28 Mio. EUR seit dem 1.1.2002 nicht länger planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich oder wenn Indikatoren auf eine Wertminderung hinweisen, auf seine Werthaltigkeit hin überprüft.

Die erstmalige Anwendung von SFAS Nr. 142 verlangte, dass alle im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen vor dem 1. Juli 2001 erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände, welche die in SFAS Nr. 141 beschriebenen Voraussetzungen für einen separaten Ausweis nicht erfüllen, als Goodwill auszuweisen sind. Ebenso sind immaterielle Vermögensgegenstände, welche die Kriterien für einen separaten Ausweis erfüllen, bisher aber als Goodwill aus der Erstkonsolidierung erfasst waren, als immaterielle Vermögensgegenstände auszuweisen. Das Unternehmen stellte in diesem Zusammenhang keinen Bedarf an Umgliederungen fest.

Die erforderliche jährliche Überprüfung des Goodwill auf Wertminderung hat die Gesellschaft jeweils im dritten Quartal eines Geschäftsjahres vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Geschäftsjahren 2004 und 2003 außerplanmäßige Abschreibungen nicht notwendig waren.

#### Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Die sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2004 bzw. 2003 bestehen aus Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 5.355 TEUR bzw. 7.305 TEUR.

Die Abschreibungen auf die sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände betragen 1.855 TEUR für das Geschäftsjahr 2004 sowie 1.965 TEUR für das Geschäftsjahr 2003. Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden weder im Geschäftsjahr 2004 noch in 2003 vorgenommen.

Im Zusammenhang mit der Erstanwendung von SFAS Nr. 142 wurde im Mai 2002 die Nutzungsdauer aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände überprüft. Dabei wurden keine immateriellen Vermögensgegenstände festgestellt, die eine unbestimmbare Nutzungsdauer haben. Nach Ablauf der planmäßigen Nutzungsdauer werden Restwerte für diese immateriellen Vermögensgegenstände nicht erwartet.

Auf Basis des Bestands an immateriellen Vermögensgegenständen, die ausnahmslos eine bestimmbare Nutzungsdauer haben, werden die folgenden Abschreibungsbeträge für die folgenden fünf Berichtsjahre erwartet:

	Betrag TEUR
2005	1.769
2006	1.202
2007	1.121
2008	1.121
2009	136
... Später	6

Diese Schätzungen können von den tatsächlichen Beträgen in der Zukunft abweichen.

### III.9 FINANZANLAGEN

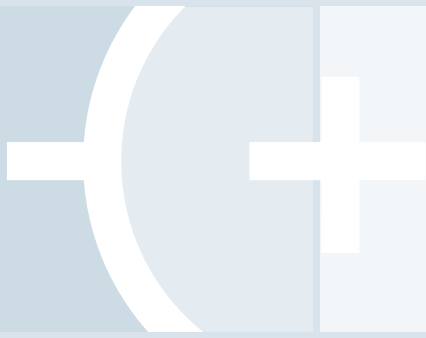
Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	2004	2003
Equity-konsolidierte Beteiligungen	22	110
Übrige Finanzanlagen	33	34
<b>Finanzanlagen</b>	<b>55</b>	<b>144</b>

Mittels der Equity-Methode wurde die Beteiligung an der Hugle Lithography Inc., USA, (Anteil 53,1 %) bewertet. Die Beteiligung wurde zum 31. Dezember 2004 mit ihrem anteiligen Eigenkapital in Höhe von 22 TEUR (Vorjahr 22 TEUR) bilanziert.

Die 49%-Beteiligung an der Suss MicroTec Company Ltd., Bangkok, wurde zum Bilanzstichtag erstmals voll in den Konzernabschluss einbezogen. Im Vorjahr betrug der nach der Equity-Methode einbezogene Beteiligungsansatz dieser Gesellschaft 88 TEUR.

Daneben bestehen weitere Beteiligungen mit Anteilen am Aktienkapital von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.



## KONZERNABSCHLUSS

### III.10 SONSTIGE LANGFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen.

	2004	2003
Rückdeckungsversicherung	1.456	1.422
Ausleihungen	198	208
Kautionen	159	59
Sonstiges	40	212
<b>Sonstige langfristige Aktiva</b>	<b>1.853</b>	<b>1.901</b>

## IV. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZPASSIVA

### IV.1 KURZ- UND LANGFRISTIGE BANKVERBINDLICHKEITEN

#### Finanzierung

Die SÜSS MicroTec AG hat am 30. September 2004 einen Darlehensvertrag mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH über eine Darlehenssumme in Höhe von 3.350 TEUR abgeschlossen. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich eines risikoadäquaten Aufschlages vereinbart. Die Effektivverzinsung im Geschäftsjahr lag bei 7,32 % p. a.. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt 1.250 TEUR ausgezahlt. Das Darlehen ist spätestens am 30. Juni 2006 vollständig zurückzuführen.

Das Unternehmen hat im Vorjahr eine Konsortialkreditvereinbarung mit mehreren Banken geschlossen. Durch den Vertrag wird der SÜSS MicroTec AG und der Suss MicroTec Lithography GmbH insgesamt eine Kreditlinie von 11,0 Mio. EUR eingeräumt. Zum Stichtag wurde die eingeräumte Kreditlinie nicht beansprucht. Die Konsortialvereinbarung ist bis zum 30. April 2005 befristet.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft weitere Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

	2004	2003
Kreditlinie	16.491	16.923
Inanspruchnahme	2.550	3.730
<b>Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>13.941</b>	<b>13.193</b>

#### Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

Die kurzfristigen Kredite zum 31. Dezember 2004 und 2003 betragen 2.550 TEUR und 3.154 TEUR. Der durchschnittliche Zinssatz der Kreditlinien betrug 6,39 % (2003: 6,16 %).

### Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

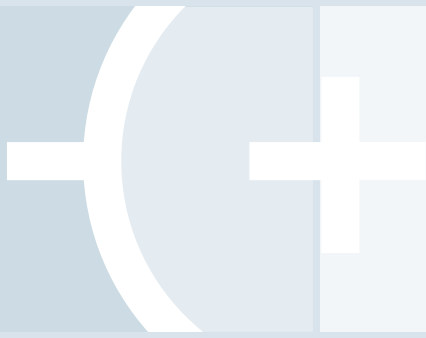
	2004	2003
Anleihen	9.629	11.642
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	11.770	13.772
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gesamt	21.399	25.414
Abzüglich kurzfristige Beträge	7.982	2.991
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristige Beträge	13.417	22.423

Nach der Wandlung von Schuldverschreibungen im Betrag von 2.013 TEUR in 200.000 neue Stückaktien der SÜSS MicroTec AG beläuft sich der Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf insgesamt 9.629 TEUR. Hiervon entfallen 9.256 TEUR auf eine Wandelanleihe, die mit 6 % p. a. verzinst wird und in Höhe von 5.634 TEUR am 31. Oktober 2005 und in Höhe von 3.622 TEUR am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 919.810 Aktien der SÜSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis beträgt hierfür 10,063075 EUR pro Aktie. Die SÜSS MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu 30 % des Nennbetrages verlangen, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140 % des Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch von bis zu 50 % des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 200 % des Wandlungspreises liegt.

Des Weiteren entfallen 373 TEUR auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6 % p. a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt 10,566229 EUR und liegt um 5 % über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von 9,566229 EUR je Aktie. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3 % der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135 % über dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausübung der Bezugsrechte kann ab 4. November 2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200 % über dem Bezugspreis liegt.

Wandel- und Optionsanleihe sind unbesichert.

Zum 1. Dezember 2004 waren Bankdarlehen in Höhe von nominal 1.432 TEUR durch Grundschulden besichert. Für Bankdarlehen über 6.374 TEUR hat die SÜSS MicroTec AG ihre Anteile an der Suss MicroTec Lithography GmbH, an der Suss MicroTec S.A.S. und an der Suss MicroTec Inc. verpfändet.



## KONZERNABSCHLUSS

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

	2004	2003	Zinssatz	Fälligkeit
Bankdarlehen I (EUR)	3.178	3.813	3,25 %	2009
Bankdarlehen II (EUR)	3.196	3.835	3,75 %	2009
Bankdarlehen III (EUR)	0	590	4,25 %	2004
Bankdarlehen IV (EUR)	588	735	3,75 %	2008
Bankdarlehen V (USD) in EUR	692	1.025	9,81 %	2007
Bankdarlehen VI (USD) in EUR	201	302	8,75 %	2007
Bankdarlehen VII (USD) in EUR	655	981	8,75 %	2007
Bankdarlehen VIII (EUR)	1.250	0	variabel	2006
Sonstige Darlehen < 1 Mio. EUR	2.010	2.491		
<b>Gesamt</b>	<b>11.770</b>	<b>13.772</b>		
...davon kurzfristig fällig	2.348	2.991		
...davon langfristig fällig	9.422	10.781		
... fällig in 2005	2.348			
2006	3.691			
2007	1.959			
2008	1.593			
2009	1.442			
...später	737			
	<b>11.770</b>			

### IV.2 LEASINGVERBINDLICHKEITEN

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Leasing-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Betriebs- und Geschäftsausstattung Capital-Leasing-Verträge. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

	Finance Lease	Operating Lease	Davon Operating Lease mit nahe-stehenden Personen
Aufwendungen 2003	-	2.633	1.828
Aufwendungen 2004	-	2.997	1.809
...fällig in 2005	176	2.916	1.749
2006	157	2.264	1.749
2007	110	1.797	1.448
2008	93	1.674	1.448
2009	74	420	339
...später	0	1.034	1.018
<b>Gesamt zukünftig</b>	<b>610</b>	<b>10.105</b>	<b>7.751</b>
Zinsanteil	85		
<b>Verbindlichkeit</b>	<b>525</b>		
...davon kurzfristig	137		
...davon langfristig	388		

#### IV.3 PENSIONSVERBINDLICHKEITEN

Das Unternehmen hat verschiedene Versicherungspläne, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichern. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i. d. R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Die Pensionsverpflichtungen setzten sich wie folgt zusammen:

	2004	2003
Inländische Verpflichtungen	3.259	3.461
... davon kurzfristig	243	212
Ausländische Verpflichtungen	381	334
... davon kurzfristig	12	2
<b>Gesamt</b>	<b>3.640</b>	<b>3.795</b>
... davon kurzfristig	255	214

##### Deutsche Pläne

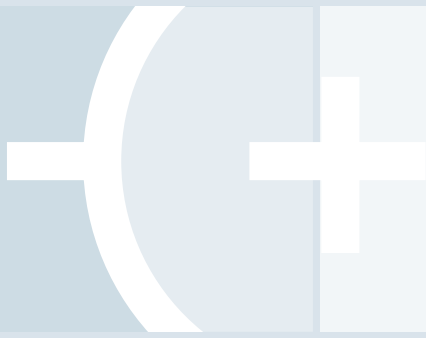
Die Pensionszusagen umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2004	2003
Abzinsungsfaktor	5,25 %	5,25 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	1,0 %	1,0 %
Lebenserwartung gem. Richttafel Dr. Heubeck 1998		

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Änderung der Anwartschaftsbarwerte („PBO“) in den Geschäftsjahren 2004 und 2003:

Überleitung der Anwartschaftsbarwerte	2004	2003
Anwartschaftsbarwert (PBO) 01.01.	3.461	3.520
Servicekosten	10	9
Zinskosten	175	186
Versicherungsmathematischer Gewinn (Verlust)	-113	24
Pensionszahlungen	-274	-278
Anwartschaftsbarwert (PBO) 31.12.	3.259	3.461

Der Anwartschaftsbarwert der Pensionsverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag mit dem versicherungsmathematischen Barwert („ABO“) identisch.



## KONZERNABSCHLUSS

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

Darstellung des Bilanzwertes	2004	2003
Anwartschaftsbarwert (PBO) 31.12.	3.259	3.461
Plankapitalanlagen	0	0
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	3.259	3.461
Nicht realisierte Überleitungsbeträge	-36	-71
Nicht realisierte Servicekosten früherer Perioden	-17	-18
Nicht realisierte versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	18	-96
	3.224	3.276
Zusätzliche Mindestverbindlichkeit	35	185
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	89
... davon Other Comprehensive Income	35	96
Pensionsrückstellung	3.259	3.461

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

Aufstellung der Pensionsaufwendungen	2004	2003
Servicekosten	10	9
Zinskosten	175	186
Amortisation der Überleitungsbeträge	36	36
Amortisation der Servicekosten früherer Perioden	0	1
Amortisation der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste	1	1
Pensionsaufwendungen	222	233

Folgende Tabelle zeigt die erwarteten Rentenzahlungen für die nächsten zehn Jahre:

Prognose der Rentenzahlungen	Betrag TEUR
2005	255
2006	257
2007	260
2008	263
2009	265
2010 bis 2014	1.366

### U.S. – Pläne

Das Unternehmen hat für seine amerikanischen Mitarbeiter, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.



Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 2.000 USD (d. h., der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.000 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2004 betragen die Aufwendungen des Unternehmens für den Gewinnbeteiligungsplan 0 TUSD (2003 0 TUSD) und für den 401 (k) Plan 166 TUSD (2003 0 TUSD).

#### IV.4 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Der Bilanzposten teilt sich wie folgt auf:

	2004	2003
Abgegrenzte Personalkosten	7.980	4.011
Erhaltene Anzahlungen	3.436	2.688
Fremdleistungen	1.790	1.420
Sonstige Rückstellungen	1.435	1.241
Garantierückstellungen	1.411	1.275
Prämien und Provisionen	1.187	1.950
Steuerrückstellungen	489	1.005
Abgegrenzte Fördermittel	475	0
Passive Rechnungsabgrenzung	377	825
Umsatzsteuer	211	329
Rückkaufgarantien	188	0
Sonstiges	900	2.185
<b>Summe</b>	<b>19.879</b>	<b>16.929</b>

In den abgegrenzten Personalkosten ist eine Rückstellung für Restrukturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Schließung des Werkes in Aßlar in Höhe von 1.369 TEUR enthalten. Die abgegrenzten Personalkosten enthalten zudem eine bilanzielle Vorsorge für das Ausscheiden von Herrn Dr. Richter.

Die Garantierückstellungen werden jährlich auf Basis der entstandenen Garantiekosten im Verhältnis zum erzielten Umsatz neu kalkuliert.

	Betrag TEUR
Stand 1. Januar 2004	1.275
Neue Gewährleistungsrückstellungen	2.651
Auszahlungen für Gewährleistungen	2.444
Zugänge zu bestehenden Gewährleistungen	0
Auflösung nicht in Anspruch genomener Gewährleistungen	71
<b>Stand 31. Dezember 2004</b>	<b>1.411</b>



## KONZERNABSCHLUSS

### IV.5 SONSTIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

In den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

	2004	2003
Lieferantenverbindlichkeiten	139	221
Darlehen von Mitarbeitern	97	96
Sonstiges	194	200
<b>Summe</b>	<b>430</b>	<b>517</b>

### IV.6 EIGENKAPITAL

Zum Vorjahresstichtag betrug das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG EUR 14.956.884. Am 6. Februar 2004 haben Inhaber der im November 2003 begebenen Wandelschuldverschreibung, fällig am 30. April 2006, ihr Wandlungsrecht teilweise ausgeübt und Wandelschuldverschreibungen im Betrag von 2.013 TEUR in insgesamt 200.000 neue Stückaktien der SÜSS MicroTec AG gewandelt. Die neuen Aktien wurden aus bedingtem Kapital gewährt. Aufgrund der Wandlung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 200.000 EUR und beträgt sodann 15.156.884 EUR. Es ist in 15.156.884 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR eingeteilt.

Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß dem handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 wurde das bestehende genehmigte Kapital 2002 und die damit verbundene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aufgehoben. Gleichzeitig wurde die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 7.478 TEUR mit Ermächtigung zu teilweisem Bezugsrechtsausschluss beschlossen.

Am 31. Dezember 2004 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt 5.797 TEUR. Es kann bis zu 5.000 TEUR für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Weitere 491 TEUR sind für den ab 2003 geltenden Aktienoptionsplan vorgesehen. Der Restbetrag von 307 TEUR ist dem alten, geschlossenen Optionsplan zuzuordnen.

	2004	2003
Grundkapital	15.157	14.957
Genehmigtes Kapital	7.478	7.466
<b>Bedingtes Kapital</b>	<b>5.797</b>	<b>5.807</b>

### Other Comprehensive Income (OCI)

Die Entwicklung des OCI stellt sich wie folgt dar:

	2004	2003
Fremdwährungsanpassungen	-5.613	-3.358
Mindestverbindlichkeit Pensionen	-60	-46
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren	47	0
OCI zu Beginn der Periode	-5.626	-3.404
<b>Veränderungen vor Steuern</b>		
Fremdwährungsanpassungen	-47	-2.255
Mindestverbindlichkeit Pensionen	27	-23
Unrealisierte Verluste/ Gewinne aus Wertpapieren	-35	47
<b>Steuereffekte</b>		
Fremdwährungsanpassungen	0	0
Mindestverbindlichkeit Pensionen	-10	9
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren	0	0
OCI am Ende der Periode	-5.597	-5.626

### Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

#### AKTIONSOPTIONSPLAN 1999

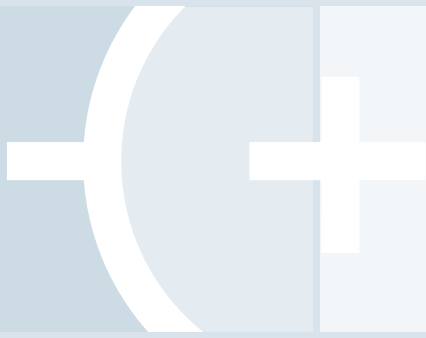
In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu 800 TEUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von drei Jahren, zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von fünf Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50 %, nach vier Jahren um mindestens 75 % bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100 % übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf 350 TEUR gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

#### AKTIONSOPTIONSPLAN 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde weiterhin der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu 500 TEUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren zu 100 % ausgeübt werden.



## KONZERNABSCHLUSS

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für zwölf Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat, als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex

oder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollen Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 750 TEUR (2003: 650 TEUR) für diese Pläne vorgenommen.

Aus dem in der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 248.408 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von 3,44 EUR gewährt. Davon sind im Geschäftsjahr infolge des Ausscheidens von Mitarbeitern 3.000 (2003: 6.500) Bezugsrechte verfallen. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals bestanden folglich zum Bilanzstichtag noch 490.500 (2003: 493.500) Bezugsrechte.

In 2003 wurden aus dem gleichen genehmigten Kapital bereits 216.500 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 1,11 gewährt.

Am 31. Dezember 2004 bestanden insgesamt 761.963 Bezugsrechte (2003: 523.796 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2004 gewährten Optionen in Höhe von 2,63 EUR wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells geschätzt. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen:

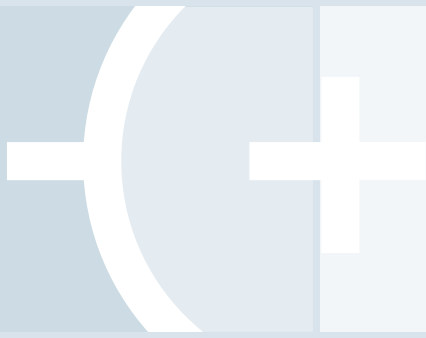
	2004	2003	2002
Erwartete durchschnittl. Laufzeit	6 Jahre	6 Jahre	5 Jahre
Risikofreier Zinssatz	3,58 %	3,23 %	-
Erwartete Volatilität SÜSS-Aktie	39 %	38 %	-
Erwartete Dividende	0 %	0 %	-

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	Gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis EUR
<b>31.12.1998</b>	<b>0</b>	
gewährt 1999	136.000	13,00
ausgeübt 1999	0	
verfallen 1999	9.600	13,00
<b>31.12.1999</b>	<b>126.400</b>	<b>13,00</b>
gewährt 2000	157.662	28,64
ausgeübt 2000	0	
verfallen 2000	0	
<b>31.12.2000</b>	<b>284.062</b>	<b>21,68</b>
gewährt 2001	68.000	35,44
ausgeübt 2001	0	
verfallen 2001	3.432	27,31
<b>31.12.2001</b>	<b>348.630</b>	<b>24,31</b>
gewährt 2002	0	
ausgeübt 2002	24.400	13,00
verfallen 2002	1.430	28,64
<b>31.12.2002</b>	<b>322.800</b>	<b>25,14</b>
gewährt 2003	216.500	1,11
ausgeübt 2003	0	
verfallen 2003	15.504	9,31
<b>31.12.2003</b>	<b>523.796</b>	<b>15,68</b>
gewährt 2004	248.408	3,44
ausgeübt 2004	0	
verfallen 2004	10.241	19,64
<b>31.12.2004</b>	<b>761.963</b>	<b>11,64</b>
ausgeübt	24.400	
noch begebbar	35.092	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	Gewichteter durschnittl. Bezugspreis EUR	Gewichtete durschnittl. Restlaufzeit Monate
unter 10,00 EUR	455.408	2,38	61
10,00 EUR – 19,99 EUR	94.140	13,00	0
20,00 EUR – 24,99 EUR	-	-	-
25,00 EUR – 29,99 EUR	120.415	27,31	11
30,00 EUR – 35,99 EUR	68.000	35,44	17
ab 36,00 EUR	24.000	36,00	5
	<b>761.963</b>	<b>11,64</b>	<b>40</b>



## KONZERNABSCHLUSS

### Ergebnis pro Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses pro Aktie.

	2004	2003
<b>Zähler:</b>		
Jahresfehlbetrag	-16.690	-14.553
<b>Nenner:</b>		
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien		
unverwässert	15.134.384	14.956.884
Verwässerung	0	0
verwässert	15.134.384	14.956.884
<b>Ergebnis pro Aktie in EUR:</b>		
unverwässert	-1,10	-0,97
verwässert	-1,10	-0,97

Im Geschäftsjahr 2004 wurden 1.293.080 Aktien aus der im Vorjahr begebenen Wandel- und Optionsanleihe bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

Die ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden bei der Berechnung der verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

## V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### V.1 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2004	2003
Sonstige Zuschüsse	722	320
Rückstellungsaufösungen	514	997
Versicherungsleistungen	329	139
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	148	0
Mitgliedsbeiträge	61	65
Mieterträge	39	47
Stornogebühren	0	593
Sonstiges	499	722
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.312</b>	<b>2.883</b>
Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	93	654
Abgang Anlagevermögen	89	551
Vertragsstrafen, Schadenersatz	85	479
Rückzahlung Zuschüsse	0	47
Sonstige Steuern	-7	165
Sonstiges	586	128
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>846</b>	<b>2.024</b>
<b>Summe</b>	<b>1.466</b>	<b>859</b>

Die sonstigen Zuschüsse betreffen insbesondere erhaltene Zuschüsse aus einem Förderprojekt der Europäischen Union.

## V.2 STEUERN

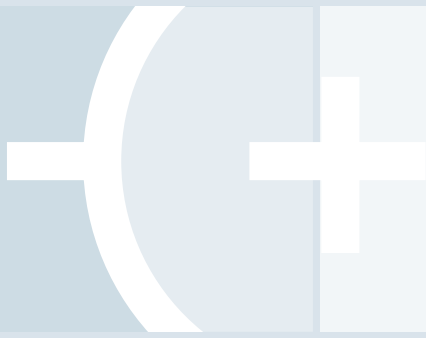
Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellt sich wie folgt dar:

	2004	2003
Deutsche Körperschaftsteuer	2.672	1.764
Deutsche Gewerbeertragsteuer	2.214	1.523
Ausländische Ertragsteuer	1.836	-1.788
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.722</b>	<b>1.499</b>
Inanspruchnahme / Bildung latenter Steuern auf Verlustvorträge	0	-4.900
Sonstiges	0	0
<b>Gesamtertrag/ -aufwand</b>	<b>6.722</b>	<b>-3.401</b>
... davon laufend	725	-1.851
Inland	138	930
Ausland	587	-2.781
... davon latent	5.997	-1.550
Inland	4.748	-2.542
Ausland	1.249	992

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

	2004	2003
<b>Angenommener Steuersatz</b>		
Körperschaftsteuer	25,00 %	25,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuersatz	14,90 %	14,90 %
<b>Kombinierter Steuersatz</b>	<b>37,34 %</b>	<b>37,34 %</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-9.968</b>	<b>-17.954</b>
<b>Erwartete Ertragssteuern</b>	<b>-3.722</b>	<b>-6.704</b>
Abweichende Steuersätze im Ausland	-16	753
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen	171	92
Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen	19	156
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	96	281
Steueraufwand Vorjahre	575	0
Wertberichtigung auf Verlustvorträge	9.404	1.793
Sonstiges	195	228
<b>Effektive Ertragssteuern</b>	<b>6.722</b>	<b>-3.401</b>

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 9.404 TEUR vorgenommen. Der größte Teil der Wertberichtigungen betrifft aktive latente Steuern auf Verlustverträge und wurde bei den deutschen Konzerngesellschaften einschließlich der SÜSS MicroTec AG in Höhe von 5.957 TEUR notwendig. Bei den Gesellschaften in Frankreich und Amerika erfolgten insgesamt Wertberichtigungen in Höhe von 475 TEUR bzw. 3.897 TUSD. Die Wertberichtigungen reduzieren die aktiven latenten Steuern auf einen Betrag, der nach Auffassung der Gesellschaft – basierend auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Gewinne sowie des Zeitpunkts der Umkehrung zeitlicher Buchungsunterschiede – eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich realisiert werden kann.



## KONZERNABSCHLUSS

Im Vorjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern aus Verlustvorträgen in Höhe von 1.793 TEUR vorgenommen. Der größte Teil dieser Wertberichtigung betraf die Konzerngesellschaft in Japan und ergab sich aus der zeitlich eingeschränkten Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

	Aktiva		Passiva	
	2004	2003	2004	2003
Bonusrückstellungen	80	101		
Pensionsrückstellungen	1.195	1.277		
Urlaubsrückstellungen	175	143		
Sonstige Rückstellungen	725	620		
Devisentermingeschäfte			86	232
Wandelanleihe			280	222
Goodwill		5	313	
SAB 104 Anpassungen	142	156		
Zwischengewinneliminierung	1.733	2.218		
Unterschiedl. Abschreibungen			473	616
Sonstiges	623	639		
Verlustvorträge	12.532	9.108		
./. Wertberichtigung Verlustvorträge	-10.823	-3.626		
./. Wertberichtigung auf weitere aktive latente Steuern	-1.525	0		
<b>Gesamt</b>	<b>4.857</b>	<b>10.641</b>	<b>1.152</b>	<b>1.070</b>
... davon kurzfristig	1.555	2.091	0	0
... davon langfristig	2.374	7.480	224	0

### V.3 NAHESTEHENDE PERSONEN

#### Süss Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (Süss MicroTec Lithography GmbH, Süss Dresden Test Systems GmbH, Süss MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der Süss Grundstücksverwaltung GbR oder der Hungar Mountains. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind in IV.2 dargestellt.

	2004	2003
Mietzahlungen	1.809	1.828



### Familie Süss

Die Familie Süss als ehemalige Gesellschafter und heutige Aktionäre des Unternehmens hat Bezüge in verschiedenster Form, u. a. als Pensionsansprüche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süss dar. Die Pensionsansprüche sind in IV.3 Pensionsverpflichtungen, deutsche Pläne, dargestellt.

	2004	2003
Gehälter und Pensionen	353	254

### CMS

Das Mitglied des Aufsichtsrates, Dr. Schücking, ist Gesellschafter der CMS, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe nimmt Rechtsberatung von dieser Kanzlei in Anspruch.

	2004	2003
Beratungsleistungen	42	86

### Leistungen an nahestehende Personen

	2004	2003
Gehälter und Pensionen	353	254
Beratungsleistungen	42	86
Mietzahlungen	1.809	1.828
<b>Summe</b>	<b>2.204</b>	<b>2.168</b>

## VI. SONSTIGE ANGABEN

### VI.1 BESONDERE AUFWANDSPOSITIONEN

#### Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

	2004	2003
Löhne und Gehälter	37.349	33.532
Soziale Abgaben	6.809	6.287
Aufwendungen zur Altersvorsorge	667	472
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>44.825</b>	<b>40.291</b>

#### Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen in 2004 41.373 TEUR (2003: 35.921 TEUR).



## KONZERNABSCHLUSS

### VI.2 FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	2004	2003
Bestellobligo	5.728	5.492
Sonstiges	1.016	823
<b>Summe</b>	<b>6.744</b>	<b>6.315</b>

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Gesellschaft ist im Mai 2004 im Zusammenhang mit der Einbringung von Geschäftsanteilen in die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2000 vom Rechtsbeistand der einbringenden Partei darauf hingewiesen worden, bei der steuerlichen Behandlung der Einbringung eine angeblich im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag geschlossene Abrede nicht beachtet zu haben. Gegenwärtig ist nicht abzusehen, ob es in dieser Angelegenheit zu einer streitigen Auseinandersetzung kommt. Der Vorstand, der sich auf die Angaben seines Rechtsbeistandes stützt, sieht die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage der Gegenpartei eher gering und hat daher keine Rückstellung für ein mögliches Prozessrisiko gebildet.

### VI.3 RESTRUKTURIERUNG

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden im Frühsommer 2004 mehrere Kostensenkungsprojekte initiiert. Dies führte auch zur Entscheidung, das Werk in Aßlar bei Frankfurt am Main zu schließen und die Produktion in das Werk in Garching zu integrieren. Ein entsprechender Sozialplan wurde angefertigt und die Mitarbeiter informiert. Insgesamt wurden zum 31. Dezember 2004 Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 1.369 TEUR gebildet. Angaben zur Restrukturierung sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

	Mitarbeiter
Verwaltung	2
Marketing und Vertrieb	1
Produktion und Technik	27
Forschung und Entwicklung	14
<b>Gesamt</b>	<b>44</b>
gezahlt in 2004	0
zu zahlen in 2005	1.369
<b>Gesamt</b>	<b>1.369</b>

Die Aufwendungen zur Zuführung der Rückstellung wurden den entsprechenden Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung zugeordnet. Im Zusammenhang mit dem Kostensenkungsprojekt wurden im Berichtsjahr insgesamt 501 TEUR an eine Beratungsgesellschaft gezahlt. Zusätzlich waren außerplanmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens in Höhe von 411 TEUR erforderlich.

Als Ergebnis von Einsparmaßnahmen wurde die Entscheidung getroffen, ein Vertriebsbüro in den USA zu schließen. Dafür wurde eine Rückstellung von 200 TEUR gebildet.

#### VI.4 SEGMENTSBERICHTERSTATTUNG

Die Gruppe ist mit dem Verkauf von technischen Produkten und Service nur in einem Segment tätig. Die Gruppe entwickelt, produziert und verkauft im Bereich Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik. Hauptkunden sind der Automobilsektor und die Halbleiterindustrie, wo diese Geräte für ähnliche Zwecke eingesetzt werden.

In 2004 und 2003 wurden mit keinem Kunden 10 % oder mehr des Konzernumsatzes erzielt.

	2004	2003
<b>Externe Umsatzerlöse – Produkte</b>		
Deutschland	46.342	39.877
USA	37.213	30.212
Frankreich	6.297	5.844
Asien	14.739	8.721
Sonstige Länder	2.520	1.865
<b>Gesamt</b>	<b>107.111</b>	<b>86.519</b>
<b>Externe Umsatzerlöse – Service</b>		
Deutschland	2.285	2.787
USA	1.546	1.843
Frankreich	831	714
Asien	862	416
Sonstige Länder	232	336
<b>Gesamt</b>	<b>5.756</b>	<b>6.096</b>
<b>Langfristige Aktiva</b>		
Deutschland	14.558	21.400
USA	2.882	5.046
Frankreich	2.187	2.470
Asien	997	1.243
Sonstige Länder	558	698
Konsolidierung	-2.522	-2.092
<b>Gesamt</b>	<b>18.660</b>	<b>28.765</b>
<b>Goodwill</b>		
Deutschland	9.082	9.082
USA	16.169	16.169
Frankreich	1.166	1.166
Asien	187	187
Sonstige Länder	1.405	1.405
<b>Gesamt</b>	<b>28.009</b>	<b>28.009</b>

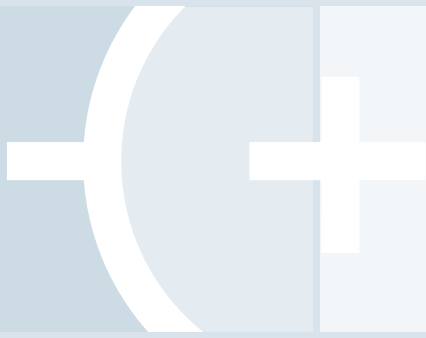
#### VI.5 VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

##### Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2004 waren:

**Herr Dr. Franz Richter**, Dipl.-Ingenieur, Eichenau, Vorstandsvorsitzender bis 9. Dezember 2004

Zuständigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Operations (bis 31. August 2004),  
Vertrieb, Marketing, Personal, Investor Relations, Recht und Versicherungen,  
Mergers und Aquisitions (bis 9. Dezember 2004)



## KONZERNABSCHLUSS

**Herr Dr. Stefan Schneidewind**, Dipl.-Ingenieur, Moritzburg / OT Reichenberg, Vorstandsvorsitzender ab 9. Dezember 2004,  
Mitglied des Vorstands ab 1. September 2004

Zuständigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion und Facility Management, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz (ab 1. September 2004)  
Vertrieb und Marketing, Konzernstrategie (ab 9. Dezember 2004)

**Herr Stephan Schulak**, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach (Mitglied des Vorstands)

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik  
Investor Relations, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal (ab 9. Dezember 2004)

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr 788.961 EUR. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und der Leasingraten für den Firmenwagen) wurden Herrn Dr. Richter und Herrn Schulak insgesamt 37.500 EUR bzw. 25.000 EUR aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Für den Jahresbonus 2004 von Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von 88.891 EUR gebildet. Der Bonus für Herrn Dr. Richter wurde im Rahmen der Rückstellung für Abfindungszahlungen berücksichtigt.

Zudem wurden an Herrn Dr. Richter und Herrn Schulak jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Herr Dr. Schneidewind erhielt anteilig für seine Zeit als Vorstand der Gesellschaft entsprechend 13.333 Bezugsrechte. Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe 2,6302 EUR.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

	Dr. Franz Richter	Dr. Stefan Schneidewind	Stephan Schulak
<b>Barvergütung</b>			
Fixum	332.534	73.731	231.305
Erfolgsbezogen	0	22.223	66.668
<b>Summe</b>	<b>332.534</b>	<b>95.954</b>	<b>297.973</b>
<b>Aktienoptionen</b>			
Anzahl	40.000	13.333	40.000
Ausübungspreis	3,44	3,44	3,44

Weiterhin wurden aufgrund der in 1999, 2000, 2001, 2003 und 2004 an Vorstände gewährten Optionen 477 TEUR als Personalaufwand in der Holding erfasst. Es erfolgten hieraus aber keinerlei Zahlungen an die Vorstände.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von 22 TEUR.

### Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2004:

**Dr. Winfried Süß**, München, Aufsichtsratsvorsitzender  
 Weitere Mandate: ISiT, Itzehoe (Kurator)

**Thomas Schlytter-Henrichsen**, Kronberg im Taunus, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

**Dr. h. c. Horst Görtz**, Neu-Anspach, Kaufmann  
 Weitere Mandate: Ultimaco Safeware AG, Oberursel (Aufsichtsratsvorsitzender)  
 GITS AG, Bochum (Aufsichtsratsvorsitzender)

**Prof. Dr. Anton Heuberger**, München, Professor an der TU CAU Kiel  
 Weitere Mandate: West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)  
 IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
 Solid Energy, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
 Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

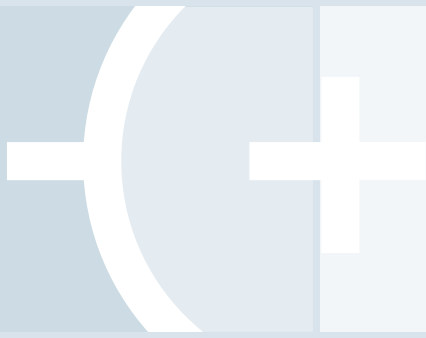
**Dr. Christoph Schücking**, Frankfurt am Main, Rechtsanwalt und Notar  
 Weitere Mandate: Lambda Physik AG, Göttingen (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main  
 (stellvertretender Vorsitzender im Gesellschafterausschuss)  
 Kennametal Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

**Dr. Thomas Sesselmann**, Tittmoning, Geschäftsführer  
 Weitere Mandate: Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)  
 Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)  
 ACU-RITE Companies Inc., Jamestown, NY, USA (Mitglied Board of Directors)  
 Heidenhain K.K., Nagoya, Japan (Mitglied Board of Directors)  
 SUMTAK Corporation, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr insgesamt 42.182 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates verzichtete auf seine Bezüge. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten je 7.669 EUR und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates erhielt 11.504 EUR.

### Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum 31.12.2004:

	Aktien	Optionen
Dr. Franz Richter	400.000	145.000
Dr. Stefan Schneidewind	0	35.648
Stephan Schulak	0	80.286
Dr. Winfried Süß	1.025.000	0
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909	0
Dr. h.c. Horst Görtz	3.894	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0
Dr. Christoph Schücking	500	0
Dr. Thomas Sesselmann	0	0



## KONZERNABSCHLUSS

### VI.6 MITARBEITER

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 733 Mitarbeiter (2002: 737 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2004	2003
Verwaltung	106	104
Marketing und Vertrieb	239	236
Produktion und Technik	386	376
<b>Summe</b>	<b>731</b>	<b>716</b>

In den at equity einbezogenen Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter o (2003: 15 Mitarbeiter) tätig.

### VI.7 CORPORATE GOVERNANCE

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Dezember 2004 abgegeben und im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

### VI.8 ANGABE GEMÄSS § 160 NR. 8 AKTG

Julius Baer Multistock (eine Anlagegesellschaft nach Luxemburger Recht – Publikumsfonds), 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, hat der Gesellschaft gem. § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG mitgeteilt, dass sie per 9. März 2004 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG unterschritten hat. Ihr Stimmrechtsanteil beträgt nun 4,79 %.

Am 1. Februar 2005 teilte Julius Baer Multistock, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, der SÜSS MicroTec AG mit, dass sie per 28. Januar 2005 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der Gesellschaft überschritten hat und seit diesem Zeitpunkt einen Stimmrechtsanteil von 5,01 % hält.

Garching, 15. März 2005

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak

## BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den Accounting Principles Generally Accepted in the United States of America (US-GAAP) liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den Accounting Principles Generally Accepted in the United States of America ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres.

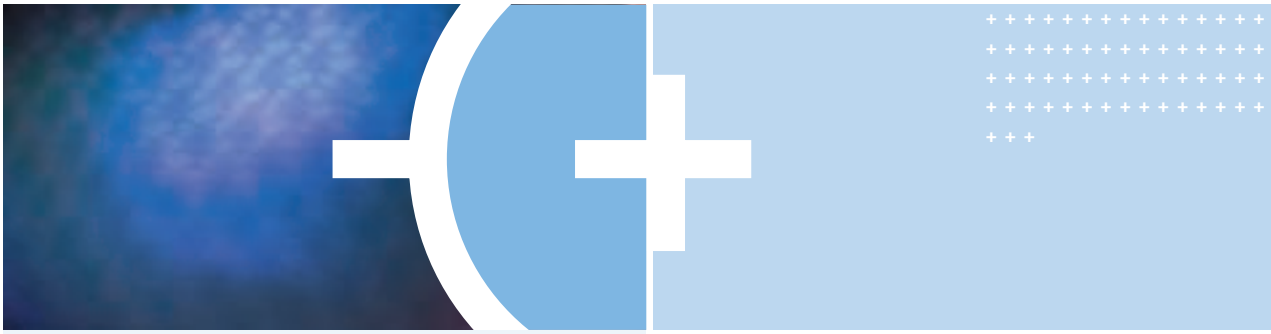
Unsere Prüfung, die sich auch auf den von dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 aufgestellten, mit dem Lagebericht des Mutterunternehmens zusammengefassten, Konzernlagebericht erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen.

München, den 17. März 2005

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Braun  
Wirtschaftsprüfer

Querfurth  
Wirtschaftsprüfer



## GLOSSAR

### 300 MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (mehr als 90 %) der heute verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 200 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf eine Wafer hergestellt werden können (und je mehr Chips auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip). Aktuell vollzieht sich der Übergang von 200 mm zu 300 mm Durchmesser der Wafer. Dies erfordert eine Anpassung der Herstellungs- und Prozesstechnologien in der Halbleitertechnik.

### ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Bei neueren Chipdesigns ist die Zahl der Anschlusskontakte pro Chip inzwischen auf über 1.000 angestiegen. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im so genannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

### ATOM

Kleinstes stabiles Element, das in der Natur vorkommt. Je nach Größe und Eigenschaft werden Atome in verschiedenen Elementen geordnet (Periodensystem der Elemente).

### BACKEND

Zweiter (hinterer) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen durchführen lassen (Packaging Foundries).

### BIOCHIP

Kleiner Chip aus Silizium, Glas, Kunststoff oder Papier, der in zahlreiche Mikrostrukturen unterteilt ist, auf denen sich spezielle Sonden aus biologisch aktiven Molekülen befinden.

### BLUETOOTH

Technologie zur drahtlosen Übermittlung von Sprache und Daten über kurze Distanzen durch kurze Radiowellen. Wird überwiegend zur drahtlosen Kommunikation von verschiedenen elektronischen Geräten untereinander eingesetzt, z. B. Mobiltelefon mit Kopfhörer oder PC mit Drucker etc.

### BONDEN

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafers mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. „Adhesives Bonden“ bedeutet das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwache atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (vander-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Bei einem anschließenden Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

### BUMP

(Engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o. Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

### CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlusskontakte, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

### CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen, die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafers beschickt wird.

### COMPOUND SEMICONDUCTOR

Siehe Verbindungshalbleiter.

### COST OF OWNERSHIP (COO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von größter Bedeutung.

### C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ bedeutet Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation des bewährten C4-Prozesses. „NP“ steht dabei für New Process.

### DIE

„Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse eingebaut wurden. Sie entstehen auf dem Wafer, indem der Die die vielen Prozessschritte durchläuft. Die Dies befinden sich also während des gesamten Fertigungsprozesses auf dem Wafer. Erst wenn sie fertig sind, wird der Wafer in die einzelnen ICs zerschnitten und diese werden dann in die Gehäuse gesetzt. Diese gehäuseten Dies werden dann oft Chips genannt. „Die“, „IC“ und „Chip“ werden oft synonym verwendet.

### DRAM

Dynamic Random Access Memory. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

### FAB

Fabriken, in denen ICs auf Wafers produziert werden. Die Errichtung einer großen Fab, mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden Dollar.

### FLIP-CHIP-BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.





#### FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese veränderten Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

#### FOUNDRY

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für Vertrieb und Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

#### FRONTEND

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Hier werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

#### GAAS

Galliumarsenid; Halbleiterwerkstoff, der für die Herstellung von Mikrochips für optoelektronische und Hochfrequenz-Anwendungen verwendet wird. Aufgrund der gegenüber Silizium höheren Elektronenmobilität ermöglicht dieser Werkstoff die Realisierung schnellerer Mikrochips und damit leistungsstärkerer Geräte.

#### HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

#### IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher integrierter Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

#### LCD-TFT

LCD (Liquid Crystal Display). TFT (Thin-Film Transistor).

LCDs sind Flüssigkristalldisplays, bestehend aus zwei Glasplatten mit stromführenden Leiterbahnen. Das Flüssigkristall zwischen den Platten lässt normales Licht durch. Wird ein elektrisches Feld in den Glasplatten erzeugt, lassen die Kristalle an dieser Stelle kein Licht mehr durch, es entsteht ein schwarzer Punkt. TFT ist eine spezielle Technologie der elektrischen Ansteuerung der LCDs. Hier ist – anders als bei den alternativen „Passiv Matrix LCD“ – jeder einzelne Bildpunkt (Pixel) über einen Transistor ansteuerbar. Diese sog. aktive Matrix ermöglicht eine bessere Bildqualität als die Passiv Matrix LCDs.

#### LED

Light Emitting Diode; Leuchtdiode. LEDs sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmals so große Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

#### LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Silizium-Wafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske entsprechen den Strukturen, die in diesem Schritt auf die ICs gebracht werden sollen. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet, an lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Die Belichtung des Fotoresist führt zu einer chemischen Veränderung, die ein Auflösen des Fotoresist in einem Entwicklungsbad erlaubt. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in der Größenordnung von 0,13 bis 0,6 Mikrometer. Im Backend, beim Advanced Packaging, werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

#### MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs gebraucht werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise. Die Maske wird dann beim Lithografie-Schritt eingesetzt, um bestimmte Bereiche zu belichten und so die zu ätzenden Bereiche zu definieren.

#### MEMS

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektrische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

#### MIKROMETER/MIKRON

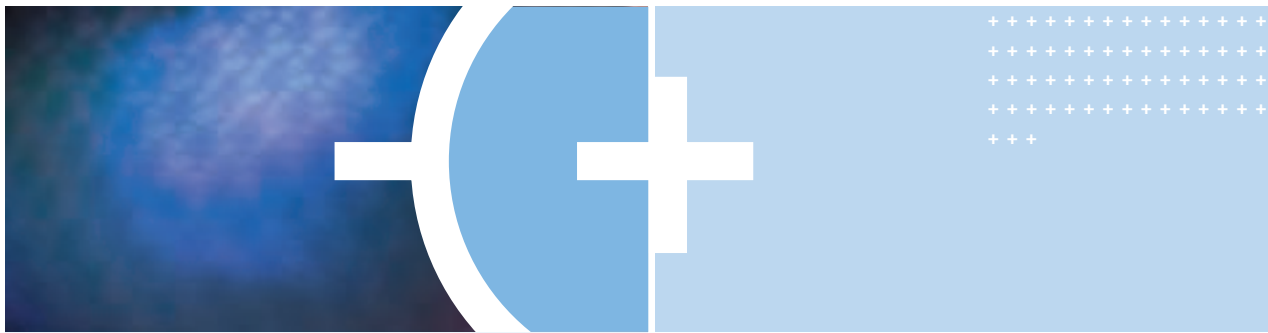
Metrisches Längenmaß. Symbol:  $\mu\text{m}$ . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60  $\mu\text{m}$ .

#### MIKROSYSTEM

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

#### MIKROSYSTEMTECHNIK (MST, MEMS, MOEMS)

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definition des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology, oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)



## GLOSSAR

der Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

### MOLEKÜL

Mehrere Atome können sich zu einem Molekül verbinden und dadurch völlig andere Eigenschaften annehmen.

### NANOIMPRINTING

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinting in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

### NANOTECHNOLOGIE

(Griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter ( $10^{-9}$  m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

### OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit so genannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

### PACKAGING FOUNDRIES

Siehe Backend.

### PDA

Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch.

### PLASMA(BEHANDLUNG)

Ein Plasma ist ein Gas, in dem Atome, Ionen und freie Elektronen gleichzeitig nebeneinander existieren. Durch elektrische Felder können Elektronen und Ionen beschleunigt werden und beim Auftreffen auf eine Oberfläche Veränderungen bewirken. Darüber hinaus können Plasmen Strahlung erzeugen, die, je nach Wellenlänge, zur Strahlungsbehandlung von Materialien eingesetzt werden kann.

### SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

### SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

### SYSTEMS-ON-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Laptops, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips immer größere Wichtigkeit.

### TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

### VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

### WAFER

Runde Scheiben aus Reinst-Silizium, auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300 mm Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200 mm Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

### WIRE-BONDING

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

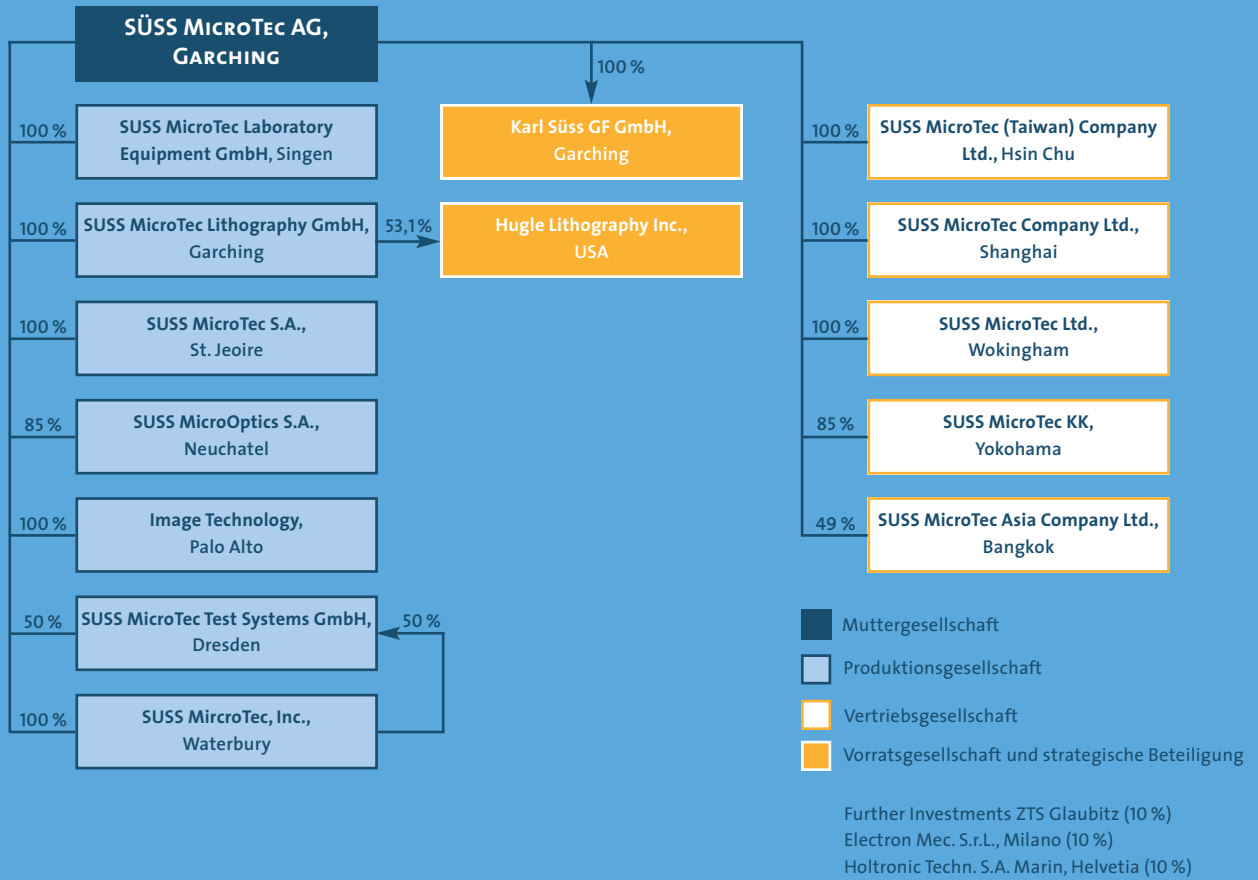
### WIRELESS LAN

Direkt in Deutsch übersetzt bedeutet der Begriff „Kabelloses lokales Netzwerk“. Damit wird Bezug genommen auf die in jedem Bürogebäude vorhandenen Computernetzwerke. Beim Wireless LAN werden die Kabel durch eine Technik ähnlich dem Handynetz ersetzt.

### YIELD

Die Ausbeute – ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

# SÜSS MicroTEC AG HOLDING STUKTUR



+++++

## IMPRESSUM

Herausgeber: SÜSS MicroTEC AG  
 Redaktion: Investor Relations, Accounting & Financial Reporting  
 Wirtschaftsprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, München  
 Gestaltung und Satz: IR-One AG & Co., Hamburg  
 Druck: Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

## KONTAKT

SÜSS MicroTEC AG  
 Schleißheimer Straße 90  
 85748 Garching, Deutschland  
 E-mail: info@suss.de  
 Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 0

Investor Relations  
 Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 314  
 E-mail: ir@suss.de

+++++

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTEC AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



[www.suss.com](http://www.suss.com)